

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2026-071



北京赛微电子股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨云春、主管会计工作负责人许骥及会计机构负责人(会计主管人员)霍夕淼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”章节中，对公司可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、MEMS 业务收入下降风险

公司于 2025 年 7 月出售瑞典 Sillex 控制权，瑞典 Sillex 不再纳入公司合并报表。2023-2025 年，瑞典 Sillex MEMS 业务收入占公司 MEMS 业务收入的比例分别为 85.56%、82.69%、77.72%；去年同期即 2025 年上半年，瑞典 Sillex 业务收入占公司 MEMS 业务收入的比例为 86.69%。瑞典 Sillex 控制权出售后，瑞典 Sillex 的收入不再纳入公司合并范围，静态情形下导致公司 MEMS 业务收入规模大幅下降。

2、业务协同不及预期风险

2025 年 9 月，公司完成对展诚科技 56.24%股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00%股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务。得益于集成电路行业总体行业的发展以及展诚科技在 IC 设计服务领域领先的行业地位，展诚科技 IC 设计服务业务发展势头良好，但公司收购展诚科技还旨在进一步拓展和深化在 MEMS 纯代工、IC 设计服务领域的战略布局，即依托展诚科技在 IC 设计服务领域积累的产业资源，以“MEMS+”模式推动双方业务发展，促进公司半导体服务产业生态协同，进一步提升公司综合竞争实力、行业地位和竞争力。若公司未能有效应对与展诚科技在企业文化、技术体系差异、业务整合管理等可能的多重协同整合影响因素，双方业务或将难以高效协同，因此在未来一段时间内，存在公司与展诚科技业务协同不及预期的风险。

3、非经常性损益利润波动风险

公司于 2025 年 7 月出售瑞典 Sillex 控制权，2026 年 5 月 7 日，瑞典 Sillex 成功在瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市交易，股票代码 SILEX。截至本公告披露日，公司直接持有瑞典 Sillex 9.90%普通股，并已按约定将瑞典 Sillex 上市增发普通股后 19.10%的普通股转让给 Bure，该 19.10%普通股将在瑞典 Sillex 首次公开募股锁定期承诺届满至公司与 Bure 双方约定时间内，由公司决策后，指令 Bure 协助择机出售，相关收益归公司所有。上述剩余股权为以公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产，在后续计量中，每期末需根据瑞典 Sillex 二级市场股价重新评估其公允价值，公允价值变动形成的利得或损失直接影响当期利润。故公司存在非经常性损益在当前与未来均会对公司利润造成显著波动的风险。

4、净利润与经营活动产生的现金流量不匹配风险

公司持有较大规模以公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产，对持有的金融资产，公司在各期末出售的情况下，上述公允价值变动损益仅为账面损益变动，无对应当期现金流入或流出，不产生实际现金流。受公允价值阶段性波动影响，公司各期账面净利润会随公允价值变动发生波动，但经营活动产生的现金流量与此并不关联，由此导致公司归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金流量存在巨大差异，出现两者不匹配的情况。未来随着公司所持金融资产公允价值持续波动，该差异将持续存在，存在公司净利润与经营活动产生的现金流量不匹配的风险。

5、新兴行业的创新风险

公司 MEMS 主业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也是国家“十五五”规划中的科技前沿攻关领域，该产业技术进步及迭代迅速，要求行业参与者不断通过新技术/工艺的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术/工艺、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，近年来，公司研发费用支出的绝对金额以及占营业收入的比重均处于高位，2023-2025 年及 2026 年上半年，公司研发费用分别高达 3.57 亿元、4.55 亿元、3.93 亿元、1.99 亿元，占营业收入的比重分别高达 27.44%、37.75%、47.66%、111.56%（2026 年上半年主要系瑞典 Sillex 出表公司营业收入下滑，导致研发费用占营业收入比重大幅上升），而研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

6、行业竞争加剧的风险

公司 MEMS 主业直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、惠普、意法半导体、德州仪器等 IDM 企业，也包括 Teledyne、台积电、X-FAB、索尼、Atomica 等境外代工企业，以及芯联集成、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微、华鑫微纳等含 MEMS 业务的境内企业；IC 设计服务及 EDA 工具服务竞争对手包括创意电子、智原科技、灿芯股份、创耀科技、芯原股份、华大九天、概伦电子、广立微、行芯科技等。MEMS 属于技术、智力及资金密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来市场及产品竞争的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

7、国际局势及汇率波动风险

自二战之后，特别是上世纪八九十年代以来，全球化发展日益加速，已成为时代发展的重要特征和显著标志，国家之间在经济、政治、文化、社会等方面的交流程度大幅提升，在加速科技进步和生产力发展的同时，也使得民族国家的利益面临着多元化的冲击和挑战，最终导致民族主义情绪的累积并在近年来显著抬头，右翼民粹主义、反全球化主义、贸易保护主义、本土主义等主张在全球，尤其是欧美国家泛起，引发国际局势紧张及日趋复杂化，对跨国经营的企业提出诸多新的挑战。公司同时持有境内外资产，虽然公司在 2025 年 7 月已完成瑞典 Sillex 控制权出售的交割，但公司目前仍持有瑞典 Sillex 股份，此外公司还涉及外币结算，日常涉及美元、欧元、瑞典克朗、日元、人民币等货币。因此，公司客观上面临着国际政治经济局势剧烈变化的风险，随之而来的还包括因汇率大幅波动对公司报表业绩（以人民币计算）产生较大影响的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理、环境和社会.....	61
第五节 重要事项	63
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 债券相关情况	75
第八节 财务报告	76

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有法定代表人签名的2026年半年度报告文本原件。

以上备查文件备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
赛微电子、公司、本公司	指	北京赛微电子股份有限公司，原名称“北京耐威科技股份有限公司”，原简称“耐威科技”
赛莱克斯国际	指	北京赛莱克斯国际科技有限公司，原名称为“北京瑞通芯源半导体科技有限公司”，系本公司全资子公司
赛莱克斯北京	指	赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司，原名称为“纳微矽磊国际科技（北京）有限公司”，报告期内系赛莱克斯国际控股子公司
赛莱克斯、瑞典 Silex	指	Silex Microsystems AB，注册在瑞典的公司，原为赛莱克斯国际间接控股的全资子公司，从事微机电系统（MEMS）产品工艺开发及代工生产业务，2025 年 7 月公司完成对瑞典 Silex 控制权的出售，瑞典 Silex 现为瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市公司
运通电子、GAE	指	运通电子有限公司（GLOBAL ACCESS ELECTRONICS LIMITED），为赛莱克斯国际 100% 持股的在香港设立的控股型公司
运通电子科技、GAETD	指	运通电子技术发展有限公司（GLOBAL ACCESS ELECTRONICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED），系运通电子全资子公司
微芯科技	指	北京微芯科技有限公司，系本公司全资子公司
极芯传感	指	北京极芯传感科技中心（有限合伙），系本公司控股合伙企业
中科赛微	指	北京中科赛微电子科技有限公司，系微芯科技控股子公司
赛积国际	指	北京赛积国际科技有限公司，原名称为“北京聚能海芯半导体制造有限公司”，系本公司全资子公司
海创微芯	指	北京海创微芯科技有限公司，系微芯科技控股子公司
Bure	指	Bure Equity AB，一家设立于瑞典的有限责任公司
光谷信息	指	武汉光谷信息技术股份有限公司，新三板挂牌公司，股份代码 430161，系本公司参股子公司
北斗产业基金	指	湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司参股合伙企业
国家集成电路基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
飞纳经纬	指	飞纳经纬科技（北京）有限公司，系本公司控股子公司
赛莱克斯深圳	指	赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司，系赛莱克斯国际控股子公司
海创微元	指	北京海创微元科技有限公司，系本公司控股子公司
赛微私募基金	指	北京赛微私募基金管理有限公司，原名称为“北京赛微股权投资管理有限公司”，系本公司参股子公司
阿基米德	指	阿基米德半导体（合肥）有限公司，系本公司参股子公司
展诚科技	指	青岛展诚科技有限公司，系本公司控股子公司
芯诚微电子	指	青岛芯诚微电子科技有限公司，系展诚科技全资子公司
宁芯微电子	指	南京宁芯微电子科技有限公司，系展诚科技全资子公司
北京传感基金	指	北京北工怀微传感科技股权投资基金（有限合伙），系本公司参股合伙企业
深圳智能传感基金	指	深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金合伙企业（有限合伙），系本公司参股合伙企业
芯东来	指	北京芯东来半导体科技有限公司，系微芯科技参股子公司
初芯微	指	杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙），系微芯科技参股合伙企业
ODI	指	境外直接投资（ODI,Overseas direct investment）是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动
FDI	指	外国直接投资（Foreign Direct Investment），是指一国的投资者将资本用于他国的生产或经营，并掌握一定经营控制权的投资行为
集成电路、IC	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块

		半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，整合器件制造商，又称为集成器件制造商，指自行进行芯片的设计、制造及封测，掌握芯片设计与生产制造工艺的半导体公司
MEMS、微机电系统	指	Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统，是指由基于 Micro-machining 技术制造的微传感芯片（或微执行芯片），和控制/处理芯片（ASIC）组成的微型电子机械系统，MEMS 能够将信息的获取、处理和执行集成在一起，是一种将微电子技术与微机械工程融合到一起、具有多功能的工业技术及相应的集成系统。MEMS 能够大幅度地提高系统的自动化、智能化水平
EDA	指	Electronic Design Automation，电子设计自动化，是指使用软件工具和方法对电子系统进行建模、设计、验证与实现的技术体系，面向超大规模集成电路（VLSI）及相关电子系统，将功能设计、逻辑综合、仿真验证、物理实现等环节进行流程化与自动化处理
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，已具备特定功能
吋	指	英寸
DRIE，深反应离子刻蚀	指	Deep Reactive Ion Etching，深反应离子刻蚀，基于氟基气体的高深宽比的干法硅刻蚀技术，同时使用物理与化学作用进行刻蚀。该技术不仅可将等离子体的产生和自偏压的产生分离，而且采用了刻蚀和钝化交替进行的工艺，实现对侧壁的保护，能够实现可控的侧向刻蚀，大大提高了刻蚀的各向异性特性，是超大规模集成电路工艺中很有发展前景的一种刻蚀方法
PE	指	Plasma Etching，等离子刻蚀，是指采用高频辉光放电反应，使反应气体激活成活性粒子，与被刻蚀材料进行反应形成挥发性反应物从而造成蚀刻
Dry Etching	指	干法刻蚀，刻蚀的一种工艺，是指用等离子体进行薄膜刻蚀的技术。干法刻蚀又分为物理性刻蚀、化学性刻蚀、物理化学性刻蚀
Wet Etching	指	湿法刻蚀，刻蚀的一种工艺，是指用液体化学试剂以化学方式去除硅片表面材料的技术
Sputtering	指	溅射，是指只发生在反应物和基体表面的反应。反应物吸附在基体上，然后第二种气体进入并与基体化学吸附成膜的一种反应方式
MOCVD	指	Metal-Organic Chemical Vapour Deposition，金属有机化学气相沉积，是在基板上生长半导体薄膜的一种技术
GaN	指	氮化镓，氮和镓的化合物，是一种新型半导体材料，适合于制造光电子、高温大功率器件和高频微波器件
控股股东、实际控制人	指	杨云春
元/万元	指	人民币元/万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
章程、公司章程	指	北京赛微电子股份有限公司章程
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	赛微电子	股票代码	300456
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京赛微电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	赛微电子		
公司的外文名称（如有）	Sai MicroElectronics Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	SMEI		
公司的法定代表人	杨云春		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐永文	孙玉华
联系地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼
电话	010-82252103	010-82251527
传真	010-59702066	010-59702066
电子信箱	ir@smeiic.com	ir@smeiic.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	178,373,115.82	570,095,783.13	-68.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,702,213,961.27	-650,333.36	415,612.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-379,251,813.20	-19,465,657.87	-1,848.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,503,842.57	165,802,553.59	-166.04%
基本每股收益（元/股）	3.6905	-0.0009	410,155.56%
稀释每股收益（元/股）	3.6905	-0.0009	410,155.56%
加权平均净资产收益率	34.07%	-0.01%	34.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,597,205,730.48	8,939,422,428.40	29.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,039,863,671.86	6,734,386,456.42	34.23%

注：上述表格中归属于上市公司股东的净利润与基本每股收益、稀释每股收益本报告期比上年同期增减不一致，系因小数点四舍五入导致；此外本半年报表格中如出现加总数与各明细数之和在尾数上存在差异亦为小数点四舍五入所致。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	733,958,288.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,493,558.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产	2,577,492,322.41	

生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2, 103. 77	
减：所得税影响额	236, 888, 660. 98	
少数股东权益影响额（税后）	1, 591, 837. 57	
合计	3, 081, 465, 774. 47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司是以 MEMS 纯代工模式为理念、特色工艺和制造能力为基础、国际化运营为侧重的半导体专业服务厂商。公司通过长期积累掌握 MEMS 制造核心工艺技术，并努力向硅光、射频、模拟等特色工艺技术进行延伸拓展；公司同时向客户提供 IC 设计服务及 EDA 工具服务，MEMS 等特色工艺开发、集成、晶圆制造及封装测试服务。报告期内，公司服务客户包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、高频通信、ICT 等厂商以及各细分行业的领先企业和众多知名芯片设计公司，涉及代工和服务芯片品类范围覆盖了通信计算、生物医药、工业汽车、消费电子等诸多应用领域。公司已初步构建 MEMS 封装测试能力，前瞻性布局 IC 设计服务及 EDA 工具服务，致力于为客户提供从设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造到封装测试的一站式综合服务，并将着重立足本土，拓展国际化运营。

报告期内，公司从事的主要业务为 MEMS 纯代工、IC 设计服务，以及基于存量设备继续开展部分半导体设备业务。同时，公司围绕半导体主业持续开展产业投资布局，对实体企业、产业基金进行参股型投资。

报告期内，为公司贡献日常经营业绩的业务主要为 MEMS 纯代工，IC 设计服务。公司 MEMS 纯代工与 IC 设计服务面向各芯片设计企业客户；区别于芯片设计公司的产品销售逻辑，公司不涉足自有芯片品牌的研发和设计，不通过销售芯片产品实现收入，而是形成以 MEMS 纯代工服务能力为核心的业务定位，有效保护客户核心 IP 及设计方案，保障与客户合作关系的纯粹性与稳定性。

1、MEMS 纯代工业务

公司 MEMS 纯代工包括工艺开发与晶圆制造。MEMS 工艺开发是指根据客户提供的芯片设计方案，以满足产品性能、实现产品“可生产性”以及平衡经济效益为目标，利用工艺技术储备及项目开发经验，进行产品制造工艺流程的开发，为客户提供定制的产品制造流程。MEMS 晶圆制造是指在完成 MEMS 芯片的工艺开发，实现产品设计固化、生产流程固化后，为客户提供批量晶圆制造服务。

2、IC 设计服务业务

公司 IC 设计服务业务，是指以芯片设计公司为主的客户在提出芯片具体功能要求后，公司协助其进行相关产品定义、架构设计、工艺选型、IP 选型、电路设计、仿真、物理设计以及量产流片等相关设计服务工作。同时，基于客户需求，公司也开始向客户少量提供 EDA 软件开发和技术支持服务。

3、半导体设备业务

近年来，为应对国际政治经济环境可能发生的极端变化，公司旗下子公司曾从境外战略性采购了多批次半导体设备进行储备使用，根据公司业务发展的实际需要及环境变化，开展了部分与半导体设备相关的销售业务，在服务集团旗下 FAB 产线设备使用需要的同时，也根据市场需求服务于其他半导体制造企业，对外销售半导体设备。报告期内，公司基于存量继续开展部分半导体设备业务。

（二）经营模式

公司 MEMS 纯代工业务以成熟商业化运营的 MEMS 产线为基础，以专业技术及生产团队、核心专利技术、核心工艺设备、丰富的工艺开发项目经验为条件，通过为客户开发并确定特定 MEMS 芯片的工艺及制造流程获得工艺开发收入，通过以特定 MEMS 工艺为客户批量制造不同类别的芯片晶圆获得晶圆制造收入。

公司 IC 设计服务业务是公司依托自身积累的技术实力、丰富的项目经验及定制开发能力，为芯片设计公司为主的客户提供以架构设计、工艺及 IP 选型、前端设计、物理设计、Memory 定制、IO/StdCell 定制优化为主的 IC 设计服务获得收入，此外公司在寄生参数提取 EDA 软件研发的同时向客户提供寄生参数提取与分析相关技术支持。

公司半导体设备业务是基于主要采购的二手半导体设备，通过确保设备的可靠性和专业的维修保养能力获得设备销售收入。

（三）主要业绩驱动因素

随着集成电路终端应用场景多样性的不断增加，物联网生态系统的逐步发展落地，集成电路产业链分工不断细化，芯片设计复杂度较以往大幅提升，MEMS 智能传感设备应用越来越广泛，而通信计算、生物医疗、工业汽车、消费电子等终端应用领域对以 MEMS 芯片为核心的智能传感设备需求不断增加，带动着 MEMS 纯代工制造市场空间也随之增长；此外，包括但不限于 MEMS 芯片设计公司在内的众多芯片设计公司对 IC 设计服务的需求旺盛，IC 设计服务企业已成为连接芯片设计企业与制造企业的重要桥梁。

公司控股子公司赛莱克斯北京（截至本报告披露之日已为公司全资子公司，下同）是国内领先的纯 MEMS 代工企业之一，正在持续扩大晶圆品类及客户应用领域。截至报告期末，赛莱克斯北京 MEMS 量产线已实现硅麦克风、BAW 滤波器、微振镜、超高频器件的量产，正在进行小批量试产气体、生物芯片、惯性加速度计、惯性测量单元（IMU）、温湿度、MEMS 硅晶振、MEMS-OCs 等 MEMS 器件，同时对于压力、硅光子、3D 硅电容、超声波换能器、喷墨打印头、磁性传感器等 MEMS 芯片、器件及模块，正积极从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进。公司 MEMS 晶圆产品的终端应用涵盖通信计算、生物医疗、工业汽车、消费电子等领域。

公司控股子公司展诚科技拥有专业突出、经验丰富的 IC 设计工程师团队及 EDA 软件开发团队，向诸多全球芯片设计公司提供多样化的 IC 设计服务。报告期内，展诚科技不断提升工艺节点覆盖技术能力，拓宽服务芯片类别，延伸终端应用领域。展诚科技 IC 设计服务覆盖 90/55/40/28/22/16/14/7/5nm 等主流及先进工艺节点，服务芯片种类包括模拟芯片中的转换芯片、接口芯片、RF 芯片、时钟芯片，以及数字芯片中的处理器 CPU、控制器 MCU、数字信号处理 DSP、AI 相关芯片等，所服务的芯片终端应用也在不断延伸。

（四）所属行业发展情况

1、集成电路行业的整体发展情况、行业政策

集成电路是信息处理和计算的基础，在科技革命和产业变革中发挥着关键作用。集成电路行业处于电子产业链的上游，其发展速度与全球经济增速正相关，呈现出周期性的波动趋势。2026 年上半年集成电路行业呈现全球市场稳步复苏、AI 与先进工艺双轮驱动增长的态势。根据国际权威研究机构 Gartner 初步统计数据显示，2025 年全球半导体市场营收总额达 7,930 亿美元，同比增长 21%。其中，人工智能（AI）相关半导体（含处理器、高带宽内存 HBM 及网络组件）成为核心增长引擎，贡献了近三分之一的市场销售额；与此同时，AI 基础设施支出持续攀升，预计到 2026 年将突破 1.3 万亿美元，进一步为行业增长注入动力。

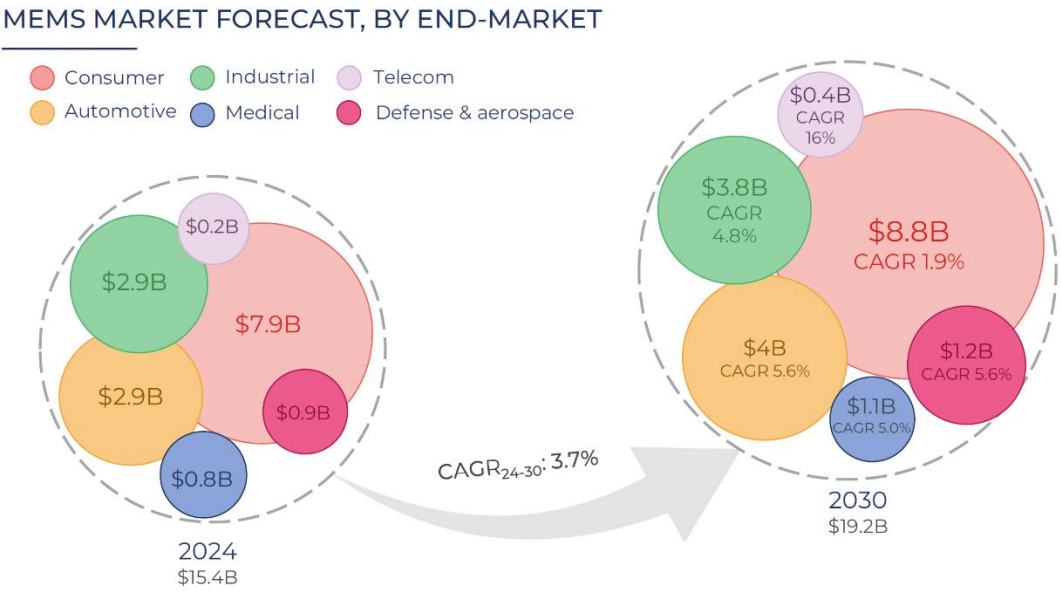
从中长期看，集成电路是一个繁荣向好的行业。近年来，国家大力支持集成电路行业创新发展。以《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》为统领，中国形成对集成电路产业发展的总体方向指引，并在此基础上出台了一系列支持集成电路产业发展的财税政策。如北京市政府在《2025 年市政府工作报告重点任务清单》中提出：大力推进集成电路、人工智能等九大专项攻关行动，着力提升共性技术供给能力，在人工智能、商业航天等领域突破一批关键核心技术。如 2023 年中央经济工作会议精神指出：“要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。”2025 年 7 月，工信部等七部门在《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》中提出：“创新基于光、电、磁、超声、化学的新型脑信号传感器，突破单模态信号局限，提高脑信号感知能力”等。2026 年初“十五五”规划提出：“完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。突出国家战略需求，部署实施一批国家重大科技任务。加强基础研究战略性、前瞻性、体系化布局，提高基础研究投入比重，加大长期稳定支持。强化科学研究、技术开发原始创新导向，优化有利于原创性、颠覆性创新的环境，产出更多标志性原创成果。”因此，基于集成电路行业整体发展长期向好的态势以及国家的长期战略政策支持，公司业务的进一步发展将继续拥有良好的产业发展及政策支持环境。

全球集成电路行业整体发展前景广阔、长期向好，AI 芯片、HBM 存储、先进封装正成为核心增长引擎，此外集成电路行业分工逐步细化，技术上也由单纯追逐先进制程转向 Chiplet、3D 堆叠、异构集成等系统集成创新。包含公司 MEMS 纯代工和 IC 设计服务在内的集成电路行业，成长预期明确，具备高确定性发展前景。

(1) MEMS 行业发展情况、行业政策

MEMS 是微电路和微机械按功能要求在芯片上的一种集成，基于光刻、腐蚀等传统半导体技术，融入超精密机械加工，并结合力学、化学、光学等学科知识和技术基础，使得一个毫米或微米级的 MEMS 具备精确而完整的机械、化学、光学等特性结构。MEMS 行业系在集成电路行业不断发展的背景下，传统集成电路无法持续地满足终端应用领域日渐变化的需求而成长起来的。随着微电子学、微机械学以及其他基础自然科学学科的相互融合，诞生了以集成电路工艺为基础，结合体微加工等技术打造的新型芯片，而终端应用市场的扩张，使得 MEMS 应用越来越广泛，产业规模日渐扩大，成为集成电路行业一个日趋活跃的新分支。

随着万物互联与人工智能的兴起，作为集成电路细分行业的 MEMS 获得了更广阔的市场空间和业务机会。传统的传感器、执行器和无源结构器件目前正逐步被替代，这使 MEMS 技术的渗透率得以进一步提高。根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球 MEMS 市场规模将由 2024 年的 154 亿美元增长至 2030 年的 192 亿美元，CAGR（年均复合增长率）为 3.7%。



图片来源：Yole Development

MEMS 属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业，是当前国际竞争和科技攻关的前沿热点。国家“十四五”规划纲要提出：“打造数字经济新优势，加强关键数字技术创新应用，聚焦传感器等关键领域。”与此同时，以高水平现代化生产力（新类型、新结构、高技术水平、高质量、高效率、可持续的生产力）为衡量标准，以“领域新、技术含量高，依靠创新驱动”为评判关键，MEMS 属于新质生产力的范畴，将助力推动相关产业的发展，增强产业创新能力和国际竞争力。2026 年初，国家“十五五”规划又进一步提出：“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力。”“深入推进数字中国建设提升数智化发展水平。”近年来，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，从关键技术研发、产业应用等角度大力支持促进行业发展，为行业的发展提供了良好的政策环境。

集成电路及 MEMS 行业部分相关政策			
发布时间	政策名称	发布单位	主要内容
2023. 1	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	工信部等六部门	发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，集成多维度信息采集能力的高端传感器、新型 MEMS 传感器和智能传感器。

2023. 1	《“机器人+”应用行动实施方案》	工信部等十七部门	推动机器人技术与 5G、云计算、智能传感等新技术融合，实现自主导航、自动避障、人机交互、语音及视觉识别、数据分析等功能。
2023. 12	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	国家发改委	推动制造业高端化、智能化、绿色化。以下内容列为鼓励类技术、装备及产品： 集成电路：线宽小于 0.25 微米（含）的特色工艺集成电路生产；传感器封装（MEMS）、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试； 传感器：微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、可加密传感器等具有无线通信功能的低功耗智能传感器。
2024. 1	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工信部等七部门	突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用；加快突破 CPU 芯片、集群低时延互连网络、异构资源管理等技术，建设超大规模智算中心，满足大模型迭代训练和应用推理需求。
2024. 3	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	国务院	促进产业高端化、智能化、绿色化发展；推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造；开展汽车以旧换新；鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴；积极培育智能家居等新型消费。
2024. 5	《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》	国家发改委等四部门	加快推动城市建筑、道路桥梁、园林绿地、地下管廊、水利水务、燃气热力、环境卫生等公共设施数字化改造、智能化运营，统筹部署泛在韧性的城市智能感知终端；推进城市智能基础设施与智能网联汽车协同发展。
2024. 12	《关于深化养老服务改革发展的意见》	中共中央、国务院	研究设立养老服务相关国家科技重大项目，重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。深化全国智慧健康养老应用示范，推广智能化家居和智慧健康产品，探索开展居家养老安全风险预警和防范服务。
2025. 8	《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	国务院	为深入实施“人工智能+”行动，推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态。
2025. 9	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	工信部、市场监督管理总局	加强电子信息领域制造业创新中心等创新平台建设，强化行业关键共性技术供给。通过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新。
2026. 1	《关于进一步提升北京市中试服务能力促进科技创新和产业创新融合发展的若干措施》	北京市发改委、北京市经信局、北京市科委等	提升中试平台全链条服务能力。引导技术创新类、成果转化与产业化类创新平台拓展技术熟化、工程化放大和可靠性验证功能。鼓励平台以中试功能为基础，加快形成覆盖技术挖掘、技术熟化、产品试制、工艺创新、试验验证、检验检测、市场对接、资金筹集等功能的产业链全链条服务能力。支持市级重大中试平台、中试产线、中试零号工厂提升产品创制能力。
2026. 3	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	全国人民代表大会、国务院	加强原始创新和关键核心技术攻关。坚持技术驱动和需求拉动相结合、锻长板和补短板相结合，完善新型举国体制，推动产出更多标志性原创成果。打好关键核心技术攻坚战。强化战略前沿领域科技布局。全面提升基础研究水平。 强化企业科技创新主体地位。落实企业在技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化应用中的主体地位，促进创新链产业链资金链人才链深度融合。推动创新资源向企业集聚。加强企业主导的产学研融通创新。完善促进企业创新的政策体系。

（2）IC 设计服务行业发展情况、行业政策

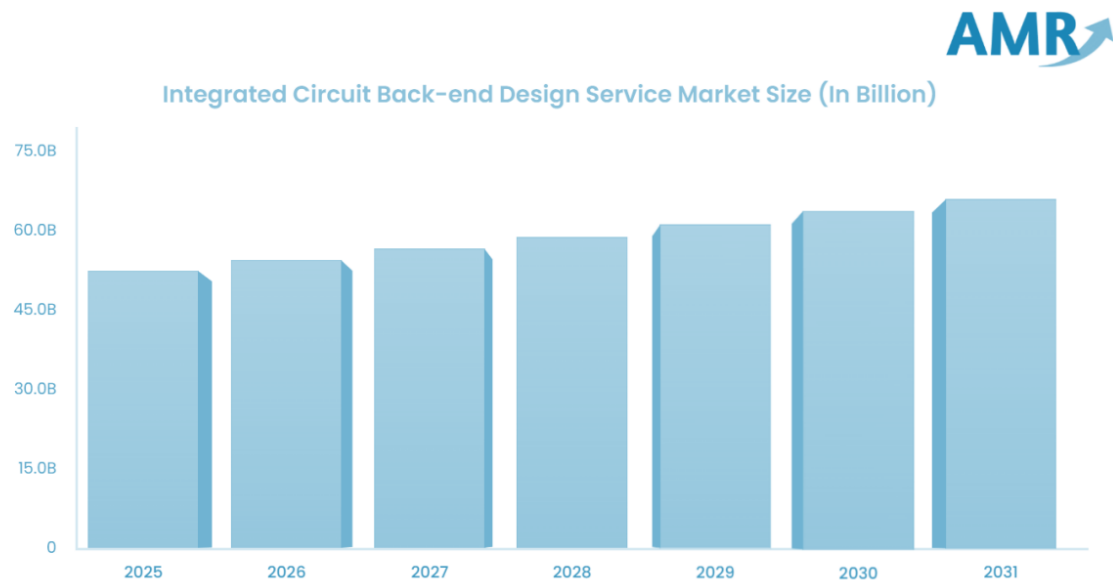
随着芯片集成度的不断提升，集成电路行业进入后摩尔时代，芯片性能单纯依靠制程微缩进行提升已面临瓶颈，产业发展也从早期的 IDM 一体化模式逐步走向高度专业化分工，IC 设计服务与 EDA 软件开发正是在这一产业演进过程中应

运而生的。当下，芯片设计涉及前端设计及验证、逻辑综合、时序分析、物理实现、版图验证、功耗优化、可靠性设计等大量复杂环节，仅仅依靠芯片设计企业自身团队已难以覆盖全部流程，为提升设计效率、降低研发成本、缩短产品上市周期，专业化的 IC 设计服务逐步从产业链中独立出来，成为连接芯片设计与制造的关键环节和重要能力补充。与此同时，为实现芯片自动化设计、逻辑仿真、电路综合、布局布线、寄生参数提取、设计规则检查、物理验证等工作，以计算机辅助设计（CAD）为基础的电子设计自动化工具逐步发展，最终形成了 EDA 软件开发行业。

在全球化集成电路蓬勃发展过程中，随着芯片制程不断精进、系统复杂度呈指数级提升，芯片研发已演变为高度专业化、知识密集型的独立赛道——IC 设计服务与 EDA 工具服务由此成为产业链不可或缺的行业。IC 设计服务是连接技术、工艺与产品的桥梁，大幅降低了芯片研发门槛、缩短周期、控制成本与风险；EDA 是芯片设计的工业软件，决定设计效率与上限，二者共同支撑芯片从算法到流片的全流程实现，是集成电路芯片设计产业创新效率的关键保障。当前，IC 设计服务行业凭借全流程技术解决方案与定制化服务能力，深度渗透通信计算、消费电子、工业汽车等多个核心领域；而国内 EDA 市场虽然仍由新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）和西门子（Siemens）EDA 三大巨头主导，但国产力量正加速突围态势，致力于实现国产替代。

根据 Archive Market Research’s Growth 数据，全球集成电路后端设计服务市场规模 2025 年市场规模约为 524 亿美元，到 2031 年市场规模将增长至约 660 亿美元。其中，亚太地区的集成电路后端设计服务市场正经历显著增长，市场份额占比约 20%。

集成电路后端设计服务市场规模（十亿美元）

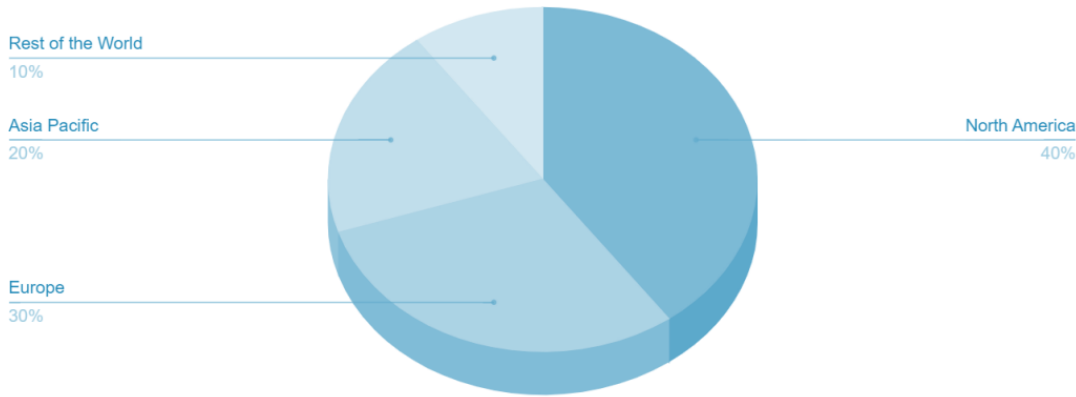


图片来源：Archive Market Research’s Growth

集成电路后端设计服务区域市场份额



Integrated Circuit Back-end Design Service Regional Market Share



图片来源：Archive Market Research’s Growth

一直以来，在 IC 设计服务与 EDA 软件开发的先进制程和关键技术领域，国外大型 IC 设计服务企业都居于主导地位，国内企业正奋力追赶。近年来，国内发布了一系列围绕 IC 设计服务与 EDA 软件开发行业的支持政策，重点以《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》为基础，持续强化顶层设计，推动国产 IC 设计服务行业与 EDA 国产替代。随着自主可控战略深入推进、下游算力与智能终端需求持续增长，叠加全方位政策红利，IC 设计服务及 EDA 软件开发行业正处在高速发展期，未来前景广阔，国产替代空间巨大。

公司当前业务以 MEMS 纯代工为核心，并兼具 IC 设计服务及 EDA 工具服务，基于两项细分行业整体发展长期向好的态势以及国家的战略政策支持，公司业务的发展将继续拥有良好的产业空间及政策支持环境。报告期内，公司及旗下控股子公司持续推动业务未来持续向好发展。

综上所述，公司主要业务所处行业呈现朝气蓬勃的发展趋势，拥有良好政策环境、广阔发展前景与巨大的发展潜力。公司将积极把握行业趋势，整合各项资源，力争实现业务的快速发展。

（五）所属行业的周期性特点

集成电路行业处于电子产业链的上游，其发展受到下游终端应用的深刻影响，其行业发展速度与全球经济增速正相关，呈现出周期性的波动趋势。近年来，随着行业分工的深化，芯片设计、制造及封测各环节专业化程度显著提高，行业整体能够更加准确的把握需求变动趋势、更有计划地控制产能规模及资本性支出、更加及时地对市场变化做出反应及修正；同时，集成电路产业在社会其他行业的渗透日益深入，终端消费群体基数庞大，一定程度上抵消了经济周期的影响，使集成电路行业整体的周期性波动日趋平滑。MEMS 纯代工、IC 设计服务行业作为基于集成电路技术演化而来的新兴子行业，其周期性与集成电路行业相似；同时由于 MEMS 技术具有替代性、前沿性、创造性，IC 设计服务也可大幅提升行业整体效率，与 MEMS 相关的技术、产品的更新和 IC 设计服务以及 EDA 软件开发的技术迭代，将为下游市场注入新的活力，并引导下游突破现有瓶颈限制、持续激发创新、拓宽终端应用范围，推动社会经济有机增长，故其行业周期性波动风险可得到有效降低。

公司 MEMS 纯代工、IC 设计服务必然受到宏观经济周期的影响，但由于终端各应用领域行业正处于快速蓬勃发展阶段，且境内企业正逐步提升自身技术进行国产替代，智能传感是推动全球经济发展的新兴力量，MEMS 更是技术变更与竞争的新兴领域，IC 设计服务亦是集成电路产业链的关键环节。因此在国产化替代、技术升级与生态构建多重驱动下的当

前阶段，集成电路行业以及公司所在的 MEMS 和 IC 设计服务行业，更多受自身发展阶段的影响，受宏观经济周期的直接影响相对较小。

（六）公司所处的行业地位

MEMS 业务方面，公司控股子公司赛莱克斯北京已投入运营并持续推动产能爬坡。赛莱克斯北京是国内领先的纯 MEMS 代工企业之一，在瑞典 Sillex 控制权转让后，公司集中资源重点发展并深化运营北京亦庄 MEMS 量产线，随着赛莱克斯北京产能的持续爬坡，公司有望在纯 MEMS 代工领域仍保持重要地位。瑞典 Sillex 是全球领先的纯 MEMS 代工企业，服务于全球各领域巨头厂商，且正在持续扩充产能；2026 年 5 月 7 日，瑞典 Sillex 成功在瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市交易，股票代码 SILEX，并于 2026 年 7 月收购美国 Onsemi 晶圆厂。截至本公告披露日，公司直接持有瑞典 Sillex 9.90%普通股，并已按约定将瑞典 Sillex 上市增发普通股后 19.10%的普通股转让给 Bure，该 19.10%普通股将在瑞典 Sillex 首次公开募股锁定期承诺届满至公司与 Bure 双方约定时间内，由公司决策后，指令 Bure 协助择机出售，相关收益归公司所有。根据 Yole Development 的统计数据，2012 年至今，瑞典 Sillex 在全球 MEMS 代工厂营收排名中一直位居前五，与意法半导体（ST Microelectronics）、TELEDYNE、台积电（TSMC）、索尼（SONY）等厂商持续竞争，2019-2024 年则在全球 MEMS 纯代工厂商中位居第一。

IC 设计服务业务方面，公司控股子公司展诚科技是国内较早从事集成电路设计服务细分领域的头部公司，累计服务多家行业知名企业，在集成电路设计服务领域占据国内领先地位。报告期内，公司控股子公司展诚科技还在 EDA 软件开发方面主要从事寄生参数提取 EDA 软件研发，展诚科技研发的寄生参数提取 EDA 主要用于精确还原集成电路纳米尺寸下真实复杂的物理模型，是保证工艺研发和芯片设计成功的关键环节。展诚科技先后荣获国家重点集成电路设计企业、国家专精特新“重点小巨人”企业、山东省“瞪羚”企业、山东省电子信息行业优秀企业、山东省软件产业高质量发展重点项目等资质荣誉。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

（一）报告期内集成电路业务情况

1、MEMS 纯代工业务

（1）产线基本情况

报告期内，公司在北京亦庄拥有一座已建成运营、具备规模产能的 8 英寸 MEMS 晶圆工厂。北京亦庄 MEMS 量产线将继续适时有序的推动产能从当前的 1.5 万片/月向 3 万片/月产能的分阶段针对性扩充，并大力扩大晶圆类别及客户领域；此外，公司正稳步推进怀柔 MEMS 中试线的建设工作。

公司北京亦庄 MEMS 量产线的基本情况如下：

晶圆产线	工艺制程	总体产能（片晶圆/年）	期间产能（片晶圆）	产能利用率	生产良率
北京亦庄 8 英寸 MEMS 量产线	0.25um-1um	180,000	90,000	29.74%	81.88%

注：1、北京亦庄 8 英寸 MEMS 量产线的定位属于规模量产线，产能处于持续扩充状态，已实现产能 15,000 片晶圆/月，按此静态推算，公司 2026 年总体产能 180,000 片/年。由于产线仍处于产能爬坡阶段，面向客户需求产品的工艺开发、产品验证及批量生产需要经历一个客观的爬坡过程，本报告期公司已进入量产阶段的晶圆品类仍相对较少，大部分仍处于工艺开发、产品验证或风险试产阶段。北京亦庄 8 英寸 MEMS 量产线产能利用率及生产良率均受到工艺开发业务的影响，工艺开发对产线的产能利用率天然低于晶圆制造业务，且产线与客户双方对开发试验阶段生产良率的容忍度一般较高，故综合导致报告期内北京亦庄 8 英寸 MEMS 量产线产能利用率处于较低水平，生产良率处于正常区间。由于北京亦庄 MEMS 量产线在持续覆盖不同的 MEMS 产品，而不同 MEMS 晶圆对材料及工艺存在差异化需求，北京亦庄 MEMS 量产线需要根据客户要求针对性地添配设备，也将促进产能爬坡持续推进。

2、由于 MEMS 属于集成电路的特色工艺分支，考验制造厂商水平的主要因素是工艺、三维结构与功能，而不是单纯地追求细线宽线距（二维）；此外，由于 MEMS 晶圆常常是 2 个以上的晶圆键合在一起，因此上表产能数据中的单片“晶圆”数在多数情况下为复合晶圆的个数。即一个 MEMS “晶圆”所蕴含的硅（或玻璃）晶圆数相当于多个（2 个以上）普通 CMOS 晶圆，大幅增加了制造的难度和复杂性，“晶圆”生产数量的数值也少于一般集成电路行业。

3、单片晶圆可以制造的 MEMS 芯片颗数因产品不同而存在巨大差异，平均而言每张 8 英寸晶圆可以产出大约为 6 英寸晶圆 2 倍数量的芯片，每张 12 英寸晶圆可以产出大约为 8 英寸晶圆 2.25 倍数量的芯片。

报告期内，公司在北京亦庄拥有一条 MEMS 先进封装测试产线，旨在面向各类 MEMS 器件及特色工艺器件提供封装测试服务。

由于 MEMS 芯片种类繁多、结构各异、应用多样、场景复杂，故 MEMS 先进封装测试比传统封装测试要更加复杂。三维封装、晶圆级封装、硅通孔、晶圆级测试、器件晶圆级动态模拟测试等先进封装和测试技术的应用，能够推动 MEMS 芯片朝着高性能、低功耗、微型化、高集成、高可靠性的趋势发展，是 MEMS 芯片设计与应用实现的必然要求。

公司 MEMS 先进封装测试产线在 2025 年末完成建设，目前处于工艺研发及生产准备阶段。

(2) 特色生产工艺情况

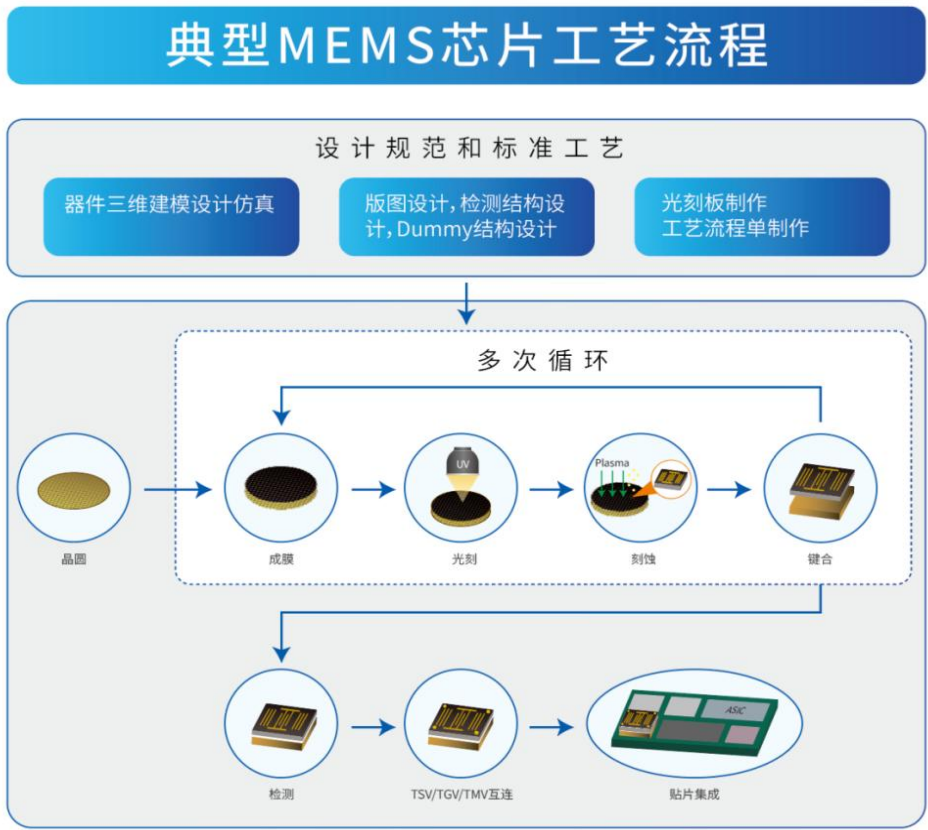
MEMS 属于集成电路行业中的特色工艺。公司 MEMS 业务经营采用“工艺开发+代工生产”的模式。“工艺开发（NRE）”模式，即 MEMS 代工厂商根据客户提供的芯片设计方案，以满足产品性能、实现产品“可生产性”以及平衡经济效益为目标，利用工艺技术储备及项目开发经验，进行产品制造工艺流程的开发，为客户提供定制的产品制造流程；“代工生产（Foundry）”模式则是 MEMS 代工厂商在完成 MEMS 产品的工艺开发，实现产品设计固化、生产流程固化后，为客户提供 MEMS 晶圆的批量代工生产服务。

MEMS 工艺开发过程示意图

结构化的工艺集成模块



图片来源：赛微电子



图片来源：赛微电子

（3）在建晶圆厂或产线情况

截至报告期末，公司北京亦庄 MEMS 量产线最新已实现 1.5 万片/月产能，并在未来将保持产能的分阶段针对性逐步扩充；此外，公司正筹备建立怀柔 MEMS 中试线。报告期内，北京亦庄 MEMS 量产线已实现硅麦克风、BAW 滤波器、微振镜、超高频器件的量产，正在进行小批量试产气体、生物芯片、惯性加速度计、惯性测量单元（IMU）、温湿度、MEMS 硅晶振、MEMS-OCS 等 MEMS 器件，同时对于压力、硅光子、3D 硅电容、超声波换能器、喷墨打印头、磁性传感器等 MEMS 芯片、器件及模块，正积极从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进。公司 MEMS 封装测试产线于 2025 年底实现通线，目前尚处于起步阶段。

2、IC 设计服务业务

公司围绕半导体制造积极布局产业生态及相关业务，于 2025 年 9 月完成对展诚科技 56.24%股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00%股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务，同时公司少量从事寄生参数提取 EDA 软件研发并向客户提供寄生参数提取与分析相关技术支持。报告期内，公司持续加强对控股子公司展诚科技及所属 IC 设计服务业务的融合，并对其积极赋能，2026 年上半年公司 IC 设计服务业务呈现稳健发展势头。

（1）服务应用情况

公司的 IC 设计服务业务区别于芯片设计公司的产品销售逻辑，并不拥有自有芯片品牌产品，亦不通过销售芯片产品实现收入，而是通过提供技术服务、解决方案或其他非芯片产品销售方式，向芯片设计公司为主的客户提供服务。

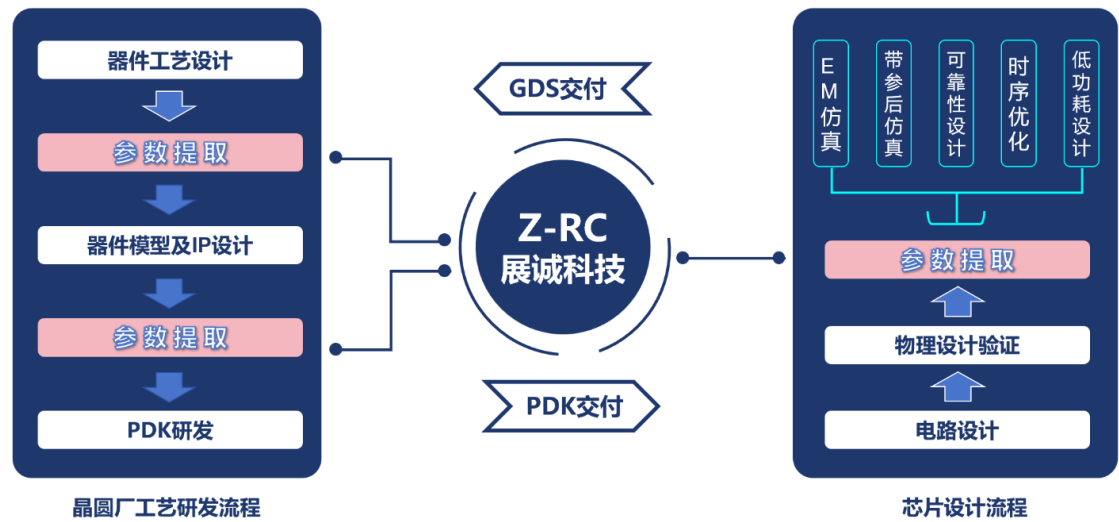
公司面向客户提供 IC 设计服务示意图



图片来源：展诚科技

此外，公司在 EDA 软件开发方面主要从事寄生参数提取 EDA 软件研发，并向客户提供寄生参数提取与分析相关技术支持。

公司 EDA 寄生参数提取流程应用示意图



图片来源：展诚科技

(2) 业务模式情况

根据协作方式、工作地点等的不同，公司通过子公司展诚科技向芯片设计公司为主的客户提供服务主要有 off-site、on-site、odc 三种模式。

展诚科技业务模式介绍				
服务模式	模式优势	重点关注	适用项目	展诚收入占比
off-site 模式	灵活高效、不受地域限制、无需驻场、管理效率高。	严格项目管理和保障信息安全，确保沟通中数据保密和顺畅。	标准化程度高、交付周期要求严格、需要快速内部协同的项目。	29%
on-site 模式	深度协同、沟通效率高、响应速度快、信息安全。	总体成本管控。	数据安全要求高、客户高频沟通、项目周期长、持续迭代优化的项目。	66%

odc 模式	成本可控、团队专属化、技术与流程适配度高，核心数据与知识产权保密性好。	需要场地搭建前置性投入，高端人才供应稀缺，区域商业环境融合事宜的考量。	长期持续性需求、注重长期成本控制和数据安全的项目。	5%
--------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----

(二) 所属细分领域主流技术水平、市场需求变化及对公司的影响

1、MEMS 纯代工

MEMS 的生产制造使用了包括体微机械加工和表面微机械加工在内的微细加工技术，并结合沉积、光刻、键合、刻蚀等集成电路工艺，在硅片上实现微型机械三维结构的构建，在保留器件机械性能的基础上大幅缩减了机械体积、降低了能耗并提高了机械可靠性，同时可批量生产，大大降低生产成本。MEMS 技术发展正受到多重因素的推动，包括成本、尺寸、性能、功率、稳定、智能及连接性。成本的降低有助于实现新应用场景，小型化的 MEMS 器件有助于系统整合，并支持增强现实（AR）等新应用的发展。在性能方面，高准确性和低噪声是关键指标，直接影响 MEMS 传感器的可靠性和效果。功率管理是确保 MEMS 技术能够持续运行的重要因素。MEMS 器件还需要对环境条件具有稳定性，能够抵抗冲击、振动、湿度、压力等环境因素。此外，传感器融合、集成数据处理（DSP）、嵌入式软件和算法、边缘 AI（包括推理和最终训练）以及多种通信接口（如 I2C、I3C、SPI、MIPI、LoRa、BLE）都是提升 MEMS 智能和连接性的关键技术。

在通信计算领域，除 MEMS 光开关在传输领域的成熟应用外，数据中心及 AI 超级计算机对硅光技术的采用，促进了 MEMS-OCS（Optical Circuit Switch，光链路交换器件）的兴起，高频通信则对基于 MEMS 工艺制造的 BAW 滤波器提出了更多的应用需求；在生物医药领域，由于试验、诊断、监测、给药设备及载体的微型化以及生物与机械之间的融合探索，MEMS 器件在医疗领域的需求持续增加；在工业汽车领域，受高端工业装备对精密传感及执行需求以及自动驾驶和高级驾驶辅助系统（ADAS）功能集成的推动，MEMS 传感器件的价值量及渗透率不断增长；在消费电子领域，随着智能手机、可穿戴设备、AR/VR/MR 等消费终端的发展，对于设备的智能化、精准化及交互性提出了丰富的需求，促进了 MEMS 传感器件的应用。整体而言，MEMS 行业拥有来源丰富、活跃变化的市场需求。

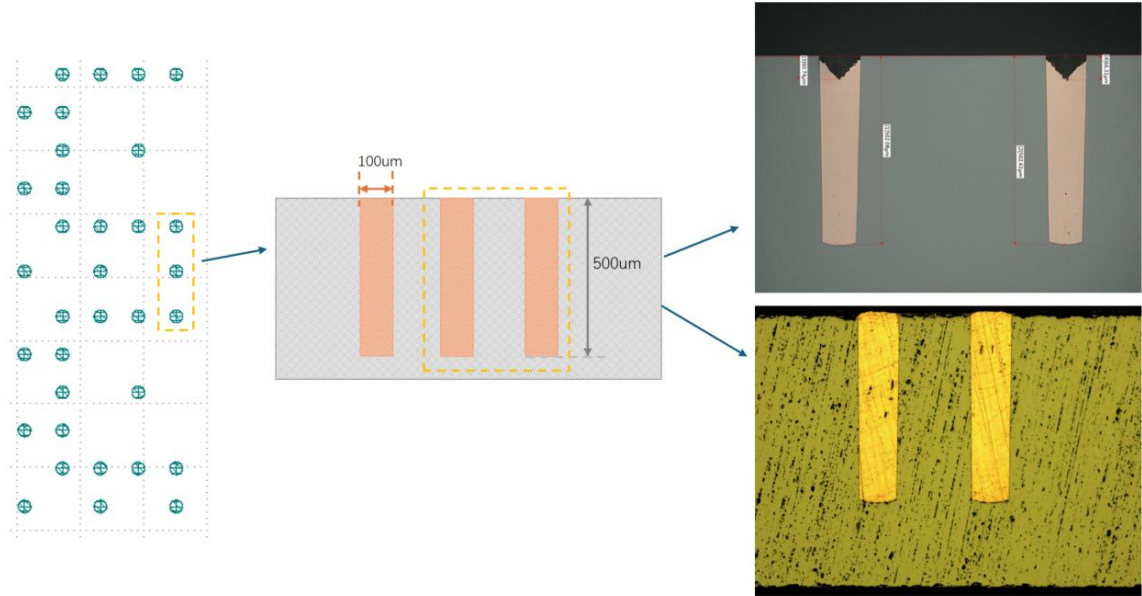
公司拥有覆盖 MEMS 领域的全面工艺技术储备，关键技术已经成熟并经过多年的生产检验，TSV、TGV、DRIE 及晶圆键合等技术模块行业领先。报告期内，公司的核心工艺及技术水平状况如下：

公司的核心工艺及技术水平状况			
核心工艺模块	对应的生产环节	效果/作用	技术水平
硅通孔技术 SilVia®TSV	芯片互连、CMOS-MEMS 集成、先进封装	在先进的三维集成电路中实现多层芯片之间的互联，能够在三维方向使得堆叠度最大而外形尺寸最小，提升芯片速度和低功耗性能。	国内领先
硅通孔金属层 MetVia®TSV			国内领先
玻璃通孔 MetVia®TGV			国内领先
深反应离子刻蚀 DRIE	刻蚀	在硅衬底上刻蚀深沟槽和深孔。	国内领先
晶圆键合 Wafer Bonding	键合与退火	将晶圆相互结合，使表面原子相互反应，产生共价键合，让其表面间的键合能达到一定强度，使晶片间无需媒介物而纯由原子键结为一体。	国内领先
DUV 光刻	光刻	最小分辨率低至 0.2 微米，对准精度小于 50 纳米。	相对领先
压电材料 Piezo material	材料应用	利用压电材料受压力作用在两端面间出现电压的特性，实现机械能和电能的互相转换。	国内领先
聚合物材料 Polymer	材料应用	聚合物增强了断裂强度、具有低杨氏模量、延长断裂时间和相对低成本，其具有惰性和生物相容的特点，适于生物和化学应用。	相对领先
磁阻材料	材料应用	利用隧道磁阻效应，实现磁场，电流的非接触量测，可应用于转速控制，编码等相关场景。	国内领先
无铅焊锡电镀 Plating solders	电镀	利用电解作用使金属或其他材料的表面附着一层金属膜，从而防止腐蚀，并提高耐磨性、导电性、反光性等。	相对领先
封帽 Capping	圆片封盖密封	形成机械结构所需的真空空间并保护晶圆避免受到机械刮伤、高温破坏。	相对领先

离子注入 Implant	硅材料改性	采用高能量离子束注入硅表面一定深度，并进行退火扩散处理，使硅表面材料改性，达到器件需要的性能。	相对领先
--------------	-------	---	------

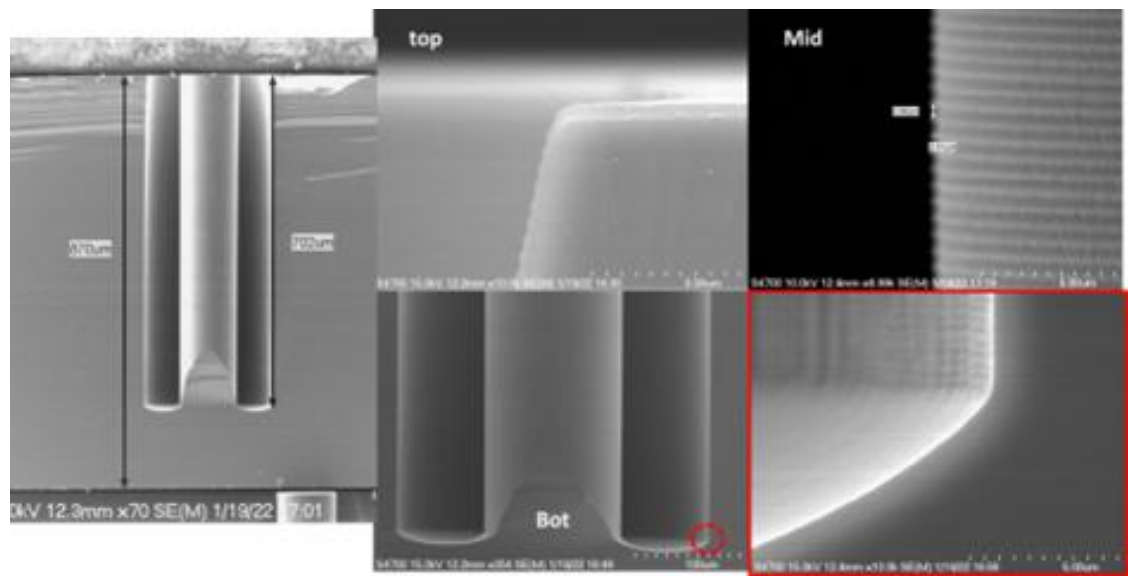
由于 MEMS 应用场景及产品种类的多样性，对 MEMS 制造工艺的需求也体现出高度的定制化与复杂性，公司掌握的硅通孔（TSV）、压电材料（PZT）、晶圆键合工艺技术举例图示如下：

硅通孔（TSV）工艺技术图示



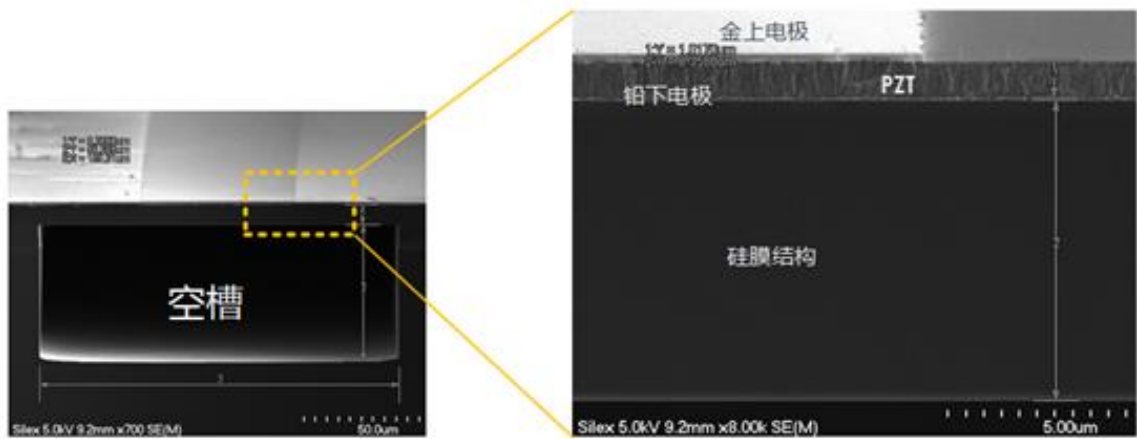
图片来源：赛微电子

厚硅晶圆 TSV 工艺技术图示



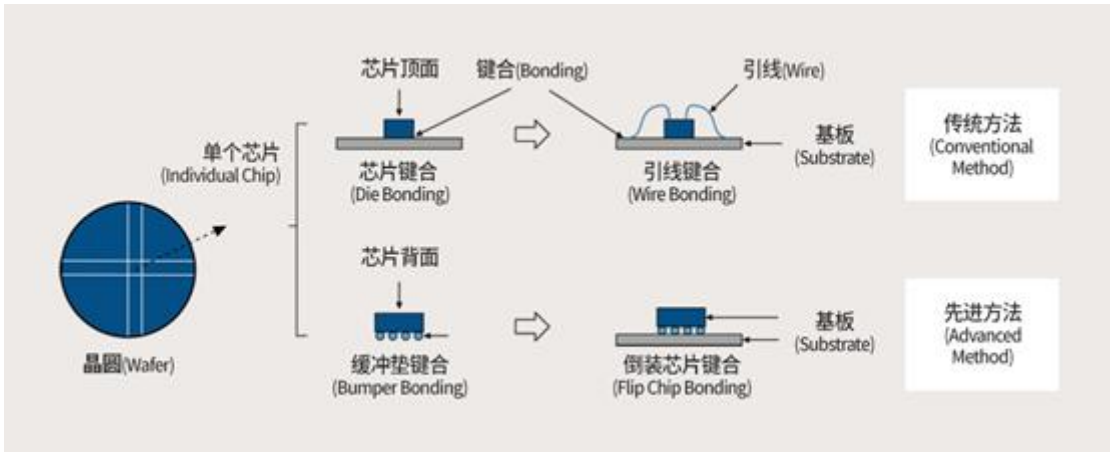
图片来源：赛微电子

压电材料（PZT）工艺技术图示



图片来源：赛微电子

键合技术图示



图片来源：赛微电子

因此，在市场需求保持中长期旺盛态势、公司代表着业内主流、领先技术水平的情况下，公司 MEMS 纯代工业务的进一步发展拥有良好的市场及竞争要素。

2、IC 设计服务

近年来，IC 设计服务主流技术围绕着“先进制程突破、异构集成落地、自动化赋能升级、多场景高效验证”四大方向进行，总体 IC 设计服务的产业角色，也从传统的物理实现工具升级为系统级优化解决方案服务商。在先进制程突破方面，随着芯片集成度持续提升，IC 设计服务已需要开始逐步适应 3nm 量产、2nm 研发的技术需求，并需要为后续更先进节点做好准备，包括 PPA（Performance 性能、Power 功耗、Area 面积）极限优化等在内的技术愈发重要。在异构集成落地方面，Chiplet（芯粒）异构集成技术、2.5D/3D 堆叠技术成为延续芯片性能增长的关键，这直接推动了 IC 设计服务与先进封装的深度融合。在自动化赋能升级方面，近年来 EDA 工具迎来 AI 赋能的革命性变革，国产 EDA 工具在 IC 设计服务成熟制程领域实现积累，积极打破国际垄断，机器学习、强化学习技术全面应用于 IC 设计服务全流程，这大幅缩短了芯片设计周期，成为 IC 设计服务效率提升的核心支撑。在多场景高效验证技术方面，随着人工智能芯片、车规芯片等高端场景需求爆发，IC 设计服务的验证要求已从传统的时序、物理验证，升级为电、热、应力、电磁等一体化的多物理场验证，以确保芯片在复杂场景下的高可靠性。

展诚科技的 IC 设计服务技术能力覆盖了 90/55/40/28/22/16/14/7/5nm 等主流及先进工艺节点，在上述主流技术方面的积累如下：

展诚科技 IC 设计服务主流技术积累情况			
技术	展诚科技技术积累	应用环节	技术水平
PPA 极限优化	自研 EDA 工具与优化流程，实现 5nm/7nm 节点 PPA 极限收敛；在性能、功耗、面积多目标平衡上形成成熟方法论；服务众多等头部客户，支撑高端芯片 PPA 最优设计。	全流程后端设计（布局布线、时序/功耗优化、物理验证、签核）。	技术能力覆盖 90/55/40/28/22/16/14/7/5nm 等主流及先进工艺节点。
2.5D/3D 堆叠技术	具备微凸点等先进互连设计能力；完成 2.5D 中介层、3D 堆叠的版图与验证方案；结合自研多物理场分析，优化堆叠结构的信号/电源/热/机械可靠性。	2.5D/3D 堆叠架构设计、互连仿真、热/应力分析、封装协同。	支撑先进封装与 Chiplet 集成的 2.5D/3D 方案落地。
多物理场验证	自研 Z-RC 寄生参数提取工具，支持高精度 RC 提取；开发多物理场（电、热、应力、电磁）协同仿真与验证流程；适配车规/航天/AI 高可靠场景验证需求。	先进工艺寄生参数提取、信号完整性、电源完整性、热/应力/EMC 分析、签核验证。	自研工具达到业内主流工具同水平，多物理场验证能力突出。
高效验证技术	构建并行化、自动化验证平台；自研验证工具与流程，提升 5nm 节点验证效率；实现物理验证、时序验证、功耗验证、多物理场验证一体化；支持大规模芯片快速签核，缩短验证周期。	全流程物理验证、时序/功耗签核、多物理场验证、量产前 sign-off。	验证效率与精度达到业内先进水平，支撑高端芯片快速交付。

未来，全球 IC 设计服务市场需求总体将依旧保持可观增长态势，但需求结构却持续发生变化。应用需求结构方面，消费电子（手机、平板、电脑等）仍是 IC 设计的基础需求，但占比逐步下降，AI 算力芯片、车规级芯片、高速通信芯片（5G-A/6G/光通信）成为核心增长引擎；技术需求结构方面，IC 设计服务需求从低端化、普适化需求向高端化、定制化需求升级转变，从 PPA 优先需求向 PPA+可靠+安全+热等多目标平衡需求转变，从通用设计需求向垂直定制需求转变。

国内集成电路产业在国产替代政策推动下，本土芯片设计企业已开始逐步崛起，这带动着配套的 IC 设计服务公司快速发展。目前，先进制程（7nm 及以下）IC 设计服务需求规模快速增长，但能提供先进制程服务的 IC 设计服务企业以国外企业居多，国内企业虽在努力进军但仍占较小份额，因此以展诚科技为代表的本土 IC 设计服务公司市场发展空间巨大。此外，尽管目前国内 EDA 市场目前仍由新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）和西门子（Siemens）等国际企业占据主导地位，但随着国家和市场对国产 EDA 行业的重视程度提升，近年来国内 EDA 企业在产业政策、产业环境、投资支持、行业需求、人才回流等各方面的利好影响下获得了迅速发展，上下游协同显著增强，展诚科技的 EDA 工具服务拥有良好的国产替代机遇。

（三）公司核心技术、成本控制及竞争优势

1、MEMS 核心技术、成本控制及公司竞争优势

（1）MEMS 核心技术

MEMS 代工业务的本质是通过集成电路大规模、标准化工艺技术，实现各类传感器件的批量精密制造，同时实现器件的小体积与低功耗。作为业界领先的 MEMS 纯代工厂商，公司 MEMS 工艺开发及晶圆制造业务的主要生产技术类别及环节与其他竞争厂商相比并无重大差异，公司的竞争优势更多地体现在通过长期实践，在制造工艺中集成了大量的专利技术（IP）和技术诀窍（Know-how），以及坚定保持“Pure-Foundry”商业运营模式。

MEMS 代工涉及的主要生产技术类别及环节		
主要技术	具体内容	使用的设备或技术
光刻	除去晶圆表面薄膜的特定部分，主要分为涂胶、曝光、显影、定影等步骤。	步进式光刻机、接触式光刻机。
键合	通过化学和物理作用将硅片与硅片、硅片与玻璃或其它材料紧密地结合起来的一种晶圆制造技术。硅晶圆键合往往与表面硅工艺、体硅工艺相结合，被用于 MEMS 器件的加工工艺中。	技术分支：直接键合（硅-硅、阳极、混合等）；间接键合（共晶、金属、glass frit 等）。 设备：晶圆级键合机。

氧化退火	氧化是在硅上形成二氧化硅；而退火提高了温度使注入的掺杂剂离子从晶格间迁移到晶格点。	技术：扩散，或晶格修复。 设备：FGA 氧化退火炉等。
沉积	采用物理和化学等方法在晶圆表面或近表面形成膜（薄膜、厚膜）。	金属溅射机、金属蒸镀机、二氧化硅/氮化硅等 离子增强化学气相沉积、物理气相沉积、电镀。
干法刻蚀	干法刻蚀的刻蚀剂为等离子体，利用等离子体和表面薄膜反应，形成挥发性物质，或直接轰击薄膜表面使之被腐蚀的工艺。	深反应离子刻蚀；二氧化硅/氮化硅/多晶硅/聚 酰亚胺薄膜刻蚀、螺旋波等离子体源二氧化硅刻 蚀。
湿法刻蚀	通过化学刻蚀液和被刻蚀物质之间的化学反应将需被刻蚀物质剥离下来的刻蚀方法。	KOH 溶液湿法硅刻蚀、HNA 系统湿法硅刻蚀、氮 化硅湿法刻蚀。
量测	对加工体（晶圆等）的电性/机械/化学/形貌/尺寸等参数进行测量，用于控制工艺参数、校调生产设备、分析失效因素和验证基本功能。	晶圆级、分立器件级探针机台、显微镜、形貌仪 等。
切割	使用高速旋转的晶圆切割设备，采用磨削的方式切割晶圆，以使芯片间得以切割分离。	（自动/或手动）晶圆切割机。

MEMS 制造上连产品设计，下接产品封测，是 MEMS 产业链中必不可少的一环。MEMS 产品类别多样、应用广泛，客户定制化程度非常高，其生产采用的微加工技术强调工艺精度，属于资金、技术及智力密集型行业。与 CMOS 相比，MEMS 代工行业呈现出多品种、小批量的特点，部分品种陆续提出大批量制造需求但暂不具备显著的规律性，同时对代工厂商的工艺技术及成本控制能力提出极高要求。

（2）MEMS 成本控制及公司竞争优劣势

报告期内，公司在 MEMS 业务的工艺技术及成本控制方面具有如下特点：

A、形成了标准化、结构化的工艺模块

虽然 MEMS 产品的特殊性要求制造者为每种产品开发独特的工艺流程，但实践中许多工艺步骤是可为多种器件通用的。公司以最大化利用工程资源为目标，提炼出多种可重复使用的工艺制程模块。标准工艺模块作为工艺集成规划的起点，再对单个产品的关键工艺开发、调整和优化，最后对单个产品开发特殊工艺或材料。标准化的工艺模块加上调整优化后的关键工艺和特殊工艺能直接整合客户的产品，实现工艺标准化和规模量产定制化相结合。

B、丰富的项目开发及代工经验

公司在历史经营期内与下游客户开展广泛合作，代工生产了包括微镜、光开关、片上实验室、微热辐射计、振荡器、原子钟、压力传感器、加速度计、陀螺仪、硅麦克风等在内的多种 MEMS 产品。长期实践中，公司严格按照新产品导入流程（NPI）进行项目管理，在产品复杂多样的环境下做好生产工艺的开发与管理；公司团队自主开发的生产管理系统能够很好地对生产计划和制造过程进行整体控制，形成了一套行之有效的 MEMS 代工厂运营管理办法。

C、建立量产工厂的成本控制体系

随着工艺开发向量产的并行转换、公司结合量产需要，采取相应的成本控制手段，一方面根据规模量产工厂的定位要求建立成本控制体系，另一方面则是积极扩大产品范围及客户群体，通过规模效应来实现边际业务成本的降低。

2、IC 设计服务核心技术、成本控制及公司竞争优劣势

（1）IC 设计服务核心技术

IC 设计服务是芯片产品定义与芯片制造中间的关键环节，在芯片设计全产业链中占据不可或缺的重要地位，对提升产业效率、强化企业核心竞争力、保障产业链供应链稳定具有关键作用。公司控股子公司展诚科技在服务客户（以芯片设计企业为主）过程中提供的 IC 设计服务主要技术及环节涵盖架构设计、前端设计及验证、物理设计及验证等。

展诚科技 IC 设计服务主要技术及环节		
主要技术	具体内容	关键作用
架构设计	依据客户需求定义关键性能指标，梳理接口与互联需求，确定芯片整体架构，划分功能模块，搭建架构级性能模型，模块划分与接口定义，验证与迭代。	架构设计：决定芯片性能、功耗和面积等。

前端设计及验证	前端设计主要是根据芯片规格、架构方案、接口协议、性能指标，使用 Verilog/SystemVerilog/VHDL 编写寄存器传输级代码，通过综合、DFT 和仿真，最终交付代码及设计文档。 验证主要是搭建测试环境，编写验证代码，设计测试用例，全面验证芯片的功能是否正常实现。	前端设计核心是把架构需求落地为可实现、可综合的 RTL 代码和相关模拟电路设计，做好模块设计、时钟复位规划和 DFT 支持，确保设计方案合规、高效，是芯片设计成功的基础。验证，核心是通过搭建验证环境、开展全面仿真、排查边界异常，确保芯片功能符合规格，把缺陷消灭在前端，避免后期流片风险。是芯片设计成功的关键。
物理设计及验证	根据前端设计数据，完成版图规划，开展布局、时钟树设计、单元创建和布线工作；依据电路逻辑关系用金属连线连接标准单元，结合客户工艺制程节点和具体要求完成相关工作，力争缩小芯片面积、降低功耗。验证核心工作时开展设计规则检查、电学规则检查、电路图和版图一致性检查及可靠性检查等。	芯片物理设计直接决定芯片的核心性能、长期可靠性及量产良率，关乎项目成败、成本控制和产品核心竞争力，优化芯片面积与功耗，保障芯片设计性能落地和功耗控制，是芯片从设计理念落地为可量产产品的关键环节。

与芯片设计公司相比，展诚科技所从事的 IC 设计服务更强调物理实现的专业性、工艺规则的适配性和设计结果的可制造性，在满足工艺约束的前提下，展诚科技需要依据客户需求实现芯片面积、功耗、时序的最优平衡，这对展诚科技服务的技术能力、成本管控提出了严苛要求。

（2）IC 设计服务成本控制及公司竞争优势

报告期内，展诚科技在 IC 设计服务成本控制方面形成了显著优势，具体特点如下：

A、打造一体化服务体系，精准匹配客户需求，进行高质量交付

展诚科技深耕 IC 设计服务领域，形成了全流程 IC 设计服务能力，可针对数字芯片、模拟芯片等不同类型产品，以及不同制程节点的工艺要求，为客户提供从版图规划到最终 GDS II 文件交付的一体化服务。在服务过程中，展诚科技深度融合工艺规则与设计优化，确保 IC 设计服务既符合客户的功能、性能需求，又高度适配芯片制造的工艺标准，有效保障客户芯片流片的良率与成功率，实现从逻辑设计到物理实现的无缝衔接。

B、构建标准化服务流程，结合客户定制化要求，实现服务效率提升

集成电路芯片设计的定制化需求虽然要求 IC 设计服务公司根据不同芯片的功能、工艺节点、性能指标制定个性化的设计方案，但芯片设计的部分核心环节与关键流程具备通用可复制性。展诚科技以提升服务效率、最大化利用技术资源为核心目标，提炼出覆盖全环节的标准化服务流程与模块化设计方法，将各环节的核心操作要点固化为标准模块，作为各类项目设计的基础框架。在此基础上，针对不同客户的工艺制程节点、芯片性能需求进行定制化调整与精细化优化，实现了标准化服务流程与定制化设计优化的有机结合，既大幅提升了项目开发效率，又能满足客户定制化要求，实现了服务效率提升。

C、运用丰富项目实操经验，构建成熟的项目管控体系，降低返工率

展诚科技在二十多年经营过程中与多家集成电路设计公司开展深度合作，积累了丰富的 IC 设计服务项目经验，在实际服务中完成了各类通用及定制化芯片的 IC 服务工作。基于长期丰富的项目实操，展诚科技建立了成熟的项目管理管控体系，从项目立项、需求对接、方案制定到设计实施、质量验证、成果交付，全流程进行精细化管理，从源头上尽最大可能规避 IC 设计服务错误，保障 IC 设计服务成果的准确性与合规性，大幅降低了项目返工率，提升了客户服务体验。

D、运用数字化/信息化手段，聚焦核心客户及业务，实现服务成本优化与规模效应

展诚科技围绕 IC 设计服务的全流程，积极通过数字化、信息化手段提升项目管理与设计协作，优化内部资源配置，减少了管理成本与运营成本。此外，公司凭借核心的技术服务能力与良好的行业口碑，聚焦核心客户及业务，提升客户合作粘性，减少市场开拓成本，实现了成本控制与业务发展的良性循环。

（四）公司下游应用领域的宏观需求分析

根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球 MEMS 市场规模将由 2024 年的 154 亿美元增长至 2030 年的 192 亿美元，CAGR（年均复合增长率）为 3.7%。其中，2024 年 10 亿美元以上的 MEMS 细分领域包括射频器件（28.83 亿美元）、惯性测量单元 IMU（24.24 亿美元）、压力传感器（23.03 亿美元）、加速度计（14.65 亿美元）、麦克风（13.92 亿美元）、喷墨打印头（12.65 亿美元）；预计 2030 年 10 亿美元以上

的 MEMS 细分领域包括惯性测量单元 IMU（30.29 亿美元）、射频器件（27.28 亿美元）、压力传感器（26.95 亿美元）、麦克风（18.26 亿美元）、加速度计（17.70 亿美元）、热辐射计（12.6 亿美元）、喷墨打印头（12.55 亿美元）。

根据 Archive Market Research's Growth 发布的《Integrated Circuit Back-end Design Service 2026-2033 Trends: Unveiling Growth Opportunities and Competitor Dynamics》，全球集成电路后端设计服务市场规模从 2020 年到 2034 年的复合年增长率预计为 3.93%，2025 年市场规模约为 524 亿美元，2031 年市场规模为约 660 亿美元。未来，随着产业政策、下游市场的持续向好，全球数据中心、智能物联网设备等领域蓬勃发展，芯片设计公司、系统厂商等对设计服务的需求不断上升，集成电路后端设计行业的市场规模有望持续扩大。

（五）公司所处行业市场竞争格局暨国内外主要行业公司

MEMS 芯片纯代工制造处于产业链的中游，该行业根据设计环节的需求开发各类 MEMS 芯片的工艺流程并实现规模生产，兼具资金密集型、技术密集型和智力密集型的特征，对企业资金实力、研发投入、技术积累等均提出了极高要求。经历汽车电子、消费电子、物联网三次发展浪潮，MEMS 芯片纯代工制造行业已形成较为稳定的市场竞争格局，瑞典 Silex、TELEDYNE、台积电（TSMC）、X-FAB 长期保持在全球 MEMS 代工第一梯队。目前，公司控股子公司赛莱克斯北京投资建设的规模量产线“8 英寸 MEMS 国际代工线”正处于产能爬坡阶段，此外国内正在建设运营 MEMS 代工线的公司主要有芯联集成电路制造股份有限公司、广州增芯科技有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司、无锡华润上华科技有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、安徽华鑫微纳集成电路有限公司等。

集成电路行业的飞速发展，促进了 IC 设计服务及 EDA 软件开发需求的日益旺盛。公司控股子公司展诚科技是国内较早从事 IC 设计服务及 EDA 软件开发的资深企业，此外其他从事 IC 设计服务或 EDA 软件开发的公司的公司主要有创意电子股份有限公司、智原科技股份有限公司、灿芯半导体（上海）股份有限公司、创耀（苏州）通信科技股份有限公司、芯原微电子（上海）股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、上海概伦电子股份有限公司、杭州广立微电子股份有限公司、杭州行芯科技有限公司等。

（六）发展战略及经营计划

公司的长期发展战略为：基于当前国际局势紧张及日趋复杂化的考量，对于经济全球化与国际产业链分工协作可能面临的挑战，积极拉通内部各业务板块，发挥资源及组织的协同效应，同时在境内外布局建立包括芯片纯代工制造及 IC 服务在内的业务平台，以同时满足境内外客户的不同需求，致力于形成可支持“内循环”、兼顾“双循环”的半导体服务体系；同时积极进行半导体产业投资布局，面向客户提供从 IC 设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造到封装测试的一站式综合服务，努力发展成一家立足本土、国际化经营的知名半导体专业服务厂商。

公司将继续落实总体发展战略及董事会制定的经营方针，以技术及市场为导向，聚焦发展半导体专业服务业务，统筹面向芯片设计公司为主要客户的各项资源及服务能力，在研发、生产、市场等方面进行全面加强，继续提高境内外业务平台的业务承接能力。

（七）报告期内的新产品或新工艺

公司 MEMS 主业继续投入研发，继续升级硅通孔（TSV）、晶圆键合、深反应离子刻蚀等多项工艺技术和工艺模块，继续开展压电（Piezo）、聚合物（Polymer）等新型材料的开发及应用，持续研发硅光子、微振镜、微透镜、惯性、谐振、滤波、硅麦、红外、压力、气体、温湿度、微流控、超声波、微开关等各式 MEMS 芯片的生产制造工艺，一方面为持续提高产线技术水平，满足不断新增的 MEMS 工艺开发及晶圆制造需求；另一方面基础及专项工艺技术的积累也将有利于公司 MEMS 产线持续扩大服务产品品类、推进产能及良率爬坡。截至目前，该等材料开发及工艺开发升级活动仍在持续进行中，将随着业务规模的增长不断应用并成熟，最终将有利于加强公司在 MEMS 纯代工领域的竞争力。

报告期内，公司控股子公司展诚科技在主要从事的 IC 设计服务方面，不断优化架构设计、电路设计、寄生参数提取仿真优化、物理设计等设计服务各环节涉及的 PPA 极限优化、2.5D/3D 堆叠技术、多物理场验证、高效验证等技术。此外展诚科技还少量从事寄生参数提取 EDA 软件研发，可根据芯片物理版图和工艺信息，用算法与软件工程计算出导线、器件之间的寄生电阻、电容、电感等，并输出给仿真、时序分析使用，主要用于精确还原集成电路纳米尺寸下真实复杂的物理模型，是保证芯片制造工艺研发和芯片设计成功的关键环节。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司持续进行技术创新和市场拓展，加大研发投入，进一步提升和扩大在 MEMS 纯代工及 IC 设计服务行业的核心竞争力，主要表现在如下方面：

（一）自主创新及研发优势

公司坚持自主创新战略，研发团队围绕 MEMS 纯代工业务、IC 设计服务业务的关键技术进行了深入系统研究，自主研发并掌握了相关工艺核心技术及相关产品的软硬件设计核心技术，不断扩大自主创新及技术研发成果。截至本报告期末，公司拥有软件著作权 127 项，专利 85 项，正在申请的专利 125 项（集成电路相关商标、软著及专利明细列表详见本节“三、主营业务分析”之“研发投入”）。凭借技术研发经验和人才优势，公司具备承担重要科研项目的能力，在 MEMS 工艺开发、晶圆制造、IC 设计服务等领域积累了丰富的研发经验。

（二）高端人才优势

公司所在的集成电路行业以及下属的 MEMS 和 IC 设计服务属于国家鼓励发展的高新技术产业及战略新兴产业，专业的技术团队以及具有丰富从业经验、对行业有深刻理解的管理层是企业可持续发展的保障。公司 MEMS 业务及 IC 设计服务业务，拥有业界一流的专家与工程师团队，其中包括多名国家特聘专家、十数名国际国内行业知名技术专家、数十名来自著名半导体企业和高校科研院所的技术专家以及专家顾问。截至本报告期末，公司拥有博士 52 名，硕士 127 名，合计占公司总人数的 17.10%；公司研发及技术人员合计 779 名，占公司总人数的 74.40%。公司核心技术及业务团队包含诸多资深专业人士，服务公司多年且经验丰富；公司首席科学家，重要子公司 CEO、CTO 和核心工艺组经理等从业时间均超过 10 年。

（三）纯代工/服务模式下的多品类拓展优势

公司 MEMS 纯代工与 IC 设计服务客户均以各类芯片设计企业为主，形成了服务面向产业链设计环节的精准业务定位。在 MEMS 纯代工业务方面，公司始终坚持并严格执行专业化纯代工（Pure-Foundry）模式，不涉足自有芯片品牌的研发、设计与销售，完全聚焦于制造环节，为客户提供稳定、可靠、可规模化的 MEMS 纯代工服务；在 IC 设计服务业务方面，公司同样坚持无自有芯片品牌产品、仅提供专业服务的运营策略。

对于采用 Fabless（无晶圆厂）模式或 Fab-lite（轻晶圆厂）模式的芯片设计企业而言，与公司开展深度合作具有显著的产业价值与成本优势。一方面，设计公司无需承担晶圆厂建设、设备采购、产线运维等巨额固定资产投入，能够显著降低前期资本开支与运营风险；另一方面，公司严格恪守专业芯片纯代工和技术服务定位，建立了完善的知识产权保护机制与信息安全体系，可有效保障客户核心 IP、设计方案与关键技术不被泄露、不被滥用，让客户在技术合作与量产落地过程中具备高度安全感。综上，公司保障了合作关系的纯粹性与稳定性，在潜在客户拓展与纯代工及服务品类延伸方面具备独特的竞争优势。

（四）先进的工艺开发及晶圆制造技术优势

公司以往 MEMS 代工品类涉及 500 余项 MEMS 工艺开发经验（包含境内外产线），与下游客户开展广泛合作，代工生产了包括微镜、微针、硅光子、振荡器、加速度计、陀螺仪、硅麦克风、片上实验室、微热辐射计、原子钟、压力传感器、气体、温湿度等在内的多种 MEMS 产品。公司在长期实践制造工艺中集成了大量的专利技术（IP）和技术诀窍（Know-how），拥有覆盖 MEMS 领域的全面工艺技术储备，关键技术已经成熟并经过多年的生产检验，TSV、TGV、DRIE 及晶圆键合等技术模块行业领先。

（五）体系化的 IC 设计服务能力优势

公司控股子公司展诚科技的 IC 设计服务累计交付设计专案 5,000 余项，服务于行业知名企业，在 IC 设计服务领域占据国内领先地位，是国内较早从事 IC 设计服务细分领域的企业。通过多年的发展积累，展诚科技在 IC 设计服务领域形成了体系化的 IC 设计服务能力，服务工艺制程覆盖 90/55/40/28/22/16/14/7/5nm 等主流及先进工艺节点；服务芯片种类包括模拟芯片中的转换芯片、接口芯片、RF 芯片、时钟芯片，以及数字芯片中的处理器 CPU、控制器 MCU、数字信号处理 DSP、AI 相关芯片等，展诚科技在体系化的 IC 设计服务能力方面具备行业领先优势。

（六）良好运营管理系统和项目管控体系优势

在 MEMS 方面，长期实践中公司严格按照新产品导入流程（NPI）进行项目管理，在产品复杂多样的环境下做好生产工艺的开发与管理；公司团队自主开发的生产管理系统能够很好地对生产计划和制造过程进行整体控制，形成了一套行之有效的 MEMS 代工厂运营管理办法。在 IC 设计服务方面，展诚科技提炼出标准化服务流程与模块化设计方法，将各环节的核心操作、质量管控要点固化为标准模块，作为各类项目设计的基础框架，实现了标准化服务流程与定制化设计优化的有机结合。

（七）正在逐步建立的一体化综合服务优势

公司围绕半导体制造积极布局产业生态及相关业务，于 2025 年 9 月完成对展诚科技 56.24% 股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00% 股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务。公司目前开展 MEMS 纯代工、IC 设计服务等业务，已初步构建 MEMS 封装测试能力，并前瞻性布局集成电路寄生参数提取 EDA 软件研发。此外，公司 MEMS 封装测试产线于 2025 年底实现通线，相对于 IC 产品的封装测试，MEMS 的封装测试面对的是一个需要与外界环境进行交互的器件或系统，在专用性、复杂性、保护性及可靠性等多方面存在其独特性，整体而言更为复杂且难度更高，MEMS 封装测试也因此具有更高的附加值。公司当前已具备先进封装的核心发展要素，掌握 TSV（硅通孔）等三维系统集成所必须的首要工艺，拥有目前业界领先的 TSV 绝缘层工艺和制造平台；公司拥有广泛且不断增长 MEMS 客户基础，具备拓展 MEMS 封装测试业务的技术研发实力及一定的技术、人员储备。因此，出于 MEMS 产业发展趋势以及自身发展战略需要，依托公司在 MEMS 代工制造领域的全球领先竞争优势，公司正积极在 MEMS 产业链向下游进行延伸拓展，已初步构建 MEMS 先进封装测试能力，面向硅麦克风、压力、惯性、光学、RF、生物医疗等 MEMS 器件提供先进集成封装、测试服务，在市场需求增长的背景下，充分利用业务间的高度相关性与紧密性，逐步建立从 IC 设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造再到封装测试的一体化服务能力。

（八）专业资质优势

由于性能及工艺的独特性，MEMS 产品的工艺开发周期较长，视产品结构、技术要求及材料应用的不同，开发期间从数月至数年不等，期间代工厂商需要与客户持续交互反馈，客户的粘性及厂商转换成本均非常高，公司 MEMS 纯代工业务主要服务于各领域知名客户及中小创新企业，公司 MEMS 产线正在结合业务需要保持各项管理体系的认证，包括 ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001、IATF16949、QC080000 等。此外，公司 IC 设计服务业务客户对服务专业技术能力、体系管理能力要求较高，公司控股子公司展诚科技具有完备的 ISO 管理体系（ISO9001、ISO27001、ISO45001），获得软件 CMMI3 级认证。

（九）优质客户资源优势

公司 MEMS 产品覆盖了通信计算、生物医疗、工业汽车、消费电子等诸多领域，公司作为同时具备先进工艺开发能力的纯 MEMS 代工企业，在服务各领域头部企业的同时，一直耐心陪伴众多创业型团队或公司，并且通过多年的相互紧密协作，不断有各领域的新兴公司陆续从工艺开发阶段向批量生产甚至规模量产阶段切换，且受益于全球 MEMS 应用的持续增长，该等细分领域客户的发展往往具有爆发性，能够为公司 MEMS 业务的持续发展提供巨大的发展潜力。公司 MEMS 服务的客户包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、高频通信、ICT 等厂商以及通信计算、生物医疗、工业汽车和消费电子各细分行业的领先企业。公司控股子公司展诚科技开展 IC 设计服务业务，累计服务华为海思、台积电（TSMC）、海光半导体、中芯国际等行业知名企业超 300 家，在行业内形成了良好的口碑和品牌知名度，不断巩固和强化了行业大客户的核心供应商地位。

（十）全球化布局能力优势

公司 MEMS 纯代工及 IC 设计服务业务具备突出的全球化布局运营能力优势。公司 MEMS 纯代工业务拥有深厚发展底蕴，具备先进的纯 MEMS 代工工艺及正在扩张的代工产能，在 2019-2024 年全球 MEMS 纯代工厂商排名中瑞典 Sillex 均位居第一，公司控股子公司北京亦庄 MEMS 量产线在中国 MEMS 纯代工厂商中亦处于第一梯队。公司自 2016 年收购瑞典 Sillex 至 2025 年 7 月完成控制权出售，累计持有、运营、管理瑞典 Sillex 近十年，本起跨境产业并购实现了多方共赢，一方面瑞典 Sillex 实现了优异发展，公司也通过该次国际并购取得了良好的财务收益回报；另一方面，该次国际并购成功助力公司实现战略转型并通过长期奋斗有力地推动了国内 MEMS 产业的自主发展。截至本公告披露日，公司直接持有瑞典 Sillex 9.90% 普通股，并已按约定将瑞典 Sillex 上市增发普通股后 19.10% 的普通股转让给 Bure，该 19.10% 普通股将在瑞典 Sillex 首次

公开募股锁定期承诺届满至公司与 Bure 双方约定时间内，由公司决策后，指令 Bure 协助择机出售，相关收益归公司所有。此外，IC 设计服务业务方面，公司积极搭建境外运营分支机构，提升了全球化布局运营能力。

三、主营业务分析

概述

（一）整体经营情况概述

报告期内，公司继续聚焦发展主营业务 MEMS（微机电系统），并持续为下一步的产能扩充及爬坡做好准备；同时依托并购展诚科技形成的业务基础，持续强化并夯实 IC 设计服务能力。

对于北京亦庄 MEMS 量产线，报告期内继续处于产能爬坡阶段，具有导入属性的工艺开发业务继续开展，带动着公司从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加，北京亦庄 MEMS 量产线业务收入实现增长。但由于北京亦庄 MEMS 量产线研发投入依然保持较高强度，运营支出存在刚性，叠加折旧摊销等因素，北京亦庄 MEMS 量产线仍处于亏损状态。

对于 IC 设计服务，报告期内，展诚科技继续保持良性发展，业务稳步推进，持续巩固拓展客户，实现盈利。

报告期内，公司及相关子公司基于存量仍适度开展半导体设备业务，贡献了一定的营业收入，但由于缺乏大客户销售，且国内半导体设备市场竞争加剧，公司 2026 年上半年半导体设备业务收入较上年同期大幅下降。

与此同时，报告期内公司管理费用、销售费用较上年同期大幅下降，财务费用较上年同期基本持平；研发费用继续处于较高投入水平。

报告期内，公司实现营业收入 17,837.31 万元，较上年同期大幅下降 68.71%；实现营业利润 310,886.56 万元，较上年同期大幅增长 4,521.59%；实现利润总额 310,886.77 万元，较上年同期大幅增长 4,521.60%；实现净利润 267,512.45 万元，较上年同期大幅增长 9,360.48%；归属于上市公司股东的净利润 270,221.40 万元，较上年同期大幅增长 415,612.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,925.18 万元，较上年同期大幅下降 1,848.31%。

报告期内，公司基本每股收益 3.6905 元，较上年同期大幅增长 410,155.56%；加权平均净资产收益率 34.07%，较上年同期优化 34.08%（绝对数值变动），主要是由于本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长 415,612.12%。

本报告期末，公司总资产 1,159,720.57 万元，较期初上升 29.73%；归属于上市公司股东的所有者权益 903,986.37 万元，股本 732,213,134.00 元，归属于上市公司股东的每股净资产 12.35 元，较期初上升 34.24%。

公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Sillex 控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典 Sillex 不再纳入公司合并报表范围，上述股权交易是本报告期公司营业收入大幅下降的主要原因。报告期内，瑞典 Sillex 在瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市，公司在瑞典 Sillex 上市的同时转让其部分股权；瑞典 Sillex 上市后，公司对持有瑞典 Sillex 的剩余股权采用公允价值计量，由股权转让及公允价值变动产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。报告期内，非经常性损益对公司当期归母净利润的影响为 308,146.58 万元（主要影响因素为转让瑞典 Sillex 部分股权及其剩余股权的公允价值变动），上年同期非经常性损益对当期归母净利润的影响为 1,881.53 万元（主要影响因素为政府补助）。

（二）主要业务情况

1、MEMS 纯代工业务发展情况

报告期内，公司 MEMS 业务收入下降，主要系公司 2025 年 7 月完成对原全资子公司瑞典 Sillex 控制权的出售，本次股权交易完成后，瑞典 Sillex 不再纳入公司合并报表范围；另一方面公司北京亦庄 MEMS 量产线的产能爬坡持续推进，除继续开展具有导入属性的工艺开发业务外，从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆代工品类持续增加，2026 年上半年北京亦庄 MEMS 量产线工厂的收入比上年同期有所增加，但整体收入规模仍较小。

报告期内，公司 MEMS 业务实现收入 7,897.15 万元，较上年同期大幅下降 85.17%；其中，MEMS 晶圆制造实现收入 4,673.83 万元，较上年同期大幅下降 84.90%，MEMS 工艺开发实现收入 3,223.32 万元，较上年同期大幅下降 85.55%，上述变化的主要原因是：瑞典 Sillex 不再纳入公司合并报表范围。与此同时，由于北京亦庄 MEMS 量产线仍处于产能爬坡阶段，营收规模体量以及量产产品类别仍相对较少，但持续累积各领域客户及晶圆产品类别。

报告期内，公司 MEMS 业务的综合毛利率为 20.44%，较上年同期下降 19.03%；其中 MEMS 晶圆制造毛利率为 6.50%，较上年同期下降 30.62%，MEMS 工艺开发毛利率为 40.66%，较上年同期下降 2.07%，上述变化的主要原因是：公司于 2025 年 7 月出售瑞典 Sillex 控制权，瑞典 Sillex 不再纳入公司合并报表，而北京亦庄 MEMS 量产线仍处于产能爬坡阶段，收入规模较小，加之受复杂国际形势、市场环境等因素影响，上游原材料价格上升，综合导致 MEMS 业务毛利率下降。

报告期内，得益于 MEMS 应用市场的高景气度，并基于持续扩充的产线产能，公司积极开拓全球市场，并积极承接 MEMS 工艺开发及晶圆制造订单，持续服务于包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、高频通信、ICT 等厂商以及通信计算、生物医疗、工业汽车和消费电子等各细分领域的领先企业。

报告期内，公司北京亦庄 MEMS 量产线持续扩大覆盖不同的产品及客户，积极推进产能及良率爬坡，并适时逐步扩充产能。公司虽已于 2025 年 7 月完成瑞典 Sillex 控制权出售的交割，但随着北京亦庄 MEMS 量产线整体运营状态的持续提升，以及公司正在推进的怀柔 MEMS 中试线布局，公司仍拥有不同定位的合格产能，不同产线在产能、市场等方面可以实现协同互补，公司有望在纯 MEMS 代工领域仍保持重要地位。

2、IC 设计服务业务发展情况

报告期内，展诚科技实现营业收入 8,752.05 万元，保障提升 IC 设计服务业务基本盘的同时，推进了 EDA 软件开发。报告期内，展诚科技紧抓算力及 AI 芯片发展的重要机遇期，优化自身技术，夯实绑定大客户战略，大力开发新客户，实现了技术优化升级与包括海外市场的业务开拓，并提前布局 3nm 以下技术储备与积累。同时，展诚科技积极延伸业务赛道，力争细分领域的突破，并不断打造自身在不同芯片领域从架构设计到版图验证的一站式服务能力和全方位服务体系，关注和兼容国际主流技术、工具、格式，积极捕捉商业机遇，为将来助力客户降低研发成本、缩短上市周期做好了扎实准备。报告期内展诚科技各业务模式的发展情况如下：

（1）off-site 模式发展情况

报告期内，展诚科技在 off-site 模式依托远程网络专业工具、安全远程协作体系的完善和普及，借助标准化的设计流程、跨地域的资源整合能力，在芯片设计、验证、标准化 IP 开发与验收、设计数据校验检查等项目流程中持续优化运营效率，有效降低了远程协作的沟通成本。off-site 模式是展诚科技服务众多客户、承接批量标准化需求的重要模式。

（2）on-site 模式发展情况

报告期内，展诚科技在 on-site 模式持续深化场景化适配能力，针对客户先进工艺节点芯片设计、高复杂度混合模块等对实时协同、工艺深度对接要求高的需求，进一步强化驻场团队的专业配比度，提升快速响应速度，通过与客户的无缝联动，在项目中实现了高效协作和高质量交付。on-site 模式是展诚科技 IC 设计服务业务发展的重要模式。

（3）odc 模式发展情况

报告期内，在 odc 离岸开发中心模式方面，展诚科技搭建专属化、定制化的离岸团队，推进规模化落地与精细化运营，围绕芯片设计客户的长期持续性需求，实现了团队与客户设计规范、工艺要求、工具链的深度适配，同时展诚科技通过建立远程管理体系、人才培养机制与数据安全防护体系，有效平抑了高端人才稀缺等问题，初步形成了成本优势与交付效率的双协同。

3、研发情况

报告期内，公司继续重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。公司 MEMS 纯代工业务及 IC 设计服务业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也需要公司进行重点、持续的研发投入。2026 年上半年，公司共计投入研发费用 19,899.89 万元，继续保持了较高的投入强度，在收入因瑞典 Sillex 出表 2026 年上半年大幅下滑的情况下，研发费用占本期营业收入比例 111.56%。具体详见本节“三、主营业务分析”之“研发投入”的相关内容。

4、投融资情况

报告期内，公司为实现产业目标、把握合作机遇、更好地服务于 MEMS 主业的发展，基于过往已有布局、根据长期发展战略继续开展投融资活动：（1）股权投资方面，根据公司业务发展战略和规划，公司进一步提高了对赛莱克斯北京、海创微元的持股比例，投资 CompoundTek 部分股权，并小比例参与投资了多家半导体产业链相关公司；（2）股权转让方面，公司转让瑞典 Sillex 部分股权，同时仍保留部分少数股权；（3）产业基金方面，持续推动相关合作产业基金在智能传感领域的项目投资，继续跟踪半导体产业基金、北斗产业基金等的投资与投后情况；（4）融资租赁方面，赛莱克斯北京、赛积国际继续执行相关融资租赁交易；（5）银行授信及并购贷款方面，公司及子公司根据经营发展中的资金需求，积极向相关银行申请综合授信额度及并购贷款，扩大资金使用空间，降低财务资金成本。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	178,373,115.82	570,095,783.13	-68.71%	主要因报告期瑞典 Sillex 已不在合并报表范围，同时展诚科技纳入合并报表范围等共同所致。
营业成本	162,651,981.89	342,000,351.68	-52.44%	主要因报告期瑞典 Sillex 已不在合并报表范围，同时展诚科技纳入合并报表范围等共同所致。
销售费用	3,604,758.21	15,679,584.68	-77.01%	主要因报告期瑞典 Sillex 已不在合并报表范围，同时展诚科技纳入合并报表范围等共同所致。
管理费用	42,500,049.06	71,802,139.15	-40.81%	主要因报告期瑞典 Sillex 已不在合并报表范围，同时展诚科技纳入合并报表范围等共同所致。
财务费用	39,628,125.85	40,556,451.57	-2.29%	无重大变动。
所得税费用	433,743,122.49	-41,423,448.91	1,147.10%	主要因当期所得税费用和递延所得税费用变动共同影响所致。
研发投入	198,998,926.06	199,344,516.53	-0.17%	无重大变动。
经营活动产生的现金流量净额	-109,503,842.57	165,802,553.59	-166.04%	综合因素所致。
投资活动产生的现金流量净额	537,845,159.59	-181,043,574.92	397.08%	综合因素所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-193,489,826.25	379,286,851.29	-151.01%	综合因素所致。
现金及现金等价物净增加额	147,011,662.39	404,231,143.04	-63.63%	综合因素所致。
利息收入	11,808,035.03	5,554,770.71	112.57%	主要因报告期货币资金平均余额较上期增加所致。
投资收益（损失以“—”号填列）	781,635,901.11	3,487,973.52	22,309.46%	主要因报告期处置瑞典 Sillex 部分股权所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	781,635,901.11	3,487,973.52	22,309.46%	主要因报告期处置瑞典 Sillex 部分股权所致。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,577,492,322.41		100.00%	主要因报告期新增以公允价值计量的交易性金融资产及其他非流动金融资产所致。
信用减值损失（损失以“—”号填列）	48,427,177.15	13,610,881.09	255.80%	主要因报告期末坏账准备较上年末减少所致。
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-22,678,174.26	-4,019,999.92	-464.13%	主要因报告期计提存货跌价较上年同期增加所致。

资产处置收益（损失以“—”号填列）	-16,511,220.61		-100.00%	主要因报告期处置固定资产所致。
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,108,865,560.40	-70,310,965.29	4,521.59%	综合因素所致。
加：营业外收入	175,631.58		100.00%	主要因报告期产生零星非经营性收入所致。
减：营业外支出	173,527.81	29.90	580,260.57%	主要因报告期产生零星非经营性支出所致。
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,108,867,664.17	-70,310,995.19	4,521.60%	综合因素所致。
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,675,124,541.68	-28,887,546.28	9,360.48%	综合因素所致。
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,675,124,541.68	-28,887,546.28	9,360.48%	综合因素所致。
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	2,702,213,961.27	-650,333.36	415,612.12%	综合因素所致。
六、其他综合收益的税后净额	-125,914,371.17	171,611,394.52	-173.37%	综合因素所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,914,371.17	171,611,394.52	-173.37%	综合因素所致。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-125,914,371.17	171,611,394.52	-173.37%	综合因素所致。
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-34,313,418.10		-100.00%	主要因报告期内在出售瑞典 Sillex 部分股权之前采用权益法核算所致。
5.现金流量套期储备		3,967,754.90	-100.00%	主要因报告期瑞典 Sillex 已不在合并报表范围，无相关衍生金融工具所致。
6.外币财务报表折算差额	-91,600,953.07	167,643,639.62	-154.64%	主要因报告期美元对人民币贬值等因素综合所致。
七、综合收益总额	2,549,210,170.51	142,723,848.24	1,686.11%	综合因素所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,576,299,590.10	170,961,061.16	1,406.95%	综合因素所致。
（一）基本每股收益	3.6905	-0.0009	410,155.56%	综合因素所致。
（二）稀释每股收益	3.6905	-0.0009	410,155.56%	综合因素所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	327,994,974.06	572,944,334.97	-42.75%	主要因报告期瑞典 Sillex 已不在合并报表范围，同时展诚科技纳入合并报表范围等共同所致。
收到的税费返还	6,996,604.79	58,544,645.50	-88.05%	主要因上年同期收到境外退税款所致。
经营活动现金流入小计	420,441,693.55	749,329,936.52	-43.89%	综合因素所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	161,062,792.47	233,455,954.18	-31.01%	主要因报告期瑞典 Sillex 已不在合并报表范围，同时展诚科技纳入合并报表范围等共同所致。
支付的各项税费	16,418,545.34	34,155,505.16	-51.93%	主要因报告期瑞典 Sillex 已不在合并报表范围，同时展诚科技纳入合并报表范围等共同所致。
支付其他与经营活动有关的现金	108,162,522.08	43,185,312.38	150.46%	主要因报告期退回政府补助款所致。
收回投资收到的现金	81,527,579.60	2,348,026.91	3,372.17%	主要因报告期处置瑞典 Sillex 部分股权所致。
取得投资收益收到的现金	632,234,154.72	10,394,568.32	5,982.35%	主要因报告期处置瑞典 Sillex 部分股权所致。
处置固定资产、无形资产和其他长	26,090,000.00		100.00%	主要因报告期处置固定资产

期资产收回的现金净额				所致。
投资活动现金流入小计	739,851,734.32	12,742,595.23	5,706.13%	综合因素所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,255,109.04	193,786,170.15	-69.94%	主要因报告期购建固定资产等长期资产支出较上年同期减少所致。
投资支付的现金	112,257,065.69		100.00%	主要因报告期对外投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,494,400.00		100.00%	主要因报告期按期支付展诚科技股权收购款所致。
吸收投资收到的现金	100,000.00		100.00%	主要因报告期公司控股子公司收到少数股东注资款所致。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00		100.00%	主要因报告期公司控股子公司收到少数股东注资款所致。
取得借款收到的现金	210,506,403.24	526,238,615.74	-60.00%	主要因报告期取得借款较上年同期减少所致。
筹资活动现金流入小计	227,977,660.63	544,028,615.74	-58.09%	综合因素所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,755,516.48	17,618,365.74	1,550.30%	主要因报告期公司分配现金股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,801,821.49		100.00%	主要因报告期支付信用证保证金所致。
筹资活动现金流出小计	421,467,486.88	164,741,764.45	155.84%	综合因素所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,839,828.38	40,185,313.08	-318.59%	综合因素所致。
加：期初现金及现金等价物余额	2,244,368,874.18	615,452,918.72	264.67%	综合因素所致。
六、期末现金及现金等价物余额	2,391,380,536.57	1,019,684,061.76	134.52%	综合因素所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☒适用 ☐不适用

报告期内，瑞典 Silex 成功在瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市交易，公司完成部分瑞典 Silex 普通股 IPO 配售；截至本公告披露日，公司直接持有瑞典 Silex 9.90% 普通股，同时公司按约定将瑞典 Silex 上市增发普通股后 19.10% 的普通股转让给 Bure，该 19.10% 普通股将在瑞典 Silex 首次公开募股锁定期承诺届满（锁定期 180 天）至公司与 Bure 双方约定时间内，由公司决策后，指令 Bure 协助择机出售，相关收益归公司所有。上述剩余股权确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在其他非流动金融资产科目核算。

前述转让瑞典 Silex 部分股权产生的投资收益及其剩余股权的公允价值变动收益是本报告期利润的重要来源，发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
集成电路行业	170,978,330.34	151,779,700.91	11.23%	-68.47%	-53.43%	-28.66%
分产品						
MEMS 纯代工	78,971,508.13	62,828,083.38	20.44%	-85.17%	-80.51%	-19.03%
IC 设计服务	87,165,772.95	66,248,687.04	24.00%	100.00%	100.00%	24.00%
分地区						
中国境内	176,233,991.95	159,829,481.30	9.31%	30.14%	49.13%	-11.54%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求：产品的产销情况

单位：元

产品名称	本报告期			上年同期			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
MEMS 纯代工	62,828,083.38	78,971,508.13	产线口径	322,434,629.34	532,660,672.21	产线口径	-80.51%	-85.17%	-
IC 设计服务	66,248,687.04	87,165,772.95	-	-	-	-	100.00%	100.00%	-

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
MEMS 纯代工	直接材料	45,694,574.89	72.73%	99,079,162.90	30.73%	-53.88%
MEMS 纯代工	直接人工	2,613,967.00	4.16%	110,261,631.71	34.20%	-97.63%
MEMS 纯代工	制造费用	14,519,541.49	23.11%	113,093,834.73	35.07%	-87.16%
MEMS 纯代工	营业成本	62,828,083.38	100.00%	322,434,629.34	100.00%	-80.51%
IC 设计服务	人工	39,819,036.33	60.11%	0.00	0.00%	不适用
IC 设计服务	外协费	14,646,807.59	22.11%	0.00	0.00%	不适用
IC 设计服务	其他	11,782,843.12	17.79%	0.00	0.00%	不适用
IC 设计服务	营业成本	66,248,687.04	100.00%	0.00	0.00%	不适用

同比变化 30%以上

☒适用 ☐不适用

报告期内 MEMS 纯代工相关成本较上年同期减少，主要因 2025 年 7 月公司出售瑞典 Sillex 股权，丧失对其控制权，本期瑞典 Sillex 不再纳入合并报表范围；新增 IC 设计服务相关成本，主要因为公司 2025 年 9 月收购展诚科技股权，取得其控制权纳入合并范围，新增 IC 设计服务业务所致。

研发投入情况

报告期内，公司共计投入研发费用 19,899.89 万元，较上年同期基本持平，占营业收入的 111.56%，报告期内主要研发投入项目如下：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
MEMS 硅麦克风制造技术	掌握硅麦克风系统制造方案，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能硅麦克风的制造。	推进技术攻关与基础应用研发、推进产品器件制造。已经实现中低端产品的量产，正在开发高端产品。	提高 MEMS 硅麦克风的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子等领域客户的制造需求。	充分发挥 MEMS 硅麦克风尺寸小、性能优良、一致性高等特点，促进公司 MEMS 硅麦克风制造业务的发展。
MEMS 微压差制造技术	掌握微压差系统制造方案，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能微压差产品的制造。	初步技术方案正在客户的终端产品上验证。	基于目前 fab 的工艺基础，实现微压差产品的大规模量产。	充分发挥 MEMS 微压差尺寸小、性能优良、一致性高等特点，促进公司 MEMS 微压差制造业务的发展。
MEMS 射频滤波器制造技术	掌握适用高频段的体声波（BAW）滤波器的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能滤波器的制造。	继续推进基础单步工艺研发及集成工艺整合。已实现多个波段以及掺铌 BAW 滤波器的量产。2024 和 2025 年持续推进双工器、四工器等多款高端滤波器的量产。	形成 BAW 滤波器的商业化、规模化 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自国内滤波器设计厂商的本土制造需求。	继续开辟 5G 通信市场的新产品领域，促进公司 BAW 滤波器制造业务的发展。

MEMS 射频谐振器制造技术	掌握谐振器集成制造技术，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能谐振器的制造。	已完成薄膜沉积工艺、薄膜刻蚀工艺研发，谐振器设计参数提取优化，器件性能达到客户需求。	形成面向谐振器的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	继续开辟 5G 通信市场的新产品领域，促进公司 MEMS 滤波器、谐振器制造业务的发展。
MEMS 微波前端模块制造技术	掌握微波前端模块的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能微波前端模块的制造。	完成基于 MEMS 工艺的微波/毫米波器件关键制造技术优化；针对第四版设计（ver4，MPW），继续在公司产线流片；与外协单位一起搭建测试环境。	形成面向射频/毫米波前端器件、射频/毫米波前端模块的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备市场潜力的 6G、太赫兹通信新产品领域，促进公司在高频通信、汽车雷达 MEMS 器件制造业务的发展。
MEMS 微波功分器制造技术	掌握高频通信器件的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高性能微波功分器的制造。	继续新设计 MPW（ver4）流片；开始设计相应的 PCB 测试板。	形成面向高频通信器件的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的 6G、太赫兹通信产品领域，促进公司高频通信器件制造业务的发展。
激光雷达 MEMS 微振镜制造技术	掌握激光雷达振镜的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现激光反射镜与电磁二维驱动器的集成，实现小型化、低成本、高精度微振镜的制造。	已实现车规级产品量产，包括多款振镜产品均进入量产阶段。目前工艺稳定，产品良率处于较高水平。	形成面向激光雷达振镜的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司微振镜制造业务的发展。
MEMS 气体传感器芯片制造技术	掌握气体传感器器件的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现低功耗、高可靠性气体传感器的制造。	已经完成多种结构和多种气体敏感的气体传感器的研制，完成关键单步工艺及集成技术的开发。已实现多款气体传感器的风险生产。目前产品在终端客户处已经在白色家电和工业上实现了应用。	形成面向气体传感器器件的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司气体传感器制造业务的发展。
MEMS 生物芯片制造技术	掌握生物芯片的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现硅衬底与玻璃衬底的兼容，实现生物机电系统的低成本、大批量制造。	持续小批量生产中，包括多款微流控传感器。同时针对不同市场需求，持续研发新的产品。	形成面向生物芯片的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，在芯片表面构建微型生物化学分析系统，实现生物基因信息的准确、快速、大量检测，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司生物芯片制造业务的发展。
MEMS 加速度计制造技术	掌握面向第三代惯性器件的低成本制造技术，解决稳定性、可量产性、可迭代性等方面的问题。	部分型号加速度计产品已实现试产，目前正在推进集成工艺整合，提高良率。同时迭代产品，针对消费级市场做新的设计开发。	提高 MEMS 惯性传感器的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子领域客户的制造需求。	有利于发挥公司原有技术积累，促进公司 MEMS 惯性传感器制造业务的发展，带动相关封装测试业务。
MEMS 惯性 IMU 制造技术	掌握面向第三代惯性器件的低成本制造技术，解决稳定性、可量产性、可迭代性等方面的问题。	正在小批量试产。	提高 MEMS 惯性传感器的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子、工业汽车领域客户的制造需求。	有利于发挥公司原有技术积累，促进公司 MEMS 惯性传感器制造业务的发展，带动相关封装测试业务。
车用 MEMS 惯性传感制造技术	掌握车用惯性传感器器件制备工艺，基于已有经验进一步研发车用 MEMS 惯性传感器件生产制造工艺。	单步工艺和初步验证已经完成，已经敲定量产设计。正在针对不同的需求进行流片。	提高 MEMS 惯性传感器的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子、工业汽车领域客户的制造需求。	有利于发挥公司原有技术积累，促进公司 MEMS 惯性传感器制造业务的发展。

MEMS 硅光子通信芯片制造技术	掌握硅光子芯片的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术在芯片上构建高性能光子组件的集成与大规模扩展，实现硅光子芯片的标准化工艺制造。	继续推进相关技术攻关与基础应用研发。	形成面向硅光子通信芯片的 MEMS 工艺开发及 CMOS 晶圆再加工的 MEMS 制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司硅光子制造业务的发展，为公司增加新的业务增长点。
MEMS 振荡器制造技术	掌握 MEMS 硅基振荡器的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术在硅晶圆上实现全温频率稳定的振荡器结构，以取代传统的石英振荡器。	初步全流程已经完成，已经测出基本性能，正在提高产品性能。	形成面向硅基振荡器的 MEMS 工艺研发及晶圆制造能力，服务并满足设计厂商需求，共同促进对传统石英振荡器的替代应用。	开辟时钟类产品新领域，促进公司 MEMS 振荡器制造业务的发展，为公司增加新的业务增长点，实现该类产品的国产替代。
MEMS 压力传感器芯片制造技术	掌握气体压力传感器器件的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现高灵敏度、宽检测量程，高可靠性的压力传感器的制造。	已经完成电容式和压阻式压力传感器的研制，完成不同类型传感器的正面和背面工艺开发。	形成面向压力传感器器件的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司压力传感器制造业务的发展，为公司增加新的业务增长点。
MEMS 热气泡喷墨打印制造技术	掌握 MEMS 热气泡喷墨打印头的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术在硅晶圆上实现精准微流控结构，实现新一代喷墨打印技术的产品化。	已经完成一款产品开发，正在进行多款新产品的研发。	提高 MEMS 热气泡喷头的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子、工业汽车领域客户的制造需求。	有利于发挥公司技术积累，开拓新的 MEMS 应用领域，促进公司相应代工业务发展，为公司增加新的业务增长点。
霍尔/磁隧穿磁性传感器制造技术	开发消费类、工业、车载霍尔/磁隧穿磁性传感器，以实现国产化的高精度的霍尔磁性传感器。	已完成向终端客户的送样。	实现高灵敏度的 MEMS 磁性传感器的量产，服务并满足工业的需求。	发挥公司原有技术积累，促进公司 MEMS 磁性传感器制造业务的发展。
8 英寸硅基 GaN 制造技术	实现大功率硅基 GaN 芯片的量产，结合目前 Fab 的基础工艺，增加部分 GaN 特色工艺	已完成所有的关键工艺和全流程的开发，全流程晶圆初步测试已达客户预期，正在针对全流程晶圆的性能部分在持续优化。	形成面向消费类和工业市场的 8 英寸硅基 GaN 芯片的量产。	开辟新的领域，促进公司硅基 GaN 业务模块的发展，实现该品类的全面发展，为公司增加新的业务增长点。
3D 硅电容 MEMS 器件制造技术	掌握 3D 硅电容 MEMS 产品的关键制造和生产技术，以 MEMS 工艺为基础实现大容量、小体积 3D 硅电容的制造，以取代传统的陶瓷电容。	产品全流程晶圆已经开发完成，初步达到客户预期。	服务并满足来自消费电子领域客户的制造需求，实现国产 3D 硅电容芯片的量产。	有利于发挥公司技术积累，开拓新的 MEMS 应用领域，促进公司相应代工业务发展，为公司增加新的业务增长点。
MEMS 光交换器件制造技术	掌握微镜阵列器件的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现高灵敏度、高可靠性的微镜阵列集成。	第一款产品已通过验证，已经进入小规模试产阶段。其余不同规格的 3 款产品全流程晶圆已经开发完成，正处于客户验证阶段。	形成面向微镜阵列的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，服务并满足来自设计厂商的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司 OCS 光交换器件领域相关业务的发展。
MEMS 射频调谐器	掌握 MEMS 射频调谐器集成制造技术，以 MEMS 工艺技术实现小体积、高可靠性的调谐器的制造。	单步工艺开发正在进行中。	形成 MEMS 射频调谐器的开发和制造能力，服务并满足设计公司的需求	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，促进公司射频调谐器相关业务的发展

MEMS 气体传感器研发	验证气体传感器全链条的关键技术，开发低功耗高灵敏度的气体传感器。	继续进行气敏材料的芯片级涂敷沉积工艺、及封装；开展封装级别的气体传感器的电测试、性能测试。	完成与合作单位申请的气体传感器项目，将开发的气体传感器给应用方送样验证。	为其最终实现产业化铺垫基础，推进公司与高校对气体传感器的联合研发和成果转化。
MEMS 气体流量开关制造技术	掌握 MEMS 气体流量开关的关键制造技术，以 MEMS 工艺技术实现低功耗、高灵敏度的气体流量开关传感器的制造。	完成 MEMS 气体流量晶圆流片；正外协进行晶圆减薄、划片，准备下一步的器件封装。	提高 MEMS 气体流量开关的工艺开发及晶圆制造水平，服务并满足来自消费电子等领域客户的制造需求。	充分发挥 MEMS 尺寸小、性能优良、一致性高等特点，促进公司在 MEMS 气体流量开关制造业务的发展。
基于 MEMS 工艺的微型天线制造技术	基于高频微空腔传输结构技术，研发用于高频通信的微型天线/阵列天线。	继续进行天线晶圆流片，收集、分析工艺制造过程中数据。开展了新的天线结构设计 with 电学仿真。	进一步形成面向高频通信器件的多系列 MEMS 高频微型天线；服务并满足来自设计厂商对高频微器件的制造需求。	开辟具备巨大市场潜力的 5G 毫米波、6G 和太赫兹通信产品领域，促进公司高频通信器件制造业务的发展，为公司增加新的业务增长点。
高性能氮化镓器件产业化应用	解决目前制约氮化镓器件在服务器、数据中心以及消费电源端产业化应用面临的技术难题。	继续推进功率芯片在 5G+/6G 通信中的应用。开始设计通信频率更高、插损较低的毫米波前端模块。	建设高性能氮化镓器件制造平台，开发出具有自主知识产权的氮化镓功率器件和电源模块。	开辟具备巨大市场潜力的新产品领域，拓展公司氮化镓器件制造业务（功率器件）的发展，为公司增加新的业务增长点。
持续性研发活动-MEMS 工艺研发	根据行业发展趋势及客户需求，围绕硅/金属通孔、晶圆键合及深反应离子刻蚀工艺以及压电材料、磁性材料及聚合物材料等进行研发。	继续对混合直接键合等永久键合技术进行攻关，初步解决了多晶圆永久键合工艺中温度梯度设计、应力控制等难点。	进一步提高 MEMS 代工领域技术壁垒，巩固竞争优势，不断提高工艺开发及晶圆制造水平。	有利于公司 MEMS 业务的持续增长。
先进 MEMS 工艺设计与服务（北京市工程研究中心）	开展共性关键单点工艺技术研发、共性关键集成工艺技术研发、MEMS 晶圆级生产制造工艺技术研发，推动 6 寸 MEMS 产品中试到 8 寸 MEMS 产品量产的连贯衔接。	初步完成 MEMS 器件的晶圆级剥离技术攻关；能进行芯片及模块级的硅衬底剥离。毫米波器件的整晶圆剥离方案（2 种）均已设计进 MEMS 毫米波晶圆第四版（ver4）。目前已经在流片。器件制造完成后，将分别采用两种技术，进行整晶圆剥离实验。	搭建先进 MEMS 工艺研发体系，打造中试公共服务中心，引进吸收国际先进 MEMS 代工技术，为国家、北京市相关重大战略任务、重点工程提供研发和试验条件，推动重大科技成果在京转化落地。	推动公司 MEMS 晶圆级生产制造工艺技术研发，提供多品种小批量 MEMS 工艺定制化服务平台，为公司增加新的业务增长点。
MEMS 器件晶圆级集成封装制造技术	开展三维多轴 MEMS 器件的晶圆级集成封装制造技术的研究，建立相应的技术创新平台，以获得大规模三维多轴（多个）异质 MEMS 器件晶圆级集成封装制造生产能力。	根据 MEMS 器件的 3D 集成封装新设计，正在流片；面对基于 CPO 的 AI 数据中心传输互连系统火爆的新形势，正在积极准备、调研 CPO 所需的 Chiplet 技术、结合公司现有设备能力，筹划如何切入。	形成 MEMS 器件及晶圆级集成封装制造能力，服务并满足来自封装客户的制造需求。	开辟公司在 MEMS 器件及晶圆级集成封装的新业务领域（特别是 AI 数据中心高速信号传输互连领域），促进公司相应新封装业务的发展。
MEMS 多高频器件三维晶圆级异质异构集成关键技术开发	开展 MEMS 多高频器件三维晶圆级异质异构集成关键技术（厚硅高频 TSV、晶圆级共晶永久键合等）研发，形成相关晶圆级异质异构集成的成套工艺。	复杂多 MEMS 高频器件二维模块晶圆流片完成；正在进行晶圆减薄、划片。正在进行高频 TSV 工艺难点分析、技术攻关。	建立公司三维 MEMS 高频器件晶圆级异质异构集成工艺平台；制备相应的集成样品晶圆。	建立 MEMS 高频器件制造平台；拓展公司 MEMS 相关技术积累，为公司 5G+、6G 和太赫兹通讯时代到来，做好相应工艺技术准备。

集成电路数字单元版图自动化设计项目研发	开发提高集成电路设计效率的集成电路数字单元版图自动化设计工具。	已经完成了常用数字单元的收集整理，基于这些单元实现了版图的自动生成功能。	针对复用性比较高的数字单元，进行版图特征的抽象提取，开发工具自动生成版图。	有利于发挥公司的技术积累，赋能公司的集成电路后端设计服务业务，促进公司业务增长。
集成电路鳍栅及围栅器件的 RC 寄生参数提取 EDA 软件研发	掌握基于鳍栅及围栅器件的电阻电容建模方法学，实现对集成电路后端版图设计中的鳍栅器及围栅器件的寄生电阻和电容的抽取。	实现了对特定工艺下鳍栅及围栅器件的后端寄生参数提取。	完善公司的寄生参数提取 EDA 软件功能，支持更多的集成电路制造工艺。	开辟具备巨大市场潜力的集成电路 EDA 设计工具领域，促进公司 EDA 业务领域的发展。
C341B 高压降压开关控制器的研发	掌握基于高压工艺的集成电路后端设计关键技术，结合已有的设计经验，完善公司的技术储备。	实现了整个功能的完整开发，通过了最终的物理验证。	支持宽输入的电压范围，并且在此基础上有精确电压控制和快速的动态响应。	有利于发挥公司技术积累，开拓新的设计服务领域，促进公司相应业务发展。
基于先进 RDL 工艺的射频集成无源芯片设计与制备	开发亚微米级 RDL 工艺技术，实现高品质精细线路制作，设计兼容 RDL 工艺的多功能集成无源器件，满足下一代通信对小型化、低损耗射频电路的需求。	已完成亚微米 RDL 工艺金属层、介质层沉积与布线图形形成的核心技术路线论证，完成多功能集成无源器件的原理设计与仿真验证，后续研究基于三维 RDL 互连的异质集成方案预研，完成关键互连结构的可行性分析。	实现高品质亚微米 RDL 工艺设计能力，建立基于 RDL 的异质集成射频芯片封装技术研究平台。	有助于公司在先进封装与射频集成领域形成核心技术壁垒，促进业务规模与盈利能力持续增长。
集成电路模拟 IP 版图 AI 自动布局技术研发	开发基于 AI 的集成电路模拟 IP 版图自动布局技术，解决传统模拟版图设计依赖人工经验、效率低、周期长的痛点，提升模拟 IP 版图设计的自动化水平与设计效率，缩短产品研发周期。	已完成模拟版图布局规则与约束的数字化建模，搭建了基于深度学习的版图布局预测模型，可对特定模拟 IP 模块进行初步自动布局生成。	实现对特定模拟 IP 模块的 AI 自动布局生成，布局结果接近人工水平，降低人力成本，形成可复用的 AI 布局技术平台。	有助于公司在模拟集成电路设计领域建立核心技术优势，提升项目交付效率与客户满意度，增强市场竞争力与可持续发展能力。
集成电路高性能工艺库的开发	本项目针对 FinFET 和 SOI 不同的工艺节点，开发高性能的工艺库，解决国内集成电路设计领域在低功耗、高性能芯片设计中的迫切需求。	已完成特定工艺 SOI 及 FinFET 工艺节点的工艺角参数采集与建模，搭建了工艺库特征化提取平台，启动 STD 标准库核心单元的电路设计与版图绘制。	完成高性能 STD 库的全流程开发与验证，库单元的关键指标达到先进主流水平，支持主流 EDA 工具。	助力公司突破先进制程工艺库核心技术壁垒，拓展先进制程设计服务市场，促进公司业务增长。
集成电路数字标准单元设计自动优化系统	开发一套提升数字电路设计性能的自动化流程，通过数据仿真、算法优化与对比分析，提升数字单元性能，达成产品性能更优、尺寸更紧凑的设计目标，增强产品竞争力。	已完成特定工艺下数字标准单元的基础数据采集与仿真建模，搭建了自动优化算法框架，实现对单元延迟、功耗、面积的多目标优化迭代。	完成一套集成电路数字标准单元设计自动优化系统，形成可复用的优化流程与工具链，可快速移植到其他工艺节点，提升数字单元设计的整体效率与性能。	有助于公司在成熟工艺平台上建立数字标准单元优化的核心技术优势，促进公司数字设计业务增长。
国产集成电路高性能数字标准库 EDA 软件的研究及应用	本项目主要围绕国产 Foundry 工艺平台在数字标准单元库的设计与优化性能需求，开展完全国产化的	已完成立项和团队组建，核心技术方案已明确，正围绕国产 Foundry 工艺平台的数字标准单元库设计与优化需求，开展 EDA 工	面向市场需求的定制化标准单元设计方法，能够根据用户在性能、功耗、面积及可靠性方面的特定需求生成差异化	有助于公司在成熟工艺平台上建立数字标准单元优化的核心技术优势，促进公司数字设计业务增长。

	EDA 工具研发，力求突破国内在数字 EDA 领域长期受制于人的技术瓶颈。	具的前期架构设计和关键技术预研。	单元库，实现 EDA 工具的柔性化与定制化应用。	
--	---------------------------------------	------------------	--------------------------	--

研发投入情况说明：

(1) 主营业务

公司在 MEMS 业务深耕多年，积累了丰富的工艺开发经验，与下游客户开展广泛合作，工艺开发能力、晶圆制造能力具备业界领先的竞争力。为继续保证在 MEMS 工艺开发及晶圆制造的业界领先地位，公司需要持续进行对 MEMS 业务核心技术开发所需各项资源的投入；同时为持续强化并夯实 IC 设计服务业务的发展，也需要进行相应的投入。

(2) 人员构成

截至报告期末，公司研发及技术人员 779 人，占员工总数的 74.40%。研发及技术人员中，博士及以上学历 51 人，占比 6.55%；硕士学历 97 人，占比 12.45%；本科学历 539 人，占比 69.19%；大专及其他 92 人，占比 11.81%。研发及技术人员普遍工作年限较长。

报告期内，公司持续引进优秀技术人才，充实核心技术人员团队。

(3) 相关无形资产

截至报告期末，公司已注册集成电路商标 14 件；累计拥有/享有集成电路软件著作权 57 项，各项集成电路专利 76 项；正在申请的集成电路专利 125 项，具体如下：

1、集成电路商标

序号	商标名称	商标注册号	核定使用商品/服务项目类别	商标有效期	所有权人
1		31817421	42	2029.05.20	赛莱克斯国际
2		31814417	42	2029.05.20	赛莱克斯国际
3	展诚	31381278	09	2029.5.20	展诚科技
4	Z-xchip	37879496	09	2029.12.20	展诚科技
5	N-chip	37895990	09	2030.3.13	展诚科技
6	Z-chip	56761236	09	2032.10.13	展诚科技
7	ZapRC	66998746	09	2033.3.6	展诚科技
8	Zcad	67010993	09	2033.2.27	展诚科技
9	Zchip	67011095	09	2033.2.27	展诚科技
10	Zealayout	67059914	09	2033.7.6	展诚科技
11	ZapeRC	81461116	42	2035.4.13	展诚科技
12	ZapeRC	81463575	09	2035.4.13	展诚科技
13	ZappeRC	81459266	09	2035.4.13	展诚科技
14	ZappeRC	81463567	42	2035.4.13	展诚科技

2、集成电路软件著作权

序号	软件著作权名称	取得方式	所有权人
1	Applica 一拖多系统软件	原始取得	展诚科技
2	集成电路组件版图电流信息优化系统	原始取得	展诚科技

3	集成电路芯片版图设计参数提取系统	原始取得	展诚科技
4	集成电路版图设计工艺规则验证系统	原始取得	展诚科技
5	集成电路芯片版图设计信息提取系统	原始取得	展诚科技
6	集成电路后端版图自动产生 LOGO 标示系统	原始取得	展诚科技
7	集成电路后端版图自动产生 padlist 系统	原始取得	展诚科技
8	集成电路后端版图十字标尺测距系统	原始取得	展诚科技
9	集成电路后端版图可移植工艺分析系统	原始取得	展诚科技
10	集成电路后端布局电阻设计优化系统	原始取得	展诚科技
11	集成电路后端电压信号检测分析系统	原始取得	展诚科技
12	集成电路后端元件设计工艺分析系统	原始取得	展诚科技
13	集成电路后端设计批量验证系统	原始取得	展诚科技
14	集成电路后端内部电流走向分析设计系统	原始取得	展诚科技
15	集成电路后端器件自动标示系统	原始取得	展诚科技
16	集成电路后端内部对称电路设计系统	原始取得	展诚科技
17	集成电路版图图形面积提取系统	原始取得	展诚科技
18	集成电路版图图形周长提取系统	原始取得	展诚科技
19	集成电路 CMOS 工艺文件移植系统	原始取得	展诚科技
20	集成电路失效检测及模拟仿真软件	原始取得	展诚科技
21	展诚集成电路阵列设计系统	原始取得	展诚科技
22	展诚集成电路测试优化软件	原始取得	展诚科技
23	展诚集成电路工艺格点验证及复位系统 V1.0	原始取得	展诚科技
24	展诚集成电路批量处理多通道线路系统 V1.0	原始取得	展诚科技
25	展诚集成电路区域密度修复系统 V1.0	原始取得	展诚科技
26	集成电路自动更改 ESD 参数与 layers 系统	原始取得	展诚科技
27	集成电路版图冗余金属高效处理系统 V1.0	原始取得	展诚科技
28	集成电路版图 label 格点检查系统 V1.0	原始取得	展诚科技
29	集成电路器件信息可视化显示系统 V1.0	原始取得	展诚科技
30	集成电路后端触发器版图自动生成系统 V1.0	原始取得	展诚科技
31	集成电路版图单元智能随机排列系统 V1.0	原始取得	展诚科技
32	集成电路寄生参数提取系统 V1.0	原始取得	展诚科技
33	Z-RC 寄生参数提取软件 V1.2	原始取得	展诚科技
34	Z-Alayout 集成电路物理设计自动化软件 V1.0	原始取得	展诚科技
35	模拟集成电路版图器件匹配增强系统 V1.0	原始取得	展诚科技
36	模拟集成电路版图合规性自动校验系统 V1.0	原始取得	展诚科技
37	集成电路标准单元多目标 PPA 智能优化系统 V1.0	原始取得	展诚科技
38	FinFET 工艺数字标准单元库多工艺角仿真系统	原始取得	展诚科技
39	芯诚集成电路区域 layer 密度测量系统	原始取得	芯诚微电子
40	芯诚集成电路 path 线批量切除系统	原始取得	芯诚微电子
41	集成电路后端版图 path 走线自动连接系统	原始取得	芯诚微电子

42	DRC 比较分析系统	原始取得	宁芯微电子
43	半导体物理知识智能考评系统	原始取得	宁芯微电子
44	电路模块信息记录系统软件	原始取得	宁芯微电子
45	电容抽取的回归测试系统	原始取得	宁芯微电子
46	电阻抽取的回归测试系统	原始取得	宁芯微电子
47	基于网页的学习测试系统	原始取得	宁芯微电子
48	基于知识图谱的习题智能推送系统	原始取得	宁芯微电子
49	晶体管多晶硅的电阻网络计算系统	原始取得	宁芯微电子
50	客户需求寄存器表自动检查系统	原始取得	宁芯微电子
51	宁芯微测试系统	原始取得	宁芯微电子
52	宁芯微基于 ICC 平台的 TIO 检测工具软件	原始取得	宁芯微电子
53	宁芯微接口控制器系统	原始取得	宁芯微电子
54	宁芯微数字仿真系统	原始取得	宁芯微电子
55	宁芯微数字设计系统软件	原始取得	宁芯微电子
56	通讯配置信息系统软件	原始取得	宁芯微电子
57	自动比较不同系统电容电阻抽取差异系统	原始取得	宁芯微电子

3、集成电路专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	专利权人	注册国家/地区
1	一种在 MEMS 结构中制造金属引脚垫的方法	2018104905190	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
2	一种接触窗的形成方法	2018104890301	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
3	一种空气芯微同轴传输线的制造方法及生物传感器	2021114533425	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
4	一种电镀设备以及电镀生产线	2021112772991	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
5	用于 TSV 微孔电沉积铜填充工艺的添加剂和电解液	2021108381247	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
6	一种微同轴工艺误差的补偿方法及微同轴	2021111985755	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
7	微同轴传输结构及其制备方法、电子设备	2021111995422	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
8	微同轴传输结构及其制备方法、电子设备	2021111995598	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
9	高频传输微结构的平坦化方法、装置及电子设备	2022108110057	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
10	抛光垫修整器、化学机械抛光装置和方法	202210412559X	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
11	一种谐振器的调频方法	2021107896960	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
12	一种微机电毫米波天线	202210546500X	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
13	一种微同轴传输线的阻抗匹配结构	2022105635424	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
14	振膜、MEMS 麦克风及 MEMS 传感器	2023218772896	实用新型	原始取得	赛莱克斯北京	中国
15	一种薄膜体声波谐振器和高频射频器件	2021107800934	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国

16	一种晶圆电镀回液管及晶圆电镀设备	2022106416509	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
17	一种晶圆传送装置和电镀系统	2022106416922	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
18	一种图形化方法	2024102524842	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
19	一种 MEMS 微同轴功分器	2022105604356	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
20	一种三维晶圆集成结构及其制备方法、电子设备	2020113927529	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
21	一种薄膜体声波谐振器及其制备方法	202011402902X	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
22	一种高频器件集成模块和模组	2021107889878	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
23	一种晶圆运输机械手	2021112772900	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
24	一种晶圆临时键合方法及解键合方法	2022105229967	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
25	一种晶圆电容的制作方法、晶圆电容及电子设备	2020114024346	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
26	一种微系统薄膜平坦化方法	202210411851X	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
27	一种基于光刻胶的金属薄膜沉积方法及相关设备	2022116044697	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
28	一种半导体器件的制备方法及半导体器件	2022106178229	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
29	一种微同轴及其制备方法	2021115132906	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
30	一种微系统薄膜平坦化方法	2022104118505	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
31	一种射频模块、制作方法及电子设备	2021114476051	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
32	一种射频模组及射频器件	2021114532831	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
33	一种新型射频模块、制作方法及电子设备	2021114476155	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
34	一种半导体器件器件及制作方法	2021111838440	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
35	一种半导体器件的制造方法	2021111984517	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
36	芯片 ID 版图的确定方法、装置、设备及存储介质	2024116985238	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
37	导电结构制备方法、导电结构及机电系统	2024119436302	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
38	高灵敏度嵌套轮环单片三轴 MEMS 陀螺芯片	2024108125564	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
39	一种芯片、制备方法及电子设备	2022104924696	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
40	一种微波集成电路封装总成及其封装工艺	2022106735468	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
41	一种含光刻胶晶圆的平坦化方法	2022115784675	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
42	半导体器件和晶圆表面沉积层的去除方法	2022115996772	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
43	一种 MEMS 干法刻蚀方法、设备及 MEMS 器件	2023107923863	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
44	一种换能器、换能器阵列及换能器阵列的制作方法	2023110576204	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
45	空腔型薄膜体声波谐振器的制造方法	2022115973272	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国
46	MEMS 传感器的制备方法及传感器	2023105967284	发明专利	原始取得	赛莱克斯北京	中国

47	一种氮化镓充电座	2022100435722	发明专利	原始取得	海创微芯	中国
48	一种散热氮化镓充电座	2022100729321	发明专利	原始取得	海创微芯	中国
49	一种晶圆的键合方法	2022106178125	发明专利	原始取得	海创微芯	中国
50	厚胶光刻方法及微结构器件	2022107732486	发明专利	原始取得	海创微芯	中国
51	一种制作带有沟道或空腔的半导体结构的方法	2018104905129	发明专利	受让取得	赛微电子	中国
52	一种 MEMS 气体传感器及制作方法	2021108199668	发明专利	受让取得	赛微电子	中国
53	一种微机电器件制备方法及其装置	2018113569288	发明专利	受让取得	赛微电子	中国
54	用于单斜 ADC 的高线性度电压-时间转换方法及转换器	2015106907750	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
55	带失调消除的动态范围增强型读出方法及电路	2015106954304	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
56	基于矩匹配的 TDI-CMOS 图像传感器 FPN 校正方法	201610910923X	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
57	用于 AER 前馈分类系统的脉冲神经元硬件架构	2016111908743	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
58	用于延迟锁相环的单端负反馈电荷泵	2017107506183	发明专利	受让取得	展诚科技	中国
59	集成电路 FinFET 复杂三维结构描述文件的生成方法和系统	2022100102885	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
60	基于并行算法的集成电路电阻抽取方法	2022106180939	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
61	随机行走在电容抽取中的细粒度的并行处理方法	2023111083806	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
62	一种寄生参数压缩提取系统及方法	2023112064681	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
63	一种基于 OPC 的图像边缘优化方法	2023112145335	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
64	一种集成电路版图图形切割方法	2023113225572	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
65	用于集成电路的螺旋电感自动生成方法	2023113225568	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
66	一种基于 Mini-batch 梯度下降法的 3D 寄生参数的优化方法	2023113225604	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
67	基于 nfs 协议实现集成电路设计的多路同步共享数据系统	2023114018832	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
68	一种优化收敛 eda 工具寄生参数提取及多场景仿真方法	2024103389725	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
69	基于电气规则检测实现定位集成电路设计缺陷的方法	2024108705714	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
70	一种人工智能寄生参数分析和自动优化方法	2024108649413	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
71	基于共享器件的集成电路高效设计方法	2024108704425	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
72	基于 RDL 工艺的射频电阻器校准结构及制造方法	2025107794062	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
73	基于大数据与数理统计的多情况电容决策因子处理方法	2025109187543	发明专利	原始取得	展诚科技	中国

74	基于 RDL 工艺的多层螺旋电感结构及制备方法	2025107792599	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
75	基于 RDL 工艺的射频集成电容结构及制备方法	2025107809373	发明专利	原始取得	展诚科技	中国
76	基于 FUZZ 测试的寄生参数结果自动化分析系统	2025109372065	发明专利	原始取得	展诚科技	中国

4、集成电路专利（正在申请）

序号	专利名称	申请号	专利类型	申请日期	取得方式	专利权人	申请注册国家/地区
1	一种微同轴结构的制备方法	2022107681997	发明专利	2022/6/30	原始取得	赛莱克斯北京	中国
2	一种晶圆光阻涂布方法	2022115785748	发明专利	2022/12/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
3	一种 MEMS 器件及其制备方法	2022115965986	发明专利	2022/12/12	原始取得	赛莱克斯北京	中国
4	光刻胶刻蚀液、微同轴光刻胶牺牲层释放方法及相关设备	2022116006888	发明专利	2022/12/13	原始取得	赛莱克斯北京	中国
5	一种单片微波集成电路的晶圆级封装方法	2022116639927	发明专利	2022/12/23	原始取得	赛莱克斯北京	中国
6	卫星通信终端天线、仿真方法及相关设备	2023100622827	发明专利	2023/1/17	原始取得	赛莱克斯北京	中国
7	一种微波天线	2023101082597	发明专利	2023/1/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
8	一种芯片、制备方法以及传感器	2023105745908	发明专利	2023/5/22	原始取得	赛莱克斯北京	中国
9	一种芯片测试方法	2023107218302	发明专利	2023/6/19	原始取得	赛莱克斯北京	中国
10	MEMS 器件的制造方法	2023107605447	发明专利	2023/6/26	原始取得	赛莱克斯北京	中国
11	台阶微结构的制备方法	2023108438441	发明专利	2023/7/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
12	具有深槽结构的 MEMS 器件的表面图形制备方法	2023109470834	发明专利	2023/7/31	原始取得	赛莱克斯北京	中国
13	一种微同轴结构及制备方法	2023109975858	发明专利	2023/8/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
14	一种基于硅通孔的片上变压器	2023109976456	发明专利	2023/8/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
15	半导体器件、制备方法及微机电系统 MEMS	2023110080406	发明专利	2023/8/10	原始取得	赛莱克斯北京	中国
16	晶圆电镀膜厚均匀性调整的阳性膜卡具装置	2023110133403	发明专利	2023/8/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
17	一种基于微同轴技术的毫米波器件制作方法及毫米波器件	2023110311896	发明专利	2023/8/16	原始取得	赛莱克斯北京	中国
18	一种同轴线 GSG 接头的制作方法及同轴线 GSG 接头	2023110368269	发明专利	2023/8/17	原始取得	赛莱克斯北京	中国
19	一种转接件、制作方法及芯片封装结构	2023110619407	发明专利	2023/8/23	原始取得	赛莱克斯北京	中国

20	通信终端天线以及通信终端	2023111102506	发明专利	2023/8/30	原始取得	赛莱克斯北京	中国
21	一种三维谐振器件及其制作方法	2023111208943	发明专利	2023/8/31	原始取得	赛莱克斯北京	中国
22	一种硅基芯片的平坦化方法及硅基芯片	2023111263230	发明专利	2023/9/1	原始取得	赛莱克斯北京	中国
23	一种芯片制备方法	2023113174335	发明专利	2023/10/12	原始取得	赛莱克斯北京	中国
24	一种微机电器件的制备方法、及微机电器件	2023115497355	发明专利	2023/11/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
25	微机电器件空腔结构的制作方法、及微机电器件	2023115496206	发明专利	2023/11/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
26	一种微机电器件的制备方法、及微机电器件	2023115495311	发明专利	2023/11/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
27	一种晶圆刻蚀方法及晶圆	202311600034X	发明专利	2023/11/28	原始取得	赛莱克斯北京	中国
28	双层金属引线的制造方法及 MEMS 器件	2023116386383	发明专利	2023/12/1	原始取得	赛莱克斯北京	中国
29	微机电器件硅通孔结构的制备方法、及微机电器件	2023117195773	发明专利	2023/12/14	原始取得	赛莱克斯北京	中国
30	MEMS 微镜及其制备方法	2024100347735	发明专利	2024/1/9	原始取得	赛莱克斯北京	中国
31	一种光刻方法	2024100566107	发明专利	2024/1/15	原始取得	赛莱克斯北京	中国
32	微机电器件硅通孔的制作方法、及微机电器件	2024100748482	发明专利	2024/1/18	原始取得	赛莱克斯北京	中国
33	一种图形化金属层制备方法	2024100807086	发明专利	2024/1/19	原始取得	赛莱克斯北京	中国
34	一种晶圆键合方法、芯片及电子设备	2024101082271	发明专利	2024/1/25	原始取得	赛莱克斯北京	中国
35	MEMS 器件的制造方法	2024101152255	发明专利	2024/1/26	原始取得	赛莱克斯北京	中国
36	一种芯片的制备方法及一种芯片	2024101149549	发明专利	2024/1/26	原始取得	赛莱克斯北京	中国
37	MEMS 微振镜的导线结构及制备方法、MEMS 微振镜	2024102270920	发明专利	2024/2/29	原始取得	赛莱克斯北京	中国
38	微机电器件的制作方法、及微机电器件	2024102737139	发明专利	2024/3/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
39	一种电子器件的制备方法及电子器件	2024102736386	发明专利	2024/3/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
40	MEMS 硅腔的刻蚀装置及刻蚀方法	2024102737891	发明专利	2024/3/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
41	一种光刻机的工艺控制方法及光刻机	2024102735877	发明专利	2024/3/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
42	一种晶片膜层表面处理方法、晶圆的制备方法及晶圆	2024104270770	发明专利	2024/4/10	原始取得	赛莱克斯北京	中国

43	基于聚酰亚胺的光刻工艺参数确定方法	2024104591428	发明专利	2024/4/17	原始取得	赛莱克斯北京	中国
44	一种电子器件的制备方法 及电子器件	2024108329222	发明专利	2024/6/25	原始取得	赛莱克斯北京	中国
45	一种平板电容器及其制 作方法	2024108234167	发明专利	2024/6/25	原始取得	赛莱克斯北京	中国
46	一种晶圆的键合切边方 法及键合晶圆	2024104844347	发明专利	2024/6/26	原始取得	赛莱克斯北京	中国
47	一种芯片的制备方法	2023117878811	发明专利	2023/12/22	原始取得	赛莱克斯北京	中国
48	全解耦四质量对称单片 三轴 MEMS 陀螺芯片	2024108125899	发明专利	2024/6/22	原始取得	赛莱克斯北京	中国
49	MEMS 芯片的制备方法	2024108634352	发明专利	2024/6/29	原始取得	赛莱克斯北京	中国
50	一种电子器件的制备方 法及电子器件	2024112907850	发明专利	2024/9/14	原始取得	赛莱克斯北京	中国
51	一种电子器件的制备方 法及电子器件	2024112909165	发明专利	2024/9/14	原始取得	赛莱克斯北京	中国
52	一种晶圆腔体制备方法 及晶圆	2024113081814	发明专利	2024/9/19	原始取得	赛莱克斯北京	中国
53	一种晶圆加工工装	2024113113105	发明专利	2024/9/20	原始取得	赛莱克斯北京	中国
54	一种图形化的方法及晶 圆掩膜版	2024114118784	发明专利	2024/10/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
55	一种均匀分布应力的多 晶硅薄膜的制备方法	2024114130023	发明专利	2024/10/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
56	一种电子器件的制备方 法及电子器件	2024114179538	发明专利	2024/10/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
57	多晶硅薄膜沉积设备、 制备方法及微机电器件	2024114496580	发明专利	2024/10/17	原始取得	赛莱克斯北京	中国
58	晶片退火装置及晶片退 火工艺方法	202411550464X	发明专利	2024/11/1	原始取得	赛莱克斯北京	中国
59	硅通孔晶圆的制造方法 以及半导体制造方法	2024119435193	发明专利	2024/12/27	原始取得	赛莱克斯北京	中国
60	微机电系统器件及其制 造方法	2025101333645	发明专利	2025/2/6	原始取得	赛莱克斯北京	中国
61	防止掺杂元素析出的多 晶硅及其制备方法	2025102026540	发明专利	2025/2/24	原始取得	赛莱克斯北京	中国
62	半导体结构及其制备方 法	2025104320401	发明专利	2025/4/8	原始取得	赛莱克斯北京	中国
63	一种掺钪氮化铝薄膜的 制备方法及掺钪氮化铝 薄膜	202510971666X	发明专利	2025/7/15	原始取得	赛莱克斯北京	中国
64	MEMS 微镜的制备系统 和制备方法	2025111173534	发明专利	2025/8/11	原始取得	赛莱克斯北京	中国
65	谐振器的制备方法及谐 振器	2025112417216	发明专利	2025/9/2	原始取得	赛莱克斯北京	中国
66	谐振器的制备方法及谐 振器	2025113176310	发明专利	2025/9/16	原始取得	赛莱克斯北京	中国

67	全解耦嵌套轮环单片三轴 MEMS 陀螺芯片	2025115763916	发明专利	2025/10/31	原始取得	赛莱克斯北京	中国
68	环拓扑八质量块全解耦单片三轴一体 MEMS 陀螺芯片	2025117756264	发明专利	2025/11/28	原始取得	赛莱克斯北京	中国
69	台阶结构的制备方法	2025120519230	发明专利	2025/12/31	原始取得	赛莱克斯北京	中国
70	MEMS 微镜及 MEMS 微镜阵列	2026101716543	发明专利	2026/2/6	原始取得	赛莱克斯北京	中国
71	一种晶圆翘曲度的矫正方法及晶片	2026102330668	发明专利	2026/2/27	原始取得	赛莱克斯北京	中国
72	一种调控晶圆翘曲度的方法及晶圆	2026104714836	发明专利	2026/4/10	原始取得	赛莱克斯北京	中国
73	一种芯片版图的切割及拼接的方法及芯片	2026104689143	发明专利	2026/4/10	原始取得	赛莱克斯北京	中国
74	一种晶圆表面残留物的处理方法	2026109935318	发明专利	2026/7/6	原始取得	赛莱克斯北京	中国
75	一种射频模组芯片的集成方法	2022106384207	发明专利	2022/6/7	原始取得	赛莱克斯北京	中国
76	气体传感器及其气敏膜的制造方法	202011392870X	发明专利	2020/12/2	原始取得	赛莱克斯北京	中国
77	一种硅通孔铜电镀液及其电镀方法	2021108419066	发明专利	2021/7/23	原始取得	赛莱克斯北京	中国
78	一种硅转接板的制备方法、及硅转接板	202311830554X	发明专利	2023/12/28	原始取得	赛微电子	中国
79	基于硅通孔技术的功分器	2024101037488	发明专利	2024/1/25	原始取得	赛微电子	中国
80	毫米波传输线的制造方法	2024101149248	发明专利	2024/1/26	原始取得	赛微电子	中国
81	基于空气芯微同轴的皮肤癌检测器及其制造方法	2024101166489	发明专利	2024/1/26	原始取得	赛微电子	中国
82	一种硅基衬底刻蚀方法及电子器件	202410121690X	发明专利	2024/1/29	原始取得	赛微电子	中国
83	声表面波谐振器及其制备方法	2024105169876	发明专利	2024/4/28	原始取得	赛微电子	中国
84	一种同轴电缆、同轴电缆的制造方法及传感器	2024111963340	发明专利	2024/8/29	原始取得	赛微电子	中国
85	一种三维互连传输线及制备方法	202411238636X	发明专利	2024/9/5	原始取得	赛微电子	中国
86	一种微同轴结构及制备方法	2024112486974	发明专利	2024/9/6	原始取得	赛微电子	中国
87	一种光敏传感器及其制备方法	2024119799306	发明专利	2024/12/31	原始取得	赛微电子	中国
88	易分离的阵列基底及其制备方法	2025107543859	发明专利	2025/6/6	原始取得	赛微电子	中国
89	一种三维互连结构及其制作方法	2025107490870	发明专利	2025/6/6	原始取得	赛微电子	中国

90	一种 MEMS 微镜器件、微镜矩阵及制备方法	2025108045456	发明专利	2025/6/17	原始取得	赛微电子	中国
91	压电谐振器及其控制方法	2025108242242	发明专利	2025/6/19	原始取得	赛微电子	中国
92	一种钛掺杂氧化镍纳米片气体传感器及其制备方法	2025108809879	发明专利	2025/6/27	原始取得	赛微电子	中国
93	一种气体传感器封装方法及传感器	202510880985X	发明专利	2025/6/27	原始取得	赛微电子	中国
94	MEMS 器件的制备方法 及 MEMS 器件	2025110817553	发明专利	2025/8/4	原始取得	赛微电子	中国
95	一种气体检测系统	2025112507509	发明专利	2025/9/3	原始取得	赛微电子	中国
96	三维高频传输互连密封结构及电子设备	2025120512640	发明专利	2025/12/31	原始取得	赛微电子	中国
97	微同轴传输结构、射频器件及微同轴传输结构的制备方法	2025120533187	发明专利	2025/12/31	原始取得	赛微电子	中国
98	柔性信号传输结构	2025120394926	发明专利	2025/12/31	原始取得	赛微电子	中国
99	复合界面的平坦化方法	2026100250724	发明专利	2026/1/9	原始取得	赛微电子	中国
100	一种功分器电路及半导体基板	2026100916951	发明专利	2026/1/23	原始取得	赛微电子	中国
101	微同轴传输结构的制备方法 及微同轴传输结构	2026101412641	发明专利	2026/2/2	原始取得	赛微电子	中国
102	一种芯片散热装置及制作方法	2022106356635	发明专利	2022/6/6	原始取得	海创微芯	中国
103	一种光刻胶显影方法	2022115785733	发明专利	2022/12/9	原始取得	海创微芯	中国
104	一种氮化镓晶体管	2023108223810	发明专利	2023/7/5	原始取得	海创微芯	中国
105	一种氮化镓晶体管动态导通电阻测试电路及测试方法	2023108342237	发明专利	2023/7/7	原始取得	海创微芯	中国
106	一种集成氮化镓及驱动系统的封装结构及电路组件	2023110298001	发明专利	2023/8/16	原始取得	海创微芯	中国
107	一种通孔结构的填充方法、及通孔结构	2024100506680	发明专利	2024/1/12	原始取得	海创微芯	中国
108	一种半导体器件的制备方法 及半导体器件	2024101308418	发明专利	2024/1/30	原始取得	海创微芯	中国
109	微同轴传输结构、制备方法 及电子器件	2024114520791	发明专利	2024/10/17	原始取得	海创微芯	中国
110	印刷电路板及其制备方法	2025101195255	发明专利	2025/1/24	原始取得	海创微芯	中国
111	传输线结构及其制备方法	2025101195310	发明专利	2025/1/24	原始取得	海创微芯	中国
112	一种功率分配器、分配方法、 组装方法和分配装置	2025101310412	发明专利	2025/2/6	原始取得	海创微芯	中国

113	系统级封装结构及其制备方法	2025105350777	发明专利	2024/4/27	原始取得	海创微芯	中国
114	印制电路板及其制备方法	2025105348813	发明专利	2024/4/27	原始取得	海创微芯	中国
115	多层电路板及其制备方法	2025105350349	发明专利	2024/4/27	原始取得	海创微芯	中国
116	微同轴传输结构的制备方法 及微同轴传输结构	2026106647592	发明专利	2026/5/14	原始取得	海创微芯	中国
117	基于 RDL 工艺的带通滤波器 结构封装方法	2025112613993	发明专利	2025/9/5	原始取得	展诚科技	中国
118	基于 RDL 工艺的射频无源 器件热管理结构制造方法	202511277193X	发明专利	2025/9/9	原始取得	展诚科技	中国
119	Socket 接口多任务协调的 寄生参数抽取方法及系统	2025112612346	发明专利	2025/9/5	原始取得	展诚科技	中国
120	基于权重的分布式精度抽取 方法	2025112624451	发明专利	2025/9/5	原始取得	展诚科技	中国
121	一种带悬浮金属的电容网络 精简方法	2025112770566	发明专利	2025/9/9	原始取得	展诚科技	中国
122	一种高度并行化的阻容网络 的优化方法	2025112996632	发明专利	2025/9/12	原始取得	展诚科技	中国
123	一种用于电路参数优化的自 适应保真度模型调度方法及 系统	2025115169167	发明专利	2025/10/23	原始取得	展诚科技	中国
124	一种面向多工艺角的集成电 路性能一致性自动优化方法	2025115251250	发明专利	2025/10/24	原始取得	展诚科技	中国
125	一种基于电路拓扑结构感知 的集成电路自动化生成方法	2025115184449	发明专利	2025/10/23	原始取得	展诚科技	中国

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	781,635,901.11	25.14%	主要因报告期处置瑞典Sillex 部分股权所致。	否，公司出售联营企业部分股权不具有可持续性。
公允价值变动损益	2,577,492,322.41	82.91%	主要因报告期新增以公允价值计量的交易性金融资产及其他非流动金融资产所致。	否，公司按照相关资产/负债的期末公允价值确认当期损益，不具有可持续性。
资产减值	-22,678,174.26	-0.73%	主要因报告期计提存货跌价较上年同期增加所致。	否，公司仍将严格按照相关会计准则及会计政策对公司资产进行减值测试，谨慎客观地反映资产情况。

营业外收入	175,631.58	0.01%	主要因报告期产生零星非经营性收入所致。	否，零星非经营性收入不具有可持续性。
营业外支出	173,527.81	0.01%	主要因报告期产生零星非经营性支出所致。	否，零星非经营性支出不具有可持续性。
信用减值损失	48,427,177.15	1.56%	主要因报告期末坏账准备较上年末减少所致。	否，公司仍将严格按照相关会计准则及会计政策对公司资产进行减值测试，谨慎客观地反映资产情况。
资产处置收益	-16,511,220.61	-0.53%	主要因报告期处置固定资产所致。	否，相关收益受公司资产状况影响，不具有可持续性。

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,391,380,536.57	20.62%	2,244,368,874.18	25.11%	-4.49%	无重大变动。
应收账款	201,876,776.97	1.74%	293,225,623.06	3.28%	-1.54%	主要因报告期收回部分应收款项所致。
合同资产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无变动。
存货	301,357,187.61	2.60%	290,157,341.34	3.25%	-0.65%	无重大变动。
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无变动。
长期股权投资	648,755,817.93	5.59%	2,462,613,615.86	27.55%	-21.96%	主要因报告期处置参股公司瑞典 Silex 部分股权后，剩余股权转入其他非流动金融资产科目采用公允价值计量所致。
固定资产	1,462,777,768.23	12.61%	1,501,932,886.96	16.80%	-4.19%	无重大变动。
在建工程	427,940,365.38	3.69%	476,905,888.63	5.33%	-1.64%	无重大变动。
使用权资产	351,600,097.23	3.03%	376,634,024.71	4.21%	-1.18%	无重大变动。
短期借款	359,525,126.89	3.10%	253,397,568.67	2.83%	0.27%	主要因报告期短期借款增加所致。
合同负债	90,128,409.41	0.78%	115,193,080.37	1.29%	-0.51%	无重大变动。
长期借款	734,089,886.73	6.33%	754,615,128.64	8.44%	-2.11%	无重大变动。
租赁负债	117,529,999.29	1.01%	171,525,401.71	1.92%	-0.91%	主要因报告期内偿还售后回租业务租金所致。
交易性金融资产	13,790,603.66	0.12%	0.00	0.00%	0.12%	主要因报告期新增交易性金融资产投资所致。
应收票据	7,291,506.51	0.06%	34,338.00	0.00%	0.06%	主要因报告期公司子公司接受票据结算应收款项较期初增加所致。
其他应收款	78,733,237.01	0.68%	125,129,732.18	1.40%	-0.72%	主要因报告期收回

						部分其他应收款所致。
其他非流动金融资产	4,454,268,818.16	38.41%	0.00	0.00%	38.41%	主要因报告期处置参股公司瑞典Silex部分股权后，剩余股权转入其他非流动金融资产科目采用公允价值计量所致。
非流动资产合计	8,318,842,689.83	71.73%	5,732,655,588.39	64.13%	7.60%	综合因素所致。
应付职工薪酬	19,694,057.75	0.17%	34,897,273.94	0.39%	-0.22%	主要因公司子公司展诚科技报告期内支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	228,066,754.40	1.97%	6,656,147.03	0.07%	1.90%	主要因报告期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	61,136,553.49	0.53%	164,053,499.14	1.84%	-1.31%	主要因报告期退回政府补助款所致。
长期应付款	0.00	0.00%	31,494,400.00	0.35%	-0.35%	主要因报告期按照到期日重分类到其他应付款所致。
递延所得税负债	264,970,723.18	2.28%	12,916,902.49	0.14%	2.14%	主要因报告期内确认其他非流动金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债所致。
其他综合收益	-91,594,376.55	-0.79%	34,319,994.62	0.38%	-1.17%	主要因报告期外币财务报表折算等所致。
未分配利润	4,135,526,181.90	35.66%	1,704,231,080.21	19.06%	16.60%	综合因素所致。
归属于母公司所有者权益合计	9,039,863,671.86	77.95%	6,734,386,456.42	75.33%	2.62%	综合因素所致。
所有者权益合计	9,299,807,321.84	80.19%	7,021,319,525.99	78.54%	1.65%	综合因素所致。

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）		5,128,939.80			8,715,832.31		-54,168.45	13,790,603.66
5. 其他非流		2,572,363.3					1,881,905.4	4,454,268.8

动金融资产		82.61					35.55	18.16
金融资产小计		2,577,492,322.41			8,715,832.31		1,881,851,267.10	4,468,059,421.82
上述合计	0.00	2,577,492,322.41			8,715,832.31		1,881,851,267.10	4,468,059,421.82
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

交易性金融资产其他变动为外币折算差额，其他非流动金融资产其他变动主要为本期将持有瑞典 Silnex 剩余股权转让至其他非流动金融资产科目核算。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司权利受限的资产主要包括通过融资租赁方式买入的产线机器设备及电子设备期末账面价值 34,988.17 万元，用于并购贷款质押的展诚科技 56.24%股权和赛莱克斯北京 9.5%股权。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
202,006,574.73	193,786,170.15	4.24%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“集成电路业务”的披露要求

公司在报告期内涉及的重大投资项目，主要是境内产线的产能扩充（相应的设备采购），相关投资随业务订单及产能扩充需求处于持续发生状态，境内子公司的资金来源于自有及自筹资金。该等投资有利于公司提高半导体代工服务能力、促进公司半导体代工业务的发展。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	MEMS 工艺开发和晶圆制造	收购	623,627,400.00	19.00%	自有或自筹资金	-	长期	-	尚未完成交割	-	-	否	2026 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	---	---	623,627,400.00	---	---	---	---	---	---	-	-	---	---	---

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
8 英 寸 MEMS 国 际 代 工 线 建 设 项目	自建	是	MEMS	26,096,949.93	2,644,696,331.93	自筹及发行股份募集	85.38%	81,521,171.46	834,648,457.45	不适用		
合计	--	--	--	26,096,949.93	2,644,696,331.93	--	--	81,521,171.46	834,648,457.45	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
基金	8,715,832.31	5,128,939.80		8,715,832.31			-54,168.45	13,790,603.66	自有资金
股票	1,252,126,965.43	2,572,363,382.61					1,881,905,435.55	4,454,268,818.16	自有资金
合计	1,260,842,797.74	2,577,492,322.41	0.00	8,715,832.31	0.00	0.00	1,881,851,267.10	4,468,059,421.82	--

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

（1）委托理财情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒适用 ☐不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
瑞典 Sillex IPO 认购方	瑞典 Sillex 12,249,746 股普通股	2026 年 05 月 07 日	70,812.43	947.34	对公司利润表科目产生正向影响，给公司带来可观的现金资产和流入，有助于公司优化资产负债结构，进一步回笼资金并集中资源，为公司的国内业务发展、海外业务拓展、未来业务规划奠定较	21.85%	瑞典 Sillex IPO 发行价格	否	不适用	是	是	2026 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

					好的基础，符合公司当前的实际情况和中长期发展战略。								
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
赛莱克斯北京（经营业绩构成影响）	子公司	MEMS 工艺开发及晶圆制造	210,526.32 万元	3,039,847,870.86	922,927,112.24	81,521,171.46	-155,398,668.41	-118,188,107.80
赛积国际（经营业绩构成影响）	子公司	MEMS 先进封装测试与半导体设备销售	88,000 万元	976,976,529.13	586,839,118.05	10,269,977.71	-72,426,743.11	-72,426,743.11
展诚科技（经营业绩构成影响）	子公司	IC 设计服务	1,000 万元	180,150,951.22	58,660,798.43	87,520,539.01	3,866,773.36	4,218,241.91

注：2025 年 7 月，公司出售瑞典 Sillex 控制权，瑞典 Sillex 变为公司参股子公司。2026 年 5 月 7 日，瑞典 Sillex 成功在瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市交易，公司完成部分瑞典 Sillex 普通股 IPO 配售；截至本公告披露日，公司直接持有瑞典 Sillex9.90%普通股，同时公司按约定将瑞典 Sillex 上市增发普通股后 19.10%的普通股转让给 Bure，该 19.10%普通股将在瑞典 Sillex 首次公开募股锁定期承诺届满（锁定期 180 天）至公司与 Bure 双方约定时间内，由公司决策后，指令 Bure 协助择机出售，相关收益归公司所有。报告期内上述事项所产生的投资收益及剩余股权的公允价值变动收益是本报告期利润的重要来源，对公司非经常性损益金额影响巨大，详细内容烦请投资者参阅公司财务报表及附注。瑞典 Sillex 上半年财务数据烦请投资者参考其在官网 www.sillexmicrosystems.com 发布的相关报告。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、赛莱克斯北京于 2021 年 6 月启动正式生产。报告期内，赛莱克斯北京持续推动 MEMS 硅麦克风、惯性器件、气体流量开关、BAW（含 FBAR）滤波器、微振镜、气体、微流控、硅光子、振荡器、MEMS-OCs、3D 硅电容等不同类别、不同型号产品的工艺开发及产品验证，具有导入属性的工艺开发业务继续开展，带动着公司从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆产品类别持续增加，但报告期内由于赛莱克斯北京仍处于产能爬坡阶段，MEMS 业务收入规模仍较小，此外赛莱克斯北京研发投入依然保持较高强度，运营支出存在刚性，叠加折旧摊销等因素，本报告期尚处于亏损状态，若后续该产线的产能及良率实现持续提升，有望亏损收窄并最终实现盈利、成为公司重要的收入及利润来源。
- 2、赛积国际于 2022 年 10 月变更经营范围，增加与半导体设备相关业务。赛积国际作为公司 MEMS 封装测试业务的一级平台企业开展相关业务活动，同时兼顾支持公司旗下境内 MEMS 代工制造中试线；近年来赛积国际从多渠道采购了多批次半导体设备进行储备使用，根据公司业务发展的实际需要及环境变化，开展了部分与半导体设备相关的销售业务，在服务集团旗下 FAB 产线设备使用需要的同时，也根据市场需求服务于其他半导体制造企业，对外销售半导体设备。

3、2025 年 9 月，公司完成对展诚科技 56.24%股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00%股权。展诚科技专注于 IC 设计服务与 EDA 软件开发，拥有专业突出、经验丰富的 IC 设计工程师团队及 EDA 软件开发团队，向诸多全球知名 IC 设计公司提供多样化服务。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、MEMS 业务收入下降风险

公司于 2025 年 7 月出售瑞典 Sillex 控制权，瑞典 Sillex 不再纳入公司合并报表。2023-2025 年，瑞典 Sillex MEMS 业务收入占公司 MEMS 业务收入的比例分别为 85.56%、82.69%、77.72%；去年同期即 2025 年上半年，瑞典 Sillex 业务收入占公司 MEMS 业务收入的比例为 86.69%。瑞典 Sillex 控制权出售后，瑞典 Sillex 的收入不再纳入公司合并范围，静态情形下导致公司 MEMS 业务收入规模大幅下降。

应对措施：公司将拓展及巩固赛莱克斯北京 MEMS 纯代工业务及展诚科技 IC 设计服务业务，进一步聚焦和投入于国内核心业务，集中资源重点发展并深化运营北京亦庄 MEMS 量产线，持续深入推进研发创新、科技合作，并加快拓展下游市场，积极响应客户需求，全力推进工艺开发及产品验证，持续推动项目的落地和产出，通过多种方式实现公司总体的营收增长及高质量可持续发展。

2、业务协同不及预期风险

2025 年 9 月，公司完成对展诚科技 56.24%股权的收购，本次交易完成后公司合计持有展诚科技 61.00%股权，通过本次交易公司拓展了 IC 设计服务业务。得益于集成电路行业总体行业的发展以及展诚科技在 IC 设计服务领域领先的行业地位，展诚科技 IC 设计服务业务发展势头良好，但公司收购展诚科技还旨在进一步拓展和深化在 MEMS 纯代工、IC 设计服务领域的战略布局，即依托展诚科技在 IC 设计服务领域积累的产业资源，以“MEMS+”模式推动双方业务发展，促进公司半导体服务产业生态协同，进一步提升公司综合竞争实力、行业地位和竞争力。若公司未能有效应对与展诚科技在企业文化、技术体系差异、业务整合管理等可能的多重协同整合影响因素，双方业务或将难以高效协同，因此在未来一段时间内，存在公司与展诚科技业务协同不及预期的风险。

应对措施：其一，公司将推进企业文化融合，通过共同培训、团队共建、利益共享等，形成积极向上、团结互信、目标一致的企业文化，为后续强化技术协同、优化整合管理提供坚实的文化支撑；其二，公司将强化技术协同，推动 IC 设计服务与 MEMS 纯代工业务的有机结合，形成业务的相互促进及客户导入；其三，公司将优化整合管理，制定分层推进的整合计划，建立常态化沟通机制，通过派驻管理人员、调整董事会结构等方式强化管控，推动双方在业务流程、管理体系上的高效衔接。2026 年 3 月，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛展诚科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，展诚科技 2025 年完成承诺业绩。

3、非经常性损益利润波动风险

公司于 2025 年 7 月出售瑞典 Sillex 控制权，2026 年 5 月 7 日，瑞典 Sillex 成功在瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市交易，股票代码 SILEX。截至本公告披露日，公司直接持有瑞典 Sillex 9.90%普通股，并已按约定将瑞典 Sillex 上市增发普通股后 19.10%的普通股转让给 Bure，该 19.10%普通股将在瑞典 Sillex 首次公开募股锁定期承诺届满至公司与 Bure 双方约定时间内，由公司决策后，指令 Bure 协助择机出售，相关收益归公司所有。上述剩余股权为以公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产，在后续计量中，每期末需根据瑞典 Sillex 二级市场股价重新评估其公允价值，公允价值变动形成的利得或损失直接影响当期利润。故公司存在非经常性损益在当前与未来均会对公司利润造成显著波动的风险。

应对措施：公司已建立风险监控机制，财务部门、投资部门、证券部门密切关注公允价值变动，及时向董事会、审计委员会进行汇报。此外，公司将在未来择机适时处置以公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产，平滑跨期利润。

4、净利润与经营活动产生的现金流量不匹配风险

公司持有较大规模以公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产，对持有的金融资产，公司在各期末出售的情况下，上述公允价值变动损益仅为账面损益变动，无对应当期现金流入或流出，不产生实际现金流。受公允价值阶段性波动影响，公司各期账面净利润会随公允价值变动发生波动，但经营活动产生的现金流量与此并不关联，由此导致公司归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金流量存在巨大差异，出现两者不匹配的情况。未来随着公司所持金融资产公允价值持续波动，该差异将持续存在，存在公司净利润与经营活动产生的现金流量不匹配的风险。

应对措施：公司将结合市场行情、资金规划及整体经营战略，择机适时优化该类金融资产的持有结构与处置节奏，降低大额账面损益波动带来的利润与现金流错配影响，持续改善公司盈利质量与现金流匹配度，平稳公司整体经营财务状况。

5、新兴行业的创新风险

公司 MEMS 主业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也是国家“十五五”规划中的科技前沿攻关领域，该产业技术进步及迭代迅速，要求行业参与者不断通过新技术/工艺的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术/工艺、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，近年来，公司研发费用支出的绝对金额以及占营业收入的比重均处于高位，2023-2025 年及 2026 年上半年，公司研发费用分别高达 3.57 亿元、4.55 亿元、3.93 亿元、1.99 亿元，占营业收入的比重分别高达 27.44%、37.75%、47.66%、111.56%（2026 年上半年主要系瑞典 Silex 出表公司营业收入下滑，导致研发费用占营业收入比重大幅上升），而研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

应对措施：公司将一如既往地重视创新，在创新决策环节充分论证，以市场为第一导向，重视平衡创新的前瞻性与风险性；在创新实施环节优化创新组织机制，充分发挥技术创新的积极性，提高实施过程中的管理效率，并重视财务资金的合理筹划与风险管理。

6、行业竞争加剧的风险

公司 MEMS 主业直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、惠普、意法半导体、德州仪器等 IDM 企业，也包括 Teledyne、台积电、X-FAB、索尼、Atomica 等境外代工企业，以及芯联集成、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微、华鑫微纳等含 MEMS 业务的境内企业；IC 设计服务及 EDA 工具服务竞争对手包括创意电子、智原科技、灿芯股份、创耀科技、芯原股份、华大九天、概伦电子、广立微、行芯科技等。MEMS 属于技术、智力及资金密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来市场及产品竞争的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

应对措施：公司将继续加大研发投入与人才建设，在优势业务领域不断优化产品性能及丰富产品品类，扩大竞争优势；在新进业务领域，充分利用资本平台，发挥融资及扩张优势，尽快取得竞争优势。同时，注重分析公司产品在不同应用领域的市场特点，提高市场响应效率，同等重视国内与国际市场。

7、国际局势及汇率波动风险

自二战之后，特别是上世纪八九十年代以来，全球化发展日益加速，已成为时代发展的重要特征和显著标志，国家之间在经济、政治、文化、社会等方面的交流程度大幅提升，在加速科技进步和生产力发展的同时，也使得民族国家的利益面临着多元化的冲击和挑战，最终导致民族主义情绪的累积并在近年来显著抬头，右翼民粹主义、反全球化主义、贸易保护主义、本土主义等主张在全球，尤其是欧美国家泛起，引发国际局势紧张及日趋复杂化，对跨国经营的企业提出诸多新的挑战。公司同时持有境内外资产，虽然公司在 2025 年 7 月已完成瑞典 Silex 控制权出售的交割，但公司目前仍持有瑞典 Silex 股份，此外公司还涉及外币结算，日常涉及美元、欧元、瑞典克朗、日元、人民币等货币。因此，公司客观上面临

着国际政治经济局势剧烈变化的风险，随之而来的还包括因汇率大幅波动对公司报表业绩（以人民币计算）产生较大影响的风险。

应对措施：公司将密切关注所涉及各主要币种的汇率变化，积极开展外汇衍生品交易进行风险对冲，尽可能地控制因汇率变动对公司所造成的影响。

8、业务转型引致的管理风险

近年来，公司进行了重大战略转型，并于 2025 年 9 月完成 IC 设计服务为主要业务的展诚科技收购，形成以半导体为核心的业务格局，MEMS 成为分处不同发展阶段、聚焦发展的战略性业务，公司国际化程度也日益提升。虽然公司已积累一定的管理经验，努力建立适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度，根据变化持续补充、加强国际化经营管理团队，但上述战略与业务层面的转型幅度较大、速度较快，对公司运营管理水平提出了较高要求；随着资产、业务、机构和人员规模的结构化扩张，资源配置和内控管理的复杂度不断上升，公司现有管理架构、流程和团队可能无法完全适应业务发展所带来的变化。公司存在管理水平不能适应业务转型的风险，存在管理制度不完善导致内部约束不健全的风险。

应对措施：公司将根据发展现状，及时优化治理结构与制度，通过集团化管理，明确分工与授权，提升管理效率，不断完善各岗位职责，强化管理层的责任和担当意识，增强对各子公司的有效管控。公司将考虑采用行之有效的激励机制，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干，并通过多种渠道引进人才，优化人才梯队结构，有效降低业务发展带来的管理风险。

9、投资并购风险

近年来，公司已完成多起投资并购，投资控股或参股了多家公司、参与了部分产业基金的投资，但同时一些收购境外产线资产的交易也因非商业因素而遗憾失败。根据发展战略的需要，公司未来可能会实施新的并购重组或投资，以提高产业链及业务拓展效率，实现跨越式发展。如果将来选择的投资并购标的不恰当、所投资公司发展方向偏差、所合作核心团队出现不利变动，或者投资并购完成后未能做好资源及业务整合，以及再次受到非商业因素的影响，将存在投资并购的目标不能实现或不能完全实现的风险，亦存在着可能的商誉减值风险。

应对措施：公司将立足于长期发展战略规划，围绕公司所处行业的特点，结合公司实际情况，制定符合可持续发展的投资规划，并选择合适的并购方式对公司现有业务补充完善、优化整合，同时，加强投后管理工作，对已有的经营制度、管理模式和管理团队进行提升，保证公司的管理水平有效的满足各项业务的发展需要，促进公司治理、生产经营的协同发展，实现公司及并购标的高质量发展。

10、政府补助风险

公司 MEMS 业务在国际上属于新兴科技创新领域，在我国也属于国家鼓励发展的高科技行业（于 2021 年 3 月被纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中的科技前沿攻关领域）。近年来，公司已陆续获得数笔与主营业务相关的政府补助。2023-2025 年及 2026 年上半年，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 1.07 亿元、0.21 亿元、0.06 亿元、0.12 亿元，占当期利润总额绝对值的比例分别为 335.69%、8.27%、0.46%、0.40%，对 2023-2024 年公司经营业绩构成重大影响，对 2025 年及 2026 年上半年公司经营业绩构成一定影响。虽然通过政策支持、资金补贴、税收优惠和低息贷款等措施大力支持半导体行业（尤其是半导体制造环节）的发展属于国际通行做法，但公司在后续财务报告期间能否持续取得政府补助、涉及多少金额、会计处理方法等均存在不确定性，因此公司存在经营业绩受政府补助影响、影响大小不确定的风险。

应对措施：一方面，公司将努力提升产能及产能利用率、提升良率，扩大半导体业务体量，提高主营业务盈利能力；另一方面，公司将继续积极争取适用于主营业务的政府补贴及税收优惠。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 2 月 25 日	北京经济技术开发区科创八街 21 号	实地调研	机构	淡水泉基金、孝庸基金、领丰资本、腾飞	主要了解公司的概况和业务发展	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

	院赛微电子北京MEMS产业基地五楼会议室			资本	情况。	n/300456 赛微电子投资者关系管理信息 20260225
2026 年 4 月 2 日	线上交流	网络平台线上交流	其他	参与公司 2025 年度网上业绩说明会的投资者	主要了解公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/300456 赛微电子投资者关系管理信息 20260402
2026 年 4 月 23 日	北京经济技术开发区科创八街 21 号院赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司三楼报告厅	实地调研	机构	国信证券、申万电子、中航证券、中邮证券、国惠基金、建信基金、财达资管、国泰租赁、江西金控、苗氏药业、华福证券、中信证券、国泰海通、浙商计算机、新华基金、易方达基金、国寿资产、至御科技、陕西产投、山东发展租赁	主要了解公司的概况和业务发展情况。	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn/300456 赛微电子投资者关系管理信息 20260423

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，并结合公司实际情况，公司已制定《市值管理制度》。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为扎实提升公司质量和投资价值，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者，从聚焦主业发展，打造国际化经营的知名半导体制造领先企业；坚持自主研发，掌握核心技术；夯实公司治理，实现高质量发展；加强投资者沟通，提升信息披露质量；重视股东回报，共享发展成果五个方面制定“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

报告期内，公司继续聚焦 MEMS 主业发展，持续推动从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进，涉及产品范围覆盖了通信计算、生物医药、工业汽车、消费电子等诸多应用领域。公司已初步构建 MEMS 封装测试能力，同时依托并购展诚科技形成的业务基础，持续强化并夯实 IC 设计服务业务的发展，致力于为客户提供从设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造到封装测试的一站式综合服务，并将着重立足本土，拓展国际化运营。在研发投入上，公司坚持自主创新，报告期内继续保持了较高的研发强度；在股东回报方面，公司在报告期内完成 2025 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.70 元（含税）。未来，公司将继续重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障，努力实现在

MEMS 主业方面的技术及业务突破；同时持续优化公司治理，健全内控体系，持续提升规范运作水平，并通过强化投资者关系管理，积极与投资者进行沟通交流，切实保障股东权益。

未来，公司将一如既往坚持以投资者为本的理念，积极落实“质量回报双提升”行动方案，促进公司长远健康可持续发展，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张阿斌	董事会秘书	离任	2026 年 04 月 22 日	工作调动
徐永文	副总经理、董事会秘书	聘任	2026 年 04 月 22 日	工作调动
刘婷	独立董事	任期满离任	2026 年 06 月 26 日	个人原因
张路	独立董事	被选举	2026 年 06 月 26 日	个人原因

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	https://hjxxpl.bevoice.com.cn:8002/home

五、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

1、公司高度重视对投资者的合理投资回报，制定“质量回报双提升”行动方案，维护投资者合法权益。公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业发展成果。

2、公司坚持平等雇佣原则，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及国际劳工组织核心公约，制定《员工手册》《招聘管理办法》等规章制度，致力于构建公平、透明且无歧视的职场环境。公司深知公平与多样性对企业发展的重要性，坚决消除一切形式的就业歧视，并持续建设多元化的员工队伍。公司员工队伍多元化，汇聚了来自不同国家和文化背景的优秀人才，包括经验丰富的工程技术人员、海外技术专家等，尊重员工的个性化需求并提供相应支持。

3、公司在自身发展的同时，积极履行社会责任。公司充分利用行业资源与技术优势，为高校学子提供实践平台。多次接待清华、北大、北理工等顶尖高校的师生，分享行业知识和企业发展经验，帮助学子拓宽视野，增强理论与实践相结合的能力，推动产学研深度融合，促进行业人才培养。

4、公司还积极参与社区发展，增进社区福祉，关注慈善公益事业，组织员工开展志愿服务活动、“共产党员献爱心”捐献活动；坚持长期艰苦奋斗，通过各种方式，努力实现在 MEMS 主业方面的技术及业务突破，助力解决半导体高科技领域部分“卡脖子”问题，创造经济和税收效益。报告期内，公司荣获“2026 科技创新先锋奖”等奖项，以及“华证 ESG 评级 A 级”、“Wind ESG 评级 AA 级”。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
飞纳经纬与湖南三湘绿谷生态科技有限公司买卖合同纠纷一案已于 2025 年经法院调解结案，因湖南三湘绿谷生态科技有限公司未在调解书约定的期限内履行付款义务，故飞纳经纬提起诉讼，要求湖南三湘绿谷生态科技有限公司股东夏杏枚、乌国坤在湖南三湘绿谷生态科技有限公司不能清偿的部分承担补充赔偿责任。	315.2	否	一审结案	夏杏枚在未缴纳出资 750.75 万元范围内、乌国坤在未缴纳出资 250.25 万元范围内对湖南三湘绿谷生态科技有限公司欠付债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。	夏杏枚、乌国坤尚未履行。	2026 年 08 月 27 日	https://www.cninfo.com.cn/
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司诉赛莱克斯北京	592.86	否	一审未开庭	不适用	不适用	2026 年 08 月 27 日	https://www.cninfo.com.cn/
赛莱克斯北京离职员工劳动纠纷	30.16	否	已调解结案	赛莱克斯北京支付离职员工 30.16 万元。	赛莱克斯北京已支付离职员工 30.16 万元。	2026 年 08 月 27 日	https://www.cninfo.com.cn/
赛莱克斯深圳离职员工劳动纠纷	4.1	否	已结案	赛莱克斯深圳支付离职员工 4.1 万元。	赛莱克斯深圳支付离职员工 4.1 万元。	2026 年 08 月 27 日	https://www.cninfo.com.cn/

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

注：公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生所持公司 11,843,479 股股份被司法冻结（诉前保全），占其所持股份的比例为 7.69%，占公司总股本比例为 1.62%。该事项起因为杨云春先生控股的商业主体（非赛微电子及其子公司）与申请保全方的融资租赁合同纠纷。原告与被告在案件审理过程中自行和解达成协议，2026 年 6 月 24 日山东省青岛市中级人民法院予以确认，出具了《民事调解书》，案件已审理终结。根据《民事调解书》，欠款方应于 2026 年 9 月 30 日前（含当日）向青岛国信分批偿还未偿还款项。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海创智能装备（烟台）有限公司	本公司实际控制人控制的公司	采购商品	采购原材料	参照市场价格	协议约定	1.06	0.00%	-	-	货币资金	-	2026年08月27日	www.cninfo.com.cn
北京芯东来半导体科技有限公司	本公司实际控制人担任董事的企业	销售设备	销售半导体设备	参照市场价格	协议约定	530.97	15.66%	5,000	否	货币资金	-	2026年03月27日	www.cninfo.com.cn
穆林	本公司实际控制人之配偶	租赁办公场所	租赁穆林持有的房屋	参照市场价格	协议约定	13.41	3.61%	50	否	货币资金	6元/平/天	2026年03月27日	www.cninfo.com.cn
杨云春	实际控制人	租赁办公场所	租赁杨云春持有的房屋	参照市场价格	协议约定	10.82	2.92%	30	否	货币资金	4元/平/天	2026年03月27日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	556.26	--	5,080	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国家集成电路基金过去十二个月内曾为公司持股 5%以上股东，同时公司董事张帅	收购股权	收购赛莱克斯北京 19%股权	以符合《证券法》要求的评估机构出具的资产评估报告为基础，根据赛莱克斯	18,458.54	60,230	62,362.74	货币资金	-	2026年06月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

	先生由国家集成电路基金委派			北京目前实际经营、资产情况以及双方合作情况确定。							
海创智能装备（烟台）有限公司	为公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生实际控制企业且其担任执行董事	收购股权	收购海创智能装备持有的芯东来部分股权	以芯东来 2025 年 5 月融资投后估值 5 亿元为参考，并结合实际经营、资产、所在行业估值及未来发展、合作情况，经双方协商确定	551.16	-	2,223.1	货币资金		2026 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不会导致公司合并报表范围的变化，未对公司当期财务状况及经营成果产生重大不利影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
☐是 ☒否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

2026 年 3 月 26 日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司 2026 年度申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生为公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准，公司及子公司免于支付担保费用。该事项经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东为公司及子公司 2026 年度申请银行授信提供关联担保的公告》	2026 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
赛莱克斯北京	2026 年 03 月 27 日	170,000	2025 年 05 月 29 日	18,400	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届	否	否

								满之次日起两年		
赛莱克斯北京			2023 年 09 月 06 日	35,943.12	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛莱克斯北京			2025 年 04 月 23 日	7,000	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛莱克斯北京			2025 年 09 月 05 日	4,993.86	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
赛莱克斯北京			2025 年 09 月 30 日	7,970	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛莱克斯北京			2025 年 12 月 25 日	3,900	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛积国际			2025 年 09 月 05 日	4,329	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
赛积国际	2026 年 03 月 27 日	45,000	2022 年 10 月 31 日	23,925	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛积国际			2025 年 10 月 15 日	1,874.76	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
赛莱克斯国际	2026 年 03 月 27 日	86,000	2025 年 09 月 15 日	24,696.77	质押、连带责任担保	赛莱克斯北京 9.5% 股权		自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
海创微元	2026 年 03 月 27 日	50,000	2026 年 04 月 22 日	0.00	连带责任担保			自主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			351,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						4,636.6

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		351,000		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		133,032.51				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		351,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,636.6				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		351,000		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		133,032.51				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				14.72%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用						

注：公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议、2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于为子公司 2026 年度申请银行授信提供担保的议案》，其中新增担保额度包括新增担保及原有担保的续期。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、控股子公司股权变动

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司股权变动的议案》，公司控股子公司海创微元股东北京赛微私募基金管理有限公司将其持有的海创微元未实缴 9%的认缴出资以零对价转让给公司。本次交易完成后，公司将持有海创微元 51%股权，海创微元仍为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于控股子公司股权变动的公告》（公告编号：2026-023）。本次股权变动事项已于 2026 年 7 月 15 日完成工商变更登记。

2、2025 年度利润分配

公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》，公司以总股本 732,213,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.70 元（含税），具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。该利润分配预案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。公司 2025 年度利润分配已于 2026 年 4 月 28 日实施完成。

3、瑞典 Silex Microsystems AB IPO 上市及转让瑞典 Silex 部分股权

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于参股子公司瑞典 Silex 拟境外上市的议案》、《关于拟转让参股子公司瑞典 Silex 部分股权的议案》，为促进瑞典 Silex 业务开拓，保障其长远发展，包括公司在内的瑞典 Silex 股东及管理层拟共同推动瑞典 Silex 在瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）IPO 上市，公司（通过全资子公司赛莱克斯国际、运通电子分别持股）拟在瑞典 Silex 上市同一时点及后续协议约定期间转让持有的部分瑞典 Silex 普通股股权。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于参股子公司瑞典 Silex 拟境外上市的公告》（公告编号：2026-029）、《关于拟转让参股子公司瑞典 Silex 部分股权的公告》（公告编号：2026-030）。

2026 年 5 月 7 日，瑞典 Silex 已成功在瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市交易，股票代码 SILEX。瑞典 Silex 本次上市以 81 瑞典克朗/股的发行价增发 12,345,679 股普通股，增发普通股获得足额认购。

运通电子已将持有的部分瑞典 Silex 普通股，以 81 瑞典克朗/股的价格进行了 IPO 配售。截至目前，公司直接持有瑞典 Silex 9.90%普通股（锁定期 180 天）；同时公司已按约定将瑞典 Silex 上市增发普通股后 19.10%的普通股转让给 Bure，该 19.10%普通股将在瑞典 Silex 首次公开募股锁定期承诺届满（锁定期 180 天）至公司与 Bure 双方约定时间内，由公司决策后，指令 Bure 协助择机出售。

4、全资子公司赛莱克斯国际收购控股子公司赛莱克斯北京 19%股权

公司于 2026 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司赛莱克斯国际以挂牌底价 62,362.74 万元通过北京产权交易所进场摘牌的方式收购国家集成电路基金持有的公司控股子公司赛莱克斯北京 19%股权。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn/>）《关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-053）。赛莱克斯国际已向北京产权交易所支付本次交易全部价款。2026 年 7 月 10 日，赛莱克斯国际收到北京产权交易所出具的《产权交易凭证》。本次股权变动事项已于 2026 年 8 月 20 日完成工商变更登记。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	134,764,206	18.41%				-113,832	-113,832	134,650,374	18.39%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	134,764,206	18.41%				-113,832	-113,832	134,650,374	18.39%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	134,764,206	18.41%				-113,832	-113,832	134,650,374	18.39%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	597,448,928	81.59%				113,832	113,832	597,562,760	81.61%
1、人民币普通股	597,448,928	81.59%				113,832	113,832	597,562,760	81.61%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	732,213,134	100.00%				0	0	732,213,134	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨云春	134,307,539	0	0	134,307,539	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
张阿斌	245,929	61,482	0	184,447	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
刘波	191,838	47,925	0	143,913	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
周家玉	18,750	4,500	0	14,250	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
闻静	150	0	75	225	高管锁定股	高管锁定股根据法律法规规定锁定。
合计	134,764,206	113,907	75	134,650,374	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		114,283	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）		0	持有特别表决权股份 的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股 数量	报告期内增减 变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
杨云春	境内自然人	21.04%	154,023,719	-25,053,000	134,307,539	19,716,180	质押 冻结	26,150,000 11,843,479
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	2.94%	21,499,461	-9,092,932	0	21,499,461	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	11,423,578	-1,677,194	0	11,423,578	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.56%	4,123,974	862,033	0	4,123,974	不适用	0
江西莹光化工有限公司	境内非国有法人	0.41%	3,020,000	1,519,000	0	3,020,000	不适用	0
#肖爱军	境内自然人	0.38%	2,818,994	2,816,094	0	2,818,994	不适用	0
#宋天峰	境内自然人	0.33%	2,411,900	0	0	2,411,900	不适用	0
吕银用	境外自然人	0.33%	2,406,600	956,700	0	2,406,600	不适用	0
#肖晓勇	境内自然人	0.33%	2,391,200	1,164,900	0	2,391,200	不适用	0
阿布达比投资局一自有资金	境外法人	0.33%	2,390,321	2,390,321	0	2,390,321	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	21,499,461	人民币普通股	21,499,461
杨云春	19,716,180	人民币普通股	19,716,180
香港中央结算有限公司	11,423,578	人民币普通股	11,423,578
UBS AG	4,123,974	人民币普通股	4,123,974
江西莹光化工有限公司	3,020,000	人民币普通股	3,020,000
#肖爱军	2,818,994	人民币普通股	2,818,994
#宋天峰	2,411,900	人民币普通股	2,411,900
吕银用	2,406,600	人民币普通股	2,406,600
#肖晓勇	2,391,200	人民币普通股	2,391,200
阿布达比投资局－自有资金	2,390,321	人民币普通股	2,390,321
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10 名股东以及其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	肖爱军通过普通证券账户持有 15,994 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,803,000 股，实际合计持有 2,818,994 股；宋天峰通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,411,900 股，实际合计持有 2,411,900 股；肖晓勇通过普通证券账户持有 5,600 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,385,600 股，实际合计持有 2,391,200 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 （股）	本期增持 股份数量 （股）	本期减持股 份数量 （股）	期末持股数 （股）	期初被授予的 限制性股票数 量（股）	本期被授予 的限制性股票 数量（股）	期末被授予 的限制性股票 数量（股）
杨云春	董事长	现任	179,076,719		25,053,000	154,023,719			
张阿斌	董事、总经理	现任	245,929			245,929			

张阿斌	董事会秘书	离任							
刘波	副总经理	现任	191,884			191,884			
周家玉	副总经理	现任	19,000			19,000			
合计	--	--	179,533,532	0	25,053,000	154,480,532	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,391,380,536.57	2,244,368,874.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,790,603.66	
衍生金融资产		
应收票据	7,291,506.51	34,338.00
应收账款	201,876,776.97	293,225,623.06
应收款项融资		
预付款项	214,047,876.19	186,017,306.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,733,237.01	125,129,732.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,357,187.61	290,157,341.34
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,885,316.13	67,833,625.07

流动资产合计	3,278,363,040.65	3,206,766,840.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	648,755,817.93	2,462,613,615.86
其他权益工具投资	184,088,235.47	148,857,235.47
其他非流动金融资产	4,454,268,818.16	
投资性房地产		
固定资产	1,462,777,768.23	1,501,932,886.96
在建工程	427,940,365.38	476,905,888.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	351,600,097.23	376,634,024.71
无形资产	103,635,371.97	109,251,627.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	131,227,814.14	131,227,814.14
长期待摊费用	13,086,169.92	16,822,812.07
递延所得税资产	339,952,045.57	303,744,304.50
其他非流动资产	201,510,185.83	204,665,378.48
非流动资产合计	8,318,842,689.83	5,732,655,588.39
资产总计	11,597,205,730.48	8,939,422,428.40
流动负债：		
短期借款	359,525,126.89	253,397,568.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,405,535.41	3,759,529.24
应付账款	45,645,644.73	46,839,044.91
预收款项		
合同负债	90,128,409.41	115,193,080.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,694,057.75	34,897,273.94

应交税费	228,066,754.40	6,656,147.03
其他应付款	61,136,553.49	164,053,499.14
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	251,993,742.53	199,590,165.11
其他流动负债	6,039,868.81	4,994,983.96
流动负债合计	1,065,635,693.42	829,381,292.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	734,089,886.73	754,615,128.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	117,529,999.29	171,525,401.71
长期应付款		31,494,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	115,172,106.02	118,169,777.20
递延所得税负债	264,970,723.18	12,916,902.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,231,762,715.22	1,088,721,610.04
负债合计	2,297,398,408.64	1,918,102,902.41
所有者权益：		
股本	732,213,134.00	732,213,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,205,189,091.71	4,205,092,606.79
减：库存股		
其他综合收益	-91,594,376.55	34,319,994.62
专项储备		
盈余公积	58,529,640.80	58,529,640.80
一般风险准备		
未分配利润	4,135,526,181.90	1,704,231,080.21
归属于母公司所有者权益合计	9,039,863,671.86	6,734,386,456.42
少数股东权益	259,943,649.98	286,933,069.57
所有者权益合计	9,299,807,321.84	7,021,319,525.99
负债和所有者权益总计	11,597,205,730.48	8,939,422,428.40

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：许骥

会计机构负责人：霍夕淼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,748,674.77	244,436,403.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,148,891.77	99,345,391.77
应收款项融资		
预付款项	646,158.36	552,187.60
其他应收款	1,772,952,890.62	1,760,519,281.05
其中：应收利息		
应收股利		200,000,000.00
存货	38,786,522.74	23,360,072.74
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,118,726.66	4,801,653.45
流动资产合计	2,013,401,864.92	2,133,014,990.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,440,697,763.25	3,454,535,831.37
其他权益工具投资	42,383,235.47	42,383,235.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,748,971.62	7,587,997.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,069,030.97	2,654,265.48
无形资产	762,612.84	947,707.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	26,918,777.35	27,755,027.26
其他非流动资产		19,880,000.00
非流动资产合计	3,519,580,391.50	3,555,744,063.73
资产总计	5,532,982,256.42	5,688,759,054.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,301,129.49	67,482,570.79
预收款项		
合同负债	6,662,973.42	6,662,973.42
应付职工薪酬		
应交税费	13,601,639.56	49,196.61
其他应付款	436,454,674.67	327,007,923.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,297,130.57	12,689,744.28
其他流动负债	848,987.54	848,987.54
流动负债合计	538,166,535.25	414,741,396.31
非流动负债：		
长期借款	90,591,891.90	68,027,903.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,499,664.37	5,000,068.15
长期应付款		31,494,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,091,556.27	104,522,372.13
负债合计	631,258,091.52	519,263,768.44
所有者权益：		
股本	732,213,134.00	732,213,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	4,071,234,499.48	4,071,234,499.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,529,640.80	58,529,640.80
未分配利润	39,746,890.62	307,518,011.33
所有者权益合计	4,901,724,164.90	5,169,495,285.61
负债和所有者权益总计	5,532,982,256.42	5,688,759,054.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	178,373,115.82	570,095,783.13
其中：营业收入	178,373,115.82	570,095,783.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	451,292,570.42	672,554,460.29
其中：营业成本	162,651,981.89	342,000,351.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,908,729.35	3,171,416.68
销售费用	3,604,758.21	15,679,584.68
管理费用	42,500,049.06	71,802,139.15
研发费用	198,998,926.06	199,344,516.53
财务费用	39,628,125.85	40,556,451.57
其中：利息费用	20,268,387.79	17,159,673.87
利息收入	11,808,035.03	5,554,770.71
加：其他收益	13,419,009.20	19,068,857.18
投资收益（损失以“—”号填列）	781,635,901.11	3,487,973.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	781,635,901.11	3,487,973.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,577,492,322.41	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	48,427,177.15	13,610,881.09
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-22,678,174.26	-4,019,999.92
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-16,511,220.61	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,108,865,560.40	-70,310,965.29
加：营业外收入	175,631.58	
减：营业外支出	173,527.81	29.90
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,108,867,664.17	-70,310,995.19
减：所得税费用	433,743,122.49	-41,423,448.91
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,675,124,541.68	-28,887,546.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,675,124,541.68	-28,887,546.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	2,702,213,961.27	-650,333.36
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-27,089,419.59	-28,237,212.92
六、其他综合收益的税后净额	-125,914,371.17	171,611,394.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,914,371.17	171,611,394.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-125,914,371.17	171,611,394.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-34,313,418.10	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		3,967,754.90

加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	162,478.62	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,983,988.78	3,586,953.93
减：所得税费用	836,249.91	859,260.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,147,738.87	2,727,693.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,147,738.87	2,727,693.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	3,147,738.87	2,727,693.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	327,994,974.06	572,944,334.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,996,604.79	58,544,645.50
收到其他与经营活动有关的现金	85,450,114.70	117,840,956.05
经营活动现金流入小计	420,441,693.55	749,329,936.52
购买商品、接受劳务支付的现金	244,301,676.23	272,730,611.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	161,062,792.47	233,455,954.18
支付的各项税费	16,418,545.34	34,155,505.16
支付其他与经营活动有关的现金	108,162,522.08	43,185,312.38
经营活动现金流出小计	529,945,536.12	583,527,382.93
经营活动产生的现金流量净额	-109,503,842.57	165,802,553.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	81,527,579.60	2,348,026.91
取得投资收益收到的现金	632,234,154.72	10,394,568.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,090,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	739,851,734.32	12,742,595.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,255,109.04	193,786,170.15
投资支付的现金	112,257,065.69	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,494,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,006,574.73	193,786,170.15
投资活动产生的现金流量净额	537,845,159.59	-181,043,574.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	210,506,403.24	526,238,615.74
收到其他与筹资活动有关的现金	17,371,257.39	17,790,000.00
筹资活动现金流入小计	227,977,660.63	544,028,615.74
偿还债务支付的现金	125,910,148.91	147,123,398.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,755,516.48	17,618,365.74
其中：子公司支付给少数股东的股		

利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,801,821.49	
筹资活动现金流出小计	421,467,486.88	164,741,764.45
筹资活动产生的现金流量净额	-193,489,826.25	379,286,851.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-87,839,828.38	40,185,313.08
五、现金及现金等价物净增加额	147,011,662.39	404,231,143.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,244,368,874.18	615,452,918.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,391,380,536.57	1,019,684,061.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,178,226.09	12,527,100.00
收到的税费返还	537,281.00	
收到其他与经营活动有关的现金	535,057,849.82	287,790,225.58
经营活动现金流入小计	563,773,356.91	300,317,325.58
购买商品、接受劳务支付的现金	19,445,653.77	8,415,773.49
支付给职工以及为职工支付的现金	13,032,526.40	11,136,512.49
支付的各项税费	304,153.94	1,404,446.41
支付其他与经营活动有关的现金	589,875,608.08	264,756,379.24
经营活动现金流出小计	622,657,942.19	285,713,111.63
经营活动产生的现金流量净额	-58,884,585.28	14,604,213.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,637,463.19	2,348,026.91
取得投资收益收到的现金	200,000,000.00	10,394,568.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	205,637,463.19	12,742,595.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,494,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,494,400.00	220,000.00
投资活动产生的现金流量净额	174,143,063.19	12,522,595.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,195,520.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	12,671,257.39	
筹资活动现金流入小计	37,866,777.39	
偿还债务支付的现金	5,524,420.45	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,186,742.30	476,553.81
支付其他与筹资活动有关的现金	101,821.49	0.00

筹资活动现金流出小计	276,812,984.24	476,553.81
筹资活动产生的现金流量净额	-238,946,206.85	-476,553.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-123,687,728.94	26,650,255.37
加：期初现金及现金等价物余额	244,436,403.71	63,319,727.56
六、期末现金及现金等价物余额	120,748,674.77	89,969,982.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末 余额	732,213,134.00				4,205,092,606.79		34,319,994.62		58,529,640.80		1,704,231,080.21		6,734,386,456.42	286,933,069.57	7,021,319,525.99
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
其他															
二、本年期初 余额	732,213,134.00				4,205,092,606.79		34,319,994.62		58,529,640.80		1,704,231,080.21		6,734,386,456.42	286,933,069.57	7,021,319,525.99
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）					96,484.92		－ 125,914,371.17				2,431,295,101.69		2,305,477,215.44	－ 26,989,419.59	2,278,487,795.85
（一）综合收 益总额							－ 125,914,371.17				2,702,213,961.27		2,576,299,590.10	－ 27,089,419.59	2,549,210,170.51
（二）所有者 投入和减少资 本					96,484.92								96,484.92	100,000.00	196,484.92
1. 所有者投 入的普通股														100,000.00	100,000.00
2. 其他权益 工具持有者投 入资本															
3. 股份支付 计入所有者权 益的金额															
4. 其他					96,48								96,48		96,48

					4.92								4.92		4.92
											-		-		-
（三）利润分配											270,918,859.58		270,918,859.58		270,918,859.58
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-270,918,859.58		-270,918,859.58		-270,918,859.58
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	732,213,134.00				4,205,189,091.71		-91,594,376.55		58,529,640.80		4,135,526,181.90		9,039,863,671.86	259,943,649.98	9,299,807,321.84

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末	732,213,134.00				4,048,091.71		-		26,890.80		254,018.90		4,923,671.86	465,543.98	5,389,807,321.84

余额	13,134.00				,395,248.89		137,984.750.19		9,277.77		74,064.86		,596,975.33	66,812.30	,163,787.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	732,213,134.00				4,048,395,248.89		-137,984.750.19		26,899,277.77		254,074,064.86		4,923,596,975.33	465,566,812.30	5,389,163,787.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							171,611,394.52				-650,333.36		170,961,061.16	-28,237,212.92	142,723,848.24
（一）综合收益总额							171,611,394.52				-650,333.36		170,961,061.16	-28,237,212.92	142,723,848.24
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额结 转留存收益															
5. 其他综合 收益结转留存 收益															
6. 其他															
（五）专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末 余额	732,213,134.00				4,048,395,248.89		33,626,644.33		26,899,277.77		253,423,731.50		5,094,558,036.49	437,329,599.38	5,531,887,635.87

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末 余额	732,213 ,134.00				4,071,2 34,499. 48				58,529, 640.80	307,518 ,011.33		5,169,4 95,285. 61
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	732,213 ,134.00				4,071,2 34,499. 48				58,529, 640.80	307,518 ,011.33		5,169,4 95,285. 61
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）										－ 267,771 ,120.71		－ 267,771 ,120.71
（一）综合收 益总额										3,147,7 38.87		3,147,7 38.87
（二）所有者 投入和减少资 本												
1. 所有者投												

入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-270,918,859.58		-270,918,859.58
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-270,918,859.58		-270,918,859.58
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	732,213,134.00				4,071,234,499.48					58,529,640.80	39,746,890.62	4,901,724,164.90

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	732,213,134.00				4,071,234,499.48				26,899,277.77	22,839,435.31		4,853,186,346.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	732,213,134.00				4,071,234,499.48				26,899,277.77	22,839,435.31		4,853,186,346.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,727,693.80		2,727,693.80
（一）综合收益总额										2,727,693.80		2,727,693.80
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结												

转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	732,213,134.00				4,071,234,499.48				26,899,277.77	25,567,129.11		4,855,914,040.36

三、公司基本情况

1、公司概况

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，前身为“北京耐威科技股份有限公司”）2015 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714 号文《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准向社会公开发行人民币普通股（A 股）并流通上市。公司注册地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室（德胜园区），公司总部办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室（德胜园区）、北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼，本公司及子公司的业务性质为产品研发、生产、销售与技术开发服务。

本公司及子公司实际从事的主要经营活动包括：MEMS 芯片的工艺开发及晶圆制造，集成电路设计服务，半导体设备销售，导航产品的研发、生产与销售；相关软硬件产品的代理销售；相关技术开发服务。

公司法定代表人：杨云春

本公司财务报表已于 2026 年 8 月 26 日经公司董事会批准报出。

2、合并财务报表范围

本公司截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间纳入合并范围的子公司共 20 户，详见本附注十“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围与上年度相比无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2026 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。

2、会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司、境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外二级子公司运通电子有限公司和境外三级子公司运通电子技术有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，本公司之境外二级子公司亞芯(香港)有限公司以港币为其记账本位币，本公司之境外三级子公司 VCHIP SDN. BHD. 以林吉特为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 500 万
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额超过 500 万
本期重要的应收款项核销/债权投资核销/其他债权投资核销	单项金额超过 500 万
合同资产账面价值发生重大变动	单项金额超过 500 万
重要的在建工程	单项金额超过 5,000 万
重要的资本化研发项目/外购在研项目	单项金额超过 1,000 万
重要的投资活动	单项金额超过 5,000 万
重要的非全资子公司/联合营企业/共同经营、纳入合并范围的重要境外经营实体/结构化主体	单一主体收入、净利润、净资产、资产总额占本公司合并报表相关项目的 20%以上的
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过 500 万元的

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算，于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为林吉特、美元或人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）可供出售外币非货币性项目（如股票）产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产、负债项目，按照资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的所有者权益项目，按发生时的即期汇率折算。利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中其他综合收益项目中列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 分类和计量：

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

2) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

①预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

a) 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合如下：

应收账款组合 1 境外公司应收组合

应收账款组合 2 境内公司应收组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 无风险组合

合同资产组合 2 账龄组合

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与

者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

12、合同资产

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，本公司已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；反之，将本公司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注五、11 金融资产减值相关内容。

13、存货

- (1) 存货的分类：存货主要分为原材料、在产品、库存商品、备品备件、发出商品、委托加工物资、在途物资等。
- (2) 存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用移动加权平均法或个别认定法确定发出存货的实际成本。
- (3) 存货的盘存制度为永续盘存制。
- (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。
- (5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

①库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以该存货的估计售价减去估计销售费用和相关税费后的金额确定；

②需要经过加工的材料，在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

14、持有待售资产

- (1) 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(2) 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中，本公司在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

15、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

（2）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；

本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.9-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
电子设备	年限平均法	3-5	5	19-31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17、在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。无形资产按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司研究阶段的支出全部费用化，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此之外，本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1）服务成本。
- 2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

26、预计负债

当与产品质量保证/亏损合同或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

27、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日计入相关资产成本或当期费用，相应增加负债。在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

28、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等金融工具的区分

本公司对于发行的优先股、永续债等金融工具，根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等金融工具的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

29、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

（1）境内商品销售：本公司境内商品销售主要为销售根据不同客户具体需求定制化开发或生产的不同类型 MEMS 芯片晶圆及相关产品、量产芯片和相关软硬件产品的代理销售等。本公司一般负责将货物运送至指定交货地点，将货物交付客户后，客户取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

（2）境外商品销售：本公司境外商品销售主要为向境外出口销售根据不同客户具体需求定制化开发或生产的不同类型 MEMS 芯片晶圆及相关产品。本公司与客户根据合同在货物交付给货运商并取得货运单时由购货方取得货物控制权，本公司确认销售商品收入。

（3）提供劳务

提供劳务收入本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。本公司在完成技术服务内容，取得客户验收单后确定提供劳务收入。劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（4）半导体设备销售收入

本公司自第三方取得商品控制权后再转让给客户，在交易过程中承担向客户转让商品的主要责任、承担存货风险，并能有权自主决定所交易的商品的价格，本公司在该交易中的身份是主要责任人，按合同约定的本公司预期有权收取的对价总额确认收入。

（5）芯片设计服务销售收入

1) 人月制计费模式：公司根据客户确认的工作量结算单据，定期确认收入。

2) 项目制计费模式：公司按合同约定的内容将技术开发成果交付客户，取得客户验收单据后确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

30、合同成本

31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点：

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资

相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

33、租赁

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司租赁资产的类别主要包括房屋及建筑物、机器设备。

（a）初始计量

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（b）后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(c) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- 2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(d) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1) 经营租赁

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

34、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期会计

1) 套期的分类

本公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

①公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。该公允价值变动源于特定风险，且将影响企业的损益和其他综合收益。

②现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

③境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2) 套期工具和被套期项目

套期工具，是指本公司为进行套期而指定的，其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的衍生工具，但签出期权除外。只有在对购入期权（包括嵌入在混合合同中的购入期权）进行套期时，签出期权才可以作为套期工具。嵌入在混合合同中但未分拆的衍生工具不能作为单独的套期工具。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产或非衍生金融负债，但指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益、且其自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益的金融负债除外。

自身权益工具不属于金融资产或金融负债，不能作为套期工具。

被套期项目，是指使本公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。本公司将下列单个项目、项目组合或其组成部分指定为被套期项目：

①已确认资产或负债。

②尚未确认的确定承诺。确定承诺，是指在未来某特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。

③极可能发生的预期交易。预期交易，是指尚未承诺但预期会发生的交易。

④境外经营净投资。

上述项目组成部分是指小于项目整体公允价值或现金流量变动的部分，本公司将下列项目组成部分或其组合指定为被套期项目：

①项目整体公允价值或现金流量变动中仅由某一个或多个特定风险引起的公允价值或现金流量变动部分(风险成分)。根据在特定市场环境下的评估，该风险成分应当能够单独识别并可靠计量。风险成分也包括被套期项目公允价值或现金流量的变动仅高于或仅低于特定价格或其他变量的部分。

②一项或多项选定的合同现金流量。

③项目名义金额的组成部分，即项目整体金额或数量的特定部分，其可以是项目整体的一定比例部分，也可以是项目整体的某一层级部分。若某一层级部分包含提前还款权，且该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响的，不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目，但在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的情况除外。

3) 套期关系评估

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

①套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

②在套期开始时, 本公司正式指定了套期工具和被套期项目, 并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法 (包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法) 等内容。

③套期关系符合套期有效性要求。

套期有效性, 是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。套期工具的公允价值或现金流量变动大于或小于被套期项目的公允价值或现金流量变动的部分为套期无效部分。

本公司发生下列情形之一的, 终止运用套期会计:

①因风险管理目标发生变化, 导致套期关系不再满足风险管理目标。

②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系, 或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中, 信用风险的影响开始占主导地位。

④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下, 本公司首先考虑套期关系再平衡, 然后评估套期关系是否满足运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分, 在仅影响其中一部分时, 剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

4) 确认和计量

满足运用套期会计方法条件的, 按如下方法进行处理:

①公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 (或其组成部分) 进行套期的, 套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

被套期项目因被套期风险敞口形成利得或损失计入当期损益, 同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (或其组成部分) 的, 其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益, 其账面价值已经按公允价值计量, 不需要调整; 被套期项目为选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 (或其组成部分) 的, 其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益, 其账面价值已经按公允价值计量, 不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺 (或其组成部分) 的, 其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债, 相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时, 应当调整该资产或负债的初始确认金额, 以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

②现金流量套期

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分, 作为现金流量套期储备, 计入其他综合收益, 属于套期无效的部分 (即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失), 计入当期损益。现金流量套期储备的金额, 按照下列两项的绝对额中较低者确定: ①套期工具自套期开始的累计利得或损失。②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

如果被套期的预期交易随后确认为一项非金融资产或非金融负债的, 或非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用公允价值套期会计的确定承诺时, 则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出, 计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间, 将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出, 计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失, 且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的, 在预计不能弥补时, 将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出, 计入当期损益。

③境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期, 包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期, 本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理。

(2) 回购本公司股份

回购本公司股份支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、出售或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

1) 本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

2) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

3) 本公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

(3) 非货币性资产交换

如果非货币性资产交换具有商业实质，并且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值(如果有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠除外)和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果非货币性资产交换不具备上述条件，则按照换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果该交换具有商业实质，并且换入资产的公允价值能够可靠计量的，按照换入的金融资产以外的各项换入资产公允价值相对比例，将换出资产公允价值总额扣除换入金融资产公允价值后的净额进行分摊，以分摊至各项换入资产的金额，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的成本进行初始计量；如该交换不具有商业实质，按照各项换入资产的公允价值的相对比例，将换出资产的账面价值总额分摊至各项换入资产，加上应支付的相关税费，作为各项换入资产的初始计量金额，换入资产的公允价值不能可靠计量的，按照各项换入资产的原账面价值的相对比例或其他合理比例对换出资产的账面价值进行分摊。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

36、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	按销售额的 9%（出租不动产）、13%计算销项税，按规定扣除进项税额后计算缴纳

城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、24%、25%
增值税	技术服务收入	3%、6%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京赛微电子股份有限公司	25%
北京赛莱克斯国际科技有限公司	25%
运通电子有限公司	16.5%
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	25%
赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司	25%
飞纳经纬科技（北京）有限公司	25%
北京微芯科技有限公司	25%
北京中科赛微电子有限公司	25%
北京极芯传感科技中心（有限合伙）	25%
北京赛积国际科技有限公司	25%
北京海创微芯科技有限公司	15%
北京海创微元科技有限公司	25%
青岛展诚科技有限公司	15%
南京宁芯微电子科技有限公司	20%
成都芯卓微电子科技有限公司	20%
青岛芯诚微电子科技有限公司	20%
上海芯舵科技有限公司	20%
无锡筑芯科技有限公司	20%
运通电子技术发展有限公司	16.5%
VCHIP SDN. BHD.	24%
亞芯(香港)有限公司	16.5%

2、税收优惠

（1）增值税优惠

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）规定，继续实施软件增值税优惠政策；根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

北京耐威科技股份有限公司（已更名为“北京赛微电子股份有限公司”）于2011年12月9日在北京市西城区国家税务局第一税务所进行了软件产品备案，包括：北斗/GPS/GLONASS 多模网络 RTK 系统移动站软件 V3.0、北斗/GPS/GLONASS 多模网络 RTK 系统监控中心软件 V4.0、北斗/GPS/GLONASS 多模网络 RTK 系统基准站软件 V3.0 三种软件产品，其生产销售的上述软件产品增值税入库税款实际税负超过3%的部分即征即退。北京耐威科技股份有限公司（已更名为“北京赛微电子股份有限公司”）于2019年12月18日在北京市西城区国家税务局第一税务所进行了软件产品备案，包括：利用外部间断信号自主修正的导航解算软件 V1.0、北斗导航芯片信号处理软件 V1.0、抗干扰天线信号处理软件 V1.0、具有自寻北自检测自标定功能的惯性导航解算软件 V1.0 四种软件产品，其生产销售的上述软件产品增值税入库税款实际税负超过3%的部分即征即退。

飞纳经纬科技（北京）有限公司于2019年9月6日在北京市西城区国家税务局第一税务所进行了软件产品备案，包括：飞纳经纬卫星导航板卡固件升级软件 V1.0、飞纳经纬高精度卫星导航数据转换软件 DataTrans V1.0、飞纳经纬串口升级软件 SerialUpdate V1.0 三种软件产品，其生产销售的上述软件产品增值税入库税款实际税负超过3%的部分即征即退。

青岛展诚科技有限公司于 2022 年 9 月 2 日在国家税务总局青岛市市南区税务局进行了软件产品备案，包括集成电路自动更改 ESD 参数与 layers 系统 V1.0、展诚集成电路测试优化软件 V1.0、展诚集成电路阵列设计系统 V1.0 等二十三种软件产品，其生产销售的上述软件产品增值税入库税款实际税负超过 3% 的部分即征即退。

(2) 所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。北京海创微芯科技有限公司于 2024 年 12 月 31 日（证书载明发证时间）取得高新技术企业证书（编号：GR202411010047 号），2024 年至 2026 年享受 15% 税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。青岛展诚科技有限公司于 2025 年 12 月 19 日（证书载明发证时间）取得高新技术企业证书（编号：GR202537100064 号），2025 年至 2027 年享受 15% 税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）规定，对集成电路线宽小于 0.25 微米或投资额超过 80 亿元的集成电路生产企业，经认定后，减按 15% 的税率征收企业所得税，其中经营期在 15 年以上的，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税（以下简称企业所得税“五免五减半”优惠政策）。赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司自 2019 年至 2023 年免征企业所得税，2024 年至 2028 年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定：“三、对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。”南京宁芯微电子科技有限公司、成都芯卓微电子科技有限公司、青岛芯诚微电子科技有限公司、上海芯舵科技有限公司和无锡筑芯科技有限公司属于符合规定的小型微利企业，按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,391,380,536.57	2,244,368,874.18
合计	2,391,380,536.57	2,244,368,874.18
其中：存放在境外的款项总额	1,966,547,349.54	1,677,417,277.36

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	13,790,603.66	

益的金融资产		
其中：		
基金投资	13,790,603.66	
其中：		
合计	13,790,603.66	

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,829,106.51	34,338.00
商业承兑票据	2,462,400.00	
合计	7,291,506.51	34,338.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,421,106.51	100.00%	129,600.00	1.75%	7,291,506.51	34,338.00	100.00%			34,338.00
其中：										
银行承兑汇票组合	4,829,106.51	65.07%			4,829,106.51	34,338.00	100.00%			34,338.00
商业承兑汇票组合	2,592,000.00	34.93%	129,600.00	5.00%	2,462,400.00					
合计	7,421,106.51	100.00%	129,600.00	1.75%	7,291,506.51	34,338.00	100.00%			34,338.00

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	2,592,000.00	129,600.00	5.00%
合计	2,592,000.00	129,600.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		129,600.00				129,600.00
合计		129,600.00				129,600.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

（4） 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	147,973.80	254,630.81
合计	147,973.80	254,630.81

（6） 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明:

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	131,707,629.38	130,046,260.94
1 至 2 年	1,644,974.98	60,859,218.03
2 至 3 年	82,655,978.78	133,122,332.86
3 年以上	55,045,514.45	53,105,170.66
3 至 4 年	38,104,792.94	40,719,664.16
4 至 5 年	4,873,441.10	4,262,000.00
5 年以上	12,067,280.41	8,123,506.50
合计	271,054,097.59	377,132,982.49

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,279,696.92	9.70%	26,279,696.92	100.00%		26,279,696.92	6.97%	26,279,696.92	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	244,774,400.67	90.30%	42,897,623.70	17.53%	201,876,776.97	350,853,285.57	93.03%	57,627,662.51	16.43%	293,225,623.06
其中：										
境外公司应收组合										
境内公司应收组合	244,774,400.67	90.30%	42,897,623.70	17.53%	201,876,776.97	350,853,285.57	93.03%	57,627,662.51	16.43%	293,225,623.06
合计	271,054,097.59	100.00%	69,177,320.62	25.52%	201,876,776.97	377,132,982.49	100.00%	83,907,359.43	22.25%	293,225,623.06

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	客户财务困难
客户 2	24,369,696.92	24,369,696.92	24,369,696.92	24,369,696.92	100.00%	客户财务困难
客户 3	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	100.00%	客户财务困难
合计	26,279,696.92	26,279,696.92	26,279,696.92	26,279,696.92		

按组合计提坏账准备类别名称： 境外公司应收组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境外公司应收组合			

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称： 境内公司应收组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	131,707,629.38	6,585,381.47	5.00%
1 至 2 年	1,644,974.98	164,497.50	10.00%
2 至 3 年	82,655,978.78	16,531,195.76	20.00%
3 至 4 年	18,298,537.12	9,149,268.56	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	10,467,280.41	10,467,280.41	100.00%
合计	244,774,400.67	42,897,623.70	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	26,279,696.92					26,279,696.92
按组合计提坏账准备	57,627,662.51	-14,712,599.31			-17,439.50	42,897,623.70

合计	83,907,359.43	-14,712,599.31			-17,439.50	69,177,320.62
----	---------------	----------------	--	--	------------	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	37,740,576.02		37,740,576.02	13.92%	7,548,115.20
客户 2	29,252,605.00		29,252,605.00	10.79%	5,850,521.00
客户 3	24,956,520.89		24,956,520.89	9.21%	1,247,826.04
客户 4	24,369,696.92		24,369,696.92	8.99%	24,369,696.92
客户 5	17,506,220.03		17,506,220.03	6.46%	875,311.00
合计	133,825,618.86		133,825,618.86	49.37%	39,891,470.16

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	0.00	0.00				

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,733,237.01	125,129,732.18
合计	78,733,237.01	125,129,732.18

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	56,130,378.41	136,739,225.59
押金及保证金	24,810,095.45	24,461,321.35
个人借款	6,100,000.00	5,650,000.00
股权转让款	2,550,000.00	2,550,000.00
代扣代缴款项	956,481.69	1,775,153.73
备用金	920,780.69	533,127.47
合计	91,467,736.24	171,708,828.14

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,986,887.55	79,156,018.74
1 至 2 年	21,266,468.16	24,386,156.34
2 至 3 年	4,463,881.44	3,811,668.30
3 年以上	6,750,499.09	64,354,984.76
3 至 4 年	3,214,748.30	52,136,827.47
4 至 5 年	36,627.47	9,015,355.12
5 年以上	3,499,123.32	3,202,802.17
合计	91,467,736.24	171,708,828.14

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	38,866,322.21	0.00	7,712,773.75	46,579,095.96
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-33,844,177.84			-33,844,177.84
其他变动	-418.89			-418.89
2026 年 6 月 30 日余额	5,021,725.48		7,712,773.75	12,734,499.23

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	46,579,095.96	-33,844,177.84			-418.89	12,734,499.23
合计	46,579,095.96	-33,844,177.84			-418.89	12,734,499.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
IMEGO AB	应收退货款	47,890,762.90	1 年以内	52.36%	2,394,538.15
芯鑫融资租赁（北京）有限责任公司	融资租赁保证金	18,400,000.00	1-2 年	20.12%	552,000.00
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	融资租赁保证金	3,000,000.00	1 年以内	3.28%	90,000.00
Fabexchange, Inc.	往来款	2,674,257.45	2-3 年	2.92%	2,674,257.45
上海宥珊实业有限公司	往来款	2,445,100.80	3-4 年	2.67%	2,445,100.80
合计		74,410,121.15		81.35%	8,155,896.40

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	178,618,685.63	83.45%	150,521,218.44	80.92%
1 至 2 年	35,334,441.65	16.51%	35,341,020.42	19.00%
2 至 3 年			60,015.77	0.03%
3 年以上	94,748.91	0.04%	95,051.55	0.05%
合计	214,047,876.19		186,017,306.18	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末余额	未结算原因
供应商 1	27,924,690.00	合同正在履行中

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
供应商 1	64,819,000.00	30.28

供应商 2	42,227,580.00	19.73
供应商 3	27,924,690.00	13.05
供应商 4	21,843,932.11	10.21
供应商 5	16,737,859.49	7.82
合计	173,553,061.60	81.09

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	114,105,480.70	0.00	114,105,480.70	111,305,656.95	0.00	111,305,656.95
在产品	28,965,800.83	11,997,255.30	16,968,545.53	27,686,548.24	8,409,543.98	19,277,004.26
库存商品	260,569,684.25	124,083,060.04	136,486,624.21	232,146,661.37	107,965,717.11	124,180,944.26
合同履约成本	30,348,932.49	7,664,415.38	22,684,517.11	26,293,746.33	6,525,171.17	19,768,575.16
发出商品	13,233,593.84	2,121,573.78	11,112,020.06	18,890,643.65	3,265,482.94	15,625,160.71
合计	447,223,492.11	145,866,304.50	301,357,187.61	416,323,256.54	126,165,915.20	290,157,341.34

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计
----	-----------	-----------------	-------------------	----

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	8,409,543.98	3,587,711.32				11,997,255.30
库存商品	107,965,717.11	19,095,127.89		2,977,784.96		124,083,060.04

合同履约成本	6,525,171.17	1,139,244.21				7,664,415.38
发出商品	3,265,482.94	-1,143,909.16				2,121,573.78
合计	126,165,915.20	22,678,174.26		2,977,784.96		145,866,304.50

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款/待抵扣增值税	68,735,207.31	66,437,089.04
预缴企业所得税	1,150,108.82	1,396,536.03
合计	69,885,316.13	67,833,625.07

补偿性资产相关信息

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
爱集微（上海）科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
海南火眼曦和股权投资私募基金合	9,218,235.47						9,218,235.47	

伙企业（有限合伙）								
阿基米德半导体（合肥）有限公司	6,500,000.00						6,500,000.00	
吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
深圳市金石重投智能传感器产业私募股权基金	16,665,000.00						16,665,000.00	
依迈微（北京）科技有限公司	1,550,000.00						1,550,000.00	
成都纤声科技有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
无锡墉旃半导体有限公司	9,600,000.00						9,600,000.00	
星昱传感科技（嘉兴）有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
北京芯东来半导体科技有限公司	52,824,000.00						75,055,000.00	
龙骧鑫睿（厦门）科技有限公司	4,500,000.00						7,500,000.00	
深圳市蔚海智芯科技有限公司	5,000,000.00						10,000,000.00	
原集微科技（上海）有限公司							5,000,000.00	
合计	148,857,235.47						184,088,235.47	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉光谷信息技术股份有限公司和湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	373,744,038.70				-452,324.62						373,291,714.08	
青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）	9,350,551.91			8,619,053.11							731,498.80	
青岛聚能创芯微电子有限公司	48,470,027.41				-4,017,335.36						44,452,692.05	
北京赛微私募基金管理有限公司	12,322,175.20				-540,490.65						11,781,684.55	
北京北工怀微传感科技股权投资基金(有限合伙)	124,172,376.81			3,882,527.50	3,673,663.12						123,963,512.43	
Silex Microsystems AB	1,866,488,400.31			520,154,331.43	34,106,008.93	-27,951,156.60				-1,352,488,921.21		
西安智诚微电子科技有限公司	728,351.48				26,223.91						754,575.39	

有限公司												
广州联星科技有限公司	3,327,755.65				-167,791.59						3,159,964.06	
北京思丰可科技有限公司	3,460,171.25				-200.00						3,459,971.25	
北京市赛微传感产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8,999,767.14				-93.73						8,999,673.41	
杭州初芯微科技合伙企业(有限合伙)	11,550,000.00		54,450,000.00		-1,326,976.11						64,673,023.89	
CompoundTek Pte Ltd			13,621,800.00		-134,291.98						13,487,508.02	
小计	2,462,613,615.86		68,071,800.00	532,655,912.04	31,166,391.92	-27,951,156.60				-1,352,488,921.21	648,755,817.93	
合计	2,462,613,615.86		68,071,800.00	532,655,912.04	31,166,391.92	-27,951,156.60				-1,352,488,921.21	648,755,817.93	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

由于武汉光谷信息技术股份有限公司为新三板挂牌企业（证券代码 430161），其截至 2026 年 8 月 26 日尚未披露 2026 年半年度报告，因此将武汉光谷信息技术股份有限公司及湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合并列示。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Silex Microsystems AB	4,454,268,818.16	
合计	4,454,268,818.16	

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,462,777,768.23	1,501,932,886.96
合计	1,462,777,768.23	1,501,932,886.96

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	656,807,146.24	1,250,443,345.21	3,070,131.00	31,094,981.29	1,941,415,603.74
2. 本期增加金额	4,069,327.94	83,697,981.11		3,204,554.79	90,971,863.84
（1）购置	4,069,327.94			3,034,013.09	7,103,341.03
（2）在建工程转入		83,697,981.11		170,541.70	83,868,522.81
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		50,359,650.69		140,960.29	50,500,610.98
（1）处置或报废		50,359,650.69		140,960.29	50,500,610.98
4. 期末余额	660,876,474.18	1,283,781,675.63	3,070,131.00	34,158,575.79	1,981,886,856.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	157,177,415.95	258,128,183.09	2,697,786.96	21,479,330.78	439,482,716.78
2. 本期增加金额	16,056,081.41	65,279,559.44	68,763.64	2,076,962.97	83,481,367.46
（1）计提	16,056,081.41	65,279,559.44	68,763.64	2,076,962.97	83,481,367.46
3. 本期减少金额		3,721,560.35		133,435.52	3,854,995.87
（1）处置或		3,721,560.35		133,435.52	3,854,995.87

报废					
4. 期末余额	173,233,497.36	319,686,182.18	2,766,550.60	23,422,858.23	519,109,088.37
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置或 报废					
其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	487,642,976.82	964,095,493.45	303,580.40	10,735,717.56	1,462,777,768.23
2. 期初账面 价值	499,629,730.29	992,315,162.12	372,344.04	9,615,650.51	1,501,932,886.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	128,979,045.82

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	427,940,365.38	476,905,888.63
合计	427,940,365.38	476,905,888.63

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	427,940,365.38		427,940,365.38	476,905,888.63		476,905,888.63
合计	427,940,365.38		427,940,365.38	476,905,888.63		476,905,888.63

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率	资金来源
北京 8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目（在建工程）	2,304,420,000.00	337,261,030.11	26,096,949.93	83,868,522.81		279,489,457.23	97.07%	98.50%	48,769,000.33			募集资金、其他、金融机构贷款
先进 MEMS 工艺设计与服务北京市工程研究中心（在建工程）	114,887,300.00	130,790,072.53				130,790,072.53	108.61%	95.00%				其他
合计	2,419,307,300.00	468,051,102.64	26,096,949.93	83,868,522.81		410,279,529.76			48,769,000.33			

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,383,717.25	401,504,277.01	30,033.27	403,918,027.53
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,383,717.25	401,504,277.01	30,033.27	403,918,027.53
二、累计折旧				
1. 期初余额	221,764.71	27,059,594.10	2,644.01	27,284,002.82
2. 本期增加金额	443,529.30	24,585,350.80	5,047.38	25,033,927.48
(1) 计提	443,529.30	24,585,350.80	5,047.38	25,033,927.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	665,294.01	51,644,944.90	7,691.39	52,317,930.30
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	1,718,423.24	349,859,332.11	22,341.88	351,600,097.23
2. 期初账面价值	2,161,952.54	374,444,682.91	27,389.26	376,634,024.71

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	67,205,028.86	0.00	29,206,000.00	51,023,286.74	147,434,315.60
2. 本期增加金额				1,409,851.04	1,409,851.04
(1) 购置				1,409,851.04	1,409,851.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	67,205,028.86		29,206,000.00	52,433,137.78	148,844,166.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	13,042,393.28		1,718,000.00	23,422,294.75	38,182,688.03
2. 本期增加金额	672,050.31		3,436,000.00	2,918,056.33	7,026,106.64
(1) 计提	672,050.31		3,436,000.00	2,918,056.33	7,026,106.64
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	13,714,443.59		5,154,000.00	26,340,351.08	45,208,794.67
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加 金额					
（1）计提					
3. 本期减少 金额					
（1）处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	53,490,585.27		24,052,000.00	26,092,786.70	103,635,371.97
2. 期初账面 价值	54,162,635.58		27,488,000.00	27,600,991.99	109,251,627.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

（2）确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形 资产	自行开发的数据资源 无形资产	其他方式取得的数据 资源无形资产	合计
----	-----------------	-------------------	---------------------	----

（3）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

（4）无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
青岛展诚科技有限 公司	131,227,814.14					131,227,814.14
飞纳经纬科技（北 京）有限公司	3,642,504.07					3,642,504.07

合计	134,870,318.21					134,870,318.21
----	----------------	--	--	--	--	----------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
飞纳经纬科技（北京）有限公司	3,642,504.07					3,642,504.07
合计	3,642,504.07					3,642,504.07

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及 依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	--------------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	14,906,896.73	28,000.00	3,549,550.50		11,385,346.23
工艺开发工程	1,915,915.34		215,091.65		1,700,823.69

合计	16,822,812.07	28,000.00	3,764,642.15		13,086,169.92
----	---------------	-----------	--------------	--	---------------

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	76,678,903.25	13,368,101.76	117,084,744.00	22,171,407.66
内部交易未实现利润	12,947,691.94	2,476,941.40	15,157,111.38	2,685,092.88
可抵扣亏损	2,431,019,368.17	312,626,010.27	2,096,375,810.04	267,077,872.99
租赁资产差异	4,618,575.32	623,713.89	3,634,640.80	506,127.69
递延收益	85,674,226.10	10,857,278.25	89,958,631.72	11,303,803.28
合计	2,610,938,764.78	339,952,045.57	2,322,210,937.94	303,744,304.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	24,052,000.00	2,405,200.00	27,488,000.00	2,748,800.00
租赁资产差异	1,718,423.24	257,763.49	2,161,952.54	324,292.88
丧失控制权日按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得	38,905,632.57	9,726,408.14	38,905,632.57	9,726,408.14
内部交易未实现利润	939,211.65	117,401.47	939,211.65	117,401.47
其他非流动金融资产的公允价值变动	1,009,855,800.32	252,463,950.08		
合计	1,075,471,067.78	264,970,723.18	69,494,796.76	12,916,902.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		339,952,045.57		303,744,304.50
递延所得税负债		264,970,723.18		12,916,902.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	153,266,856.60	139,567,626.59
可抵扣亏损	499,574,215.77	491,829,871.26
合计	652,841,072.37	631,397,497.85

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	1,788,353.65	1,788,353.65	
2027 年	4,292,735.96	1,644,255.30	
2028 年	12,969,058.89	11,538,383.93	
2029 年	84,354,010.20	79,224,357.90	
2030 年	79,884,228.88	184,913,358.63	
2031 年	87,061,991.63	11,386,450.21	
2032 年	29,540,469.75	24,727,923.56	
2033 年	23,725,975.24	31,853,914.96	
2034 年	27,113,808.46	25,880,042.94	
2035 年	34,198,840.88	40,380,211.54	
2036 年	15,055,711.24		
永久	99,589,030.99	78,492,618.64	
合计	499,574,215.77	491,829,871.26	

其他说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款、工程款	121,510,185.83		121,510,185.83	124,665,378.48		124,665,378.48
预付股权款	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
合计	201,510,185.83		201,510,185.83	204,665,378.48		204,665,378.48

补偿性资产相关信息

其他说明：

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

其他说明：

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	331,928,598.19	252,528,598.19
信用借款	27,380,269.00	686,800.00
短期借款应付利息	216,259.70	182,170.48
合计	359,525,126.89	253,397,568.67

短期借款分类的说明：

赛莱克斯北京自中国银行股份有限公司北京北三环支行取得借款人民币 7,970.00 万元，自兴业银行股份有限公司北京西单支行取得借款人民币 7,000.00 万元，自中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区分行取得借款 5,000.00 万元，自宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）取得借款人民币 4,993.86 万元，自中国进出口银行北京分行取得借款人民币 3,900.00 万元；赛积国际自宁波银行取得借款人民币 4,329.00 万元；以上借款均由公司及公司控股股东杨云春提供担保。

展诚科技自中国工商银行股份有限公司青岛市分行取得借款人民币 888.03 万元，自招商银行股份有限公司青岛分行取得借款人民币 1,850 万元，该两笔借款为信用借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,405,535.41	3,759,529.24
合计	3,405,535.41	3,759,529.24

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,995,627.36	36,951,560.47
1 年以上	2,650,017.37	9,887,484.44
合计	45,645,644.73	46,839,044.91

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	61,136,553.49	164,053,499.14
合计	61,136,553.49	164,053,499.14

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应退政府补助		87,350,000.00
设备及工程款	23,241,802.07	37,629,725.40
应付股权收购款	31,494,400.00	31,494,400.00
应付水电费、房租、物业费等	4,035,195.86	3,164,843.50
单位往来款	600,766.03	2,336,805.12
应付项目补助款	800,000.00	1,400,000.00
个人款项	922,724.57	586,215.38
押金及保证金	5,000.00	5,000.00
其他	36,664.96	86,509.74
合计	61,136,553.49	164,053,499.14

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	86,982,569.59	96,196,098.03
1 年以上	3,145,839.82	18,996,982.34
合计	90,128,409.41	115,193,080.37

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,846,741.78	131,806,363.16	147,018,060.03	19,635,044.91
二、离职后福利-设定提存计划	50,532.16	12,570,318.53	12,561,837.85	59,012.84
三、辞退福利		637,184.90	637,184.90	
合计	34,897,273.94	145,013,866.59	160,217,082.78	19,694,057.75

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,398,076.29	113,982,941.96	129,469,598.51	18,911,419.74
2、职工福利费		2,793,483.22	2,793,483.22	
3、社会保险费	28,802.30	7,402,348.78	7,328,874.37	102,276.71
其中：医疗保险费	28,205.89	6,786,934.73	6,786,805.11	28,335.51
工伤保险费	596.41	323,428.52	323,424.66	600.27
马来西亚公司保险费		291,985.53	218,644.60	73,340.93
4、住房公积金	17,037.00	5,531,886.86	5,487,662.86	61,261.00
5、工会经费和职工教育经费	402,826.19	2,095,702.34	1,938,441.07	560,087.46
合计	34,846,741.78	131,806,363.16	147,018,060.03	19,635,044.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	49,009.61	12,155,138.99	12,146,636.44	57,512.16
2、失业保险费	1,522.55	415,179.54	415,201.41	1,500.68
合计	50,532.16	12,570,318.53	12,561,837.85	59,012.84

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	459,216.35	763,968.06
企业所得税	212,852,870.00	4,980,214.22
个人所得税	13,602,729.27	835,634.63
城市维护建设税	19,894.21	11,424.11
代扣代缴企业所得税	1,017,493.92	
教育费附加	8,443.07	6,006.91
地方教育费附加	5,628.71	3,982.75
其他	100,478.87	54,916.35
合计	228,066,754.40	6,656,147.03

其他说明

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	156,774,939.84	122,215,438.37
一年内到期的租赁负债	95,218,802.69	77,374,726.74
合计	251,993,742.53	199,590,165.11

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,039,868.81	4,994,983.96
合计	6,039,868.81	4,994,983.96

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	344,930,546.99	334,766,924.12
保证借款	545,934,279.58	542,063,642.89
减：一年内到期的长期借款	-156,774,939.84	-122,215,438.37
合计	734,089,886.73	754,615,128.64

长期借款分类的说明：

(1) 赛积国际自中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“建设银行”）取得借款人民币 23,925.00 万元，借款期限从 2022 年 10 月 31 日至 2028 年 10 月 31 日；赛莱克斯北京自建设银行取得借款人民币 30,628.03 万元，借款期限从 2023 年 9 月 6 日至 2028 年 9 月 5 日；以上借款均由公司及公司控股股东杨云春先生提供担保。

(2) 赛微电子自上海浦东发展银行股份有限公司北京分行取得借款人民币 9,775.86 万元，借款期限从 2025 年 12 月 22 日至 2035 年 12 月 21 日，该借款由公司控股股东杨云春先生提供担保，同时质押展诚科技 56.24%股权。

(3) 赛莱克斯国际自北京银行股份有限公司安华路支行取得借款 24,696.77 万元，借款期限为 2025 年 9 月 19 日至 2035 年 9 月 19 日，该借款由公司控股股东杨云春先生提供担保，同时质押赛莱克斯北京 9.5%股权。

其他说明，包括利率区间：

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁	117,529,999.29	171,525,401.71
合计	117,529,999.29	171,525,401.71

其他说明

	期末余额
资产负债表日后第 1 年	102,973,501.59
资产负债表日后第 2 年	117,989,439.64
资产负债表日后第 3 年	-
以后年度	-

最低租赁付款合计	220,962,941.23
未确认融资费用	8,214,139.25
应付融资租赁款	212,748,801.98
其中：1 年内到期的租赁款	95,218,802.69
1 年后到期的租赁款	117,529,999.29

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		31,494,400.00
合计		31,494,400.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款		31,494,400.00
合计		31,494,400.00

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关	81,515,032.27		3,938,500.21	77,576,532.06	政府补助
与收益相关	36,654,744.93	8,130,240.00	7,189,410.97	37,595,573.96	政府补助
合计	118,169,777.20	8,130,240.00	11,127,911.18	115,172,106.02	

其他说明：

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	732,213,134.00						732,213,134.00

其他说明：

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,180,383,451.90			4,180,383,451.90
其他资本公积	24,709,154.89	96,484.92		24,805,639.81
合计	4,205,092,606.79	96,484.92		4,205,189,091.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	34,319,994.62	- 91,600,953.07	34,313,418.10			- 125,914,371.17		- 91,594,376.55
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	34,313,418.10		34,313,418.10			- 34,313,418.10		
外币财务报表折算差额	6,576.52	- 91,600,953.07				- 91,600,953.07		- 91,594,376.55
其他综合收益合计	34,319,994.62	- 91,600,953.07	34,313,418.10			- 125,914,371.17		- 91,594,376.55

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,529,640.80			58,529,640.80
合计	58,529,640.80			58,529,640.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,704,231,080.21	254,074,064.86
调整后期初未分配利润	1,704,231,080.21	254,074,064.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,702,213,961.27	1,473,454,069.63
减：提取法定盈余公积		31,630,363.03
应付普通股股利	270,918,859.58	
加：分步收购股权购买日之前持有的股权于购买日的公允价值与账面价值的差额		8,328,000.00
其他		5,308.75
期末未分配利润	4,135,526,181.90	1,704,231,080.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	172,639,103.77	153,324,490.39	545,124,297.95	328,111,073.11
其他业务	5,734,012.05	9,327,491.50	24,971,485.18	13,889,278.57
合计	178,373,115.82	162,651,981.89	570,095,783.13	342,000,351.68

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
MEMS 纯代工	78,971,508.13	62,828,083.38					78,971,508.13	62,828,083.38
IC 设计服务	87,165,772.95	66,248,687.04					87,165,772.95	66,248,687.04
半导体设备	4,424,778.77	21,344,100.00					4,424,778.77	21,344,100.00
其他	7,811,055.97	12,231,111.47					7,811,055.97	12,231,111.47
按经营地区分类								
其中：								
境内销售	176,233,991.95	159,829,481.30					176,233,991.95	159,829,481.30
境外销售	2,139,123.87	2,822,500.59					2,139,123.87	2,822,500.59
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	178,373,115.82	162,651,981.89					178,373,115.82	162,651,981.89

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	109,729.56	2,557.72
教育费附加	81,310.68	1,826.94
房产税	3,237,929.24	2,881,173.00
土地使用税	80,565.23	76,632.75
印花税	358,722.42	181,227.06
环境保护税	40,472.22	27,999.21
合计	3,908,729.35	3,171,416.68

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	26,713,939.26	33,306,915.73
办公费用	3,335,473.54	7,026,840.57
中介咨询费用	3,019,822.42	18,707,066.71
房租及物业费	2,971,563.32	5,646,891.67
折旧	2,878,891.66	2,529,963.89
业务招待费	998,655.70	308,265.96
无形资产摊销	955,055.90	851,971.82
差旅费	775,869.44	751,610.28

会议费	87,460.34	30,362.72
其他	763,317.48	2,642,249.80
合计	42,500,049.06	71,802,139.15

其他说明

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费用	2,680,026.50	11,924,764.81
业务招待费	458,891.61	32,982.40
差旅费	219,430.01	1,419,793.73
广告宣传	62,094.00	678,159.43
办公费	23,779.41	591.22
交通费用	5,899.42	29,470.18
折旧	4,179.15	3,785.06
业务咨询费		1,209,705.34
其他	150,458.11	380,332.51
合计	3,604,758.21	15,679,584.68

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	83,148,764.91	71,985,121.47
工资及福利	63,647,860.99	68,781,792.05
材料费	23,083,383.93	23,387,636.23
能源消耗费	12,207,253.50	12,852,062.35
技术服务费	6,893,199.13	9,496,032.41
固定资产修理费	5,424,877.85	5,275,062.92
无形资产摊销	1,876,930.24	1,973,255.80
房租及物业费	739,718.21	1,572,464.66
办公费用	382,840.84	680,926.87
差旅费	104,018.84	195,511.86
其他	1,490,077.62	3,144,649.91
合计	198,998,926.06	199,344,516.53

其他说明

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,268,387.79	17,159,673.87

减：利息收入	11,808,035.03	5,554,770.71
手续费支出	301,350.59	64,746.65
汇兑损失	31,153,562.50	29,642,794.52
减：汇兑收益	287,140.00	755,992.76
合计	39,628,125.85	40,556,451.57

其他说明

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,432,058.47	18,863,813.62
增值税加计抵减	627,807.96	
个税手续费返还	359,142.77	205,043.56
合计	13,419,009.20	19,068,857.18

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,128,939.80	
其他非流动金融资产	2,572,363,382.61	
合计	2,577,492,322.41	

其他说明：

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,166,391.92	-6,906,594.80
处置长期股权投资产生的投资收益	750,469,509.19	10,394,568.32
合计	781,635,901.11	3,487,973.52

其他说明

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-129,600.00	
应收账款坏账损失	14,712,599.31	-682,863.74
其他应收款坏账损失	33,844,177.84	14,293,744.83

合计	48,427,177.15	13,610,881.09
----	---------------	---------------

其他说明

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,678,174.26	-4,019,999.92
合计	-22,678,174.26	-4,019,999.92

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-16,511,220.61	

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金	175,000.00		175,000.00
非流动资产毁损报废利得	631.58		631.58
合计	175,631.58		175,631.58

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
滞纳金	166,241.37	29.90	166,241.37
非流动资产毁损报废损失	1,386.44		1,386.44
其他	900.00		900.00
合计	173,527.81	29.90	173,527.81

其他说明：

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	217,897,042.87	18,981,596.65
递延所得税费用	215,846,079.62	-60,405,045.56
合计	433,743,122.49	-41,423,448.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,108,867,664.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	777,216,916.04
子公司适用不同税率的影响	-263,719,038.88
调整以前期间所得税的影响	85,492.96
非应税收入的影响	-304,260,922.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,072,992.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-89,598.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,582,653.52
研发加计扣除	-21,057,956.56
以前期间可弥补亏损账面与申报差异	25,177,084.07
来源于境外股息的税款	217,735,500.00
所得税费用	433,743,122.49

其他说明：

55、其他综合收益

详见附注 37、其他综合收益。

56、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	63,001,126.39	100,858,435.52
政府补助	9,815,078.62	8,372,268.09
利息收入	11,808,035.03	5,554,770.71
保证金或押金	73,141.10	2,818,225.67

员工备用金	577, 101. 98	237, 256. 06
营业外收入	175, 631. 58	
合计	85, 450, 114. 70	117, 840, 956. 05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款	87, 350, 000. 00	
费用类	15, 944, 028. 29	42, 101, 016. 17
员工备用金	1, 722, 145. 00	520, 000. 00
往来款	2, 593, 132. 00	300, 000. 00
保证金或押金	173, 994. 35	199, 519. 66
手续费	205, 694. 63	64, 746. 65
营业外支出	173, 527. 81	29. 90
合计	108, 162, 522. 08	43, 185, 312. 38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资取得投资收益收到的现金	632, 234, 154. 72	10, 394, 568. 32
处置长期股权投资收回的投资成本	81, 527, 579. 60	2, 348, 026. 91
处置长期资产收回的现金	26, 090, 000. 00	
合计	739, 851, 734. 32	12, 742, 595. 23

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购置长期资产	58, 255, 109. 04	193, 786, 170. 15
投资参股公司	112, 257, 065. 69	
购买子公司	31, 494, 400. 00	

合计	202,006,574.73	193,786,170.15
----	----------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金户收款	4,700,000.00	
收到代扣分红个税款	12,671,257.39	
收回融资租赁业务保证金		17,790,000.00
合计	17,371,257.39	17,790,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金户付款	4,700,000.00	
分配现金股利手续费	101,821.49	
合计	4,801,821.49	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	253,397,568.67	146,393,469.00	40,221.97	40,300,000.00	6,132.75	359,525,126.89
一年内到期的非流动负债	199,590,165.11		74,283,195.61	20,854,150.82	1,025,467.37	251,993,742.53
长期借款	754,615,128.64	64,112,934.24	391,930.33	50,023,462.41	35,006,644.07	734,089,886.73
租赁负债	171,525,401.71		13,684.80	35,586,686.50	18,422,400.72	117,529,999.29
合计	1,379,128,264.13	210,506,403.24	74,729,032.71	146,764,299.73	54,460,644.91	1,463,138,755.44

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,675,124,541.68	-28,887,546.28
加：资产减值准备	-25,749,002.89	-9,590,881.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,481,367.46	96,569,805.29
使用权资产折旧	25,033,927.48	34,955,273.91
无形资产摊销	7,026,106.64	3,916,778.38
长期待摊费用摊销	3,764,642.15	2,406,840.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	16,511,220.61	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	754.86	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,577,492,322.41	
财务费用（收益以“－”号填列）	51,134,810.29	17,159,673.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-781,635,901.11	-3,487,973.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-36,207,741.07	-63,577,976.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	252,053,820.69	12,602,325.23
存货的减少（增加以“－”号填列）	-30,900,235.57	-34,524,789.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	148,850,947.22	166,535,997.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	82,400,407.66	-17,629,369.97
其他	-2,901,186.26	-10,645,604.31
经营活动产生的现金流量净额	-109,503,842.57	165,802,553.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,391,380,536.57	1,019,684,061.76
减：现金的期初余额	2,244,368,874.18	615,452,918.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	147,011,662.39	404,231,143.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	31,494,400.00
其中：	
青岛展诚科技有限公司	31,494,400.00
取得子公司支付的现金净额	31,494,400.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,391,380,536.57	2,244,368,874.18
可随时用于支付的银行存款	2,391,380,536.57	2,244,368,874.18
三、期末现金及现金等价物余额	2,391,380,536.57	2,244,368,874.18

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	189,051,760.64	6.8109	1,287,612,636.54
欧元	94,037.99	7.7672	730,411.88
港币	232,992.93	0.8685	202,354.36
瑞典克朗	959,402,643.51	0.7003	671,869,671.25
林吉特	585,322.93	1.6734	979,479.39
应收账款			
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

（2） 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

（3） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

（4） 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

60、租赁

（1） 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

本公司作为承租方以简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁主要为租赁房屋、机器等，本期租赁费用合计为 1,137,336.18 元。

涉及售后租回交易的情况

本公司售后租回交易主要涉及机器设备，详见“七、合并财务报表项目注释 15 使用权资产”和“七、合并财务报表项目注释 32 租赁负债”。

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋建筑物出租	4,841,216.64	
合计	4,841,216.64	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

61、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	83,148,764.91	71,985,121.47
工资及福利	63,647,860.99	68,781,792.05
材料费	23,083,383.93	23,387,636.23
能源消耗费	12,207,253.50	12,852,062.35
技术服务费	6,893,199.13	9,496,032.41
固定资产修理费	5,424,877.85	5,275,062.92
无形资产摊销	1,876,930.24	1,973,255.80
房租及物业费	739,718.21	1,572,464.66
办公费用	382,840.84	680,926.87
差旅费	104,018.84	195,511.86
其他	1,490,077.62	3,144,649.91
合计	198,998,926.06	199,344,516.53
其中：费用化研发支出	198,998,926.06	199,344,516.53

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	-----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值		购买日账面价值	
资产：				
货币资金				
应收款项				
存货				
固定资产				
无形资产				
负债：				
借款				
应付款项				
递延所得税负债				
净资产				
减：少数股东权益				
取得的净资产				

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京赛莱克斯国际科技有限公司	1,500,000,000.00	北京市北京经济技术开发区西环南路 26 号院 1 幢 4 层 3A11 室	北京市北京经济技术开发区西环南路 26 号院 1 幢 4 层 3A11 室	技术开发/销售	100.00%		非同一控制下企业合并
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	2,105,263,200.00	北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）	北京市北京经济技术开发区科创八街 21 号院 1 号楼（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）	技术开发/销售		80.00%	通过设立方式取得
运通电子有限公司	10,000.00 港币	香港特别行政区海港城海洋中心 16 楼 1627	香港特别行政区海港城海洋中心 16 楼 1627	持股平台		100.00%	非同一控制下企业合并
北京赛积国际科技有限公司	880,000,000.00	北京市北京经济技术开发区科创十三街 1 号院 3 号楼 2 层 101-07 室	北京市北京经济技术开发区科创十三街 1 号院 3 号楼 2 层 101-07 室	技术开发/销售	100.00%		通过设立方式取得
北京海创微芯科技有限公司	30,000,000.00	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼三层 329-04 室	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼三层 329-04 室	技术开发/销售		70.00%	通过设立方式取得
飞纳经纬科技（北京）有限公司	10,000,000.00	北京市西城区裕民路 18 号 24 层 2606 号	北京市西城区裕民路 18 号 24 层 2606 号	技术开发/销售	65.00%		非同一控制下企业合并
北京微芯科技有限公司	100,000,000.00	北京市北京经济技术开发区科创十三街 1 号院 3 号楼 2 层 101-06 室	北京市北京经济技术开发区科创十三街 1 号院 3 号楼 2 层 101-06 室	技术开发/销售	100.00%		通过设立方式取得
北京中科赛微电子科技有限公司	10,000,000.00	北京市海淀区花园北路 25 号小关（厂南	北京市海淀区花园北路 25 号小关（厂南	技术开发/销售		57.14%	通过设立方式取得

		区) 5 幢 2 层 1-208 室	区) 5 幢 2 层 1-208 室				
北京极芯传感 科技中心 (有 限合伙)	3,000,000.00	北京市北京经 济技术开发区 科谷一街 10 号院 5 号楼 8 层 801 室	北京市北京经 济技术开发区 科谷一街 10 号院 5 号楼 8 层 801 室	投资平台	99.00%	1.00%	通过设立方式 取得
赛莱克斯微系 统科技 (深 圳) 有限公司	1,500,000.00	深圳市光明区 凤凰街道东坑 社区凤归路 3 号 2 栋一层	深圳市光明区 凤凰街道东坑 社区凤归路 3 号 2 栋一层	技术开发/销 售		30.00%	通过设立方式 取得
北京海创微元 科技有限公司	300,000,000.00	北京市怀柔区 大中富乐村北 红螺东路 21 号 56 幢 2 层 210 室	北京市怀柔区 大中富乐村北 红螺东路 21 号 56 幢 2 层 210 室	技术开发/销 售	42.00%		通过设立方式 取得
青岛展诚科技 有限公司	10,000,000.00	山东省青岛市 市南区延安三 路 109 号华通 中联创意产业 园 B2 栋 3 层	山东省青岛市 市南区延安三 路 109 号华通 中联创意产业 园 B2 栋 3 层	技术开发/销 售	56.24%	4.76%	非同一控制下 企业合并
南京宁芯微电 子科技有限公司	1,050,000.00	南京市江北新 区研创园江淼 路 88 号腾飞 大厦 A 座 6 层 612 室	南京市江北新 区研创园江淼 路 88 号腾飞 大厦 A 座 6 层 612 室	技术开发/销 售		100.00%	非同一控制下 企业合并
成都芯卓微电 子科技有限公司	1,000,000.00	中国 (四川) 自由贸易试验 区成都高新区 天府大道中段 1388 号 1 栋 5 层 522 号	中国 (四川) 自由贸易试验 区成都高新区 天府大道中段 1388 号 1 栋 5 层 522 号	技术开发/销 售		100.00%	非同一控制下 企业合并
青岛芯诚微电 子科技有限公司	3,000,000.00	山东省青岛市 崂山区松岭路 169 号青岛国 际创新园二期 D2-1601	山东省青岛市 崂山区松岭路 169 号青岛国 际创新园二期 D2-1601	技术开发/销 售		100.00%	非同一控制下 企业合并
上海芯舵科技 有限公司	1,000,000.00	中国 (上海) 自由贸易试验 区祖冲之路 2305 号 B 幢 908 室 (房产 登记证为 8 层)	中国 (上海) 自由贸易试验 区祖冲之路 2305 号 B 幢 908 室 (房产 登记证为 8 层)	技术开发/销 售		51.00%	非同一控制下 企业合并
无锡筑芯科技 有限公司	1,000,000.00	无锡市新吴区 菱湖大道 111- 34 号无锡软件 园天鹅座 D 座 301 室-077	无锡市新吴区 菱湖大道 111- 34 号无锡软件 园天鹅座 D 座 301 室-077	技术开发/销 售		51.00%	通过设立方式 取得
运通电子技术 发展有限公司	10,000.00 港币	香港特别行政 区海港城海洋 中心 16 楼 1627	香港特别行政 区海港城海洋 中心 16 楼 1627	技术开发/销 售		100.00%	通过设立方式 取得
VCHIP SDN. BHD.	10,000.00 林吉特	马来西亚, 檳 城, 乔治市, 苏丹艾哈迈德	马来西亚, 檳 城, 乔治市, 苏丹艾哈迈德	技术开发/销 售		100.00%	非同一控制下 企业合并

		沙路, BHL 大厦, 51-10-F	沙路, BHL 大厦, 51-10-F				
亞芯(香港)有限公司	10,000.00 港币	香港特别行政区九龙湾宏光道 8 号创豪坊 8 层 5 号	香港特别行政区九龙湾宏光道 8 号创豪坊 8 层 5 号	持股平台		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司持有赛莱克斯微系统科技(深圳)有限公司 30%股权,为第一大股东,赛莱克斯微系统科技(深圳)有限公司设有董事会,董事会由 3 名成员组成,北京赛莱克斯国际科技有限公司提名 2 人,且赛莱克斯微系统科技(深圳)有限公司董事长由本公司董事长杨云春担任,财务及法务等相关事务亦由本公司控制,本公司能够控制赛莱克斯微系统科技(深圳)有限公司,因此将其纳入合并报表范围。

公司直接持有北京海创微元科技有限公司 42%股权,为第一大股东,北京海创微元科技有限公司设有董事会,董事会由 5 名成员组成,公司提名 3 人,且北京海创微元科技有限公司董事长由本公司董事长杨云春担任,财务及法务等相关事务亦由本公司控制,本公司能够控制北京海创微元科技有限公司,因此将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司	20.00%	-23,637,621.56		182,801,165.72
青岛展诚科技有限公司	39.00%	1,476,578.58		22,031,181.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	945,982,195.74	2,093,865,675.12	3,039,847,870.86	1,722,979,417.13	393,941,341.49	2,116,920,758.62	940,094,653.05	2,122,407,195.11	3,062,501,848.16	1,563,063,711.56	458,322,916.56	2,021,386,628.12
青岛展诚科技有限公司	170,775,343.92	9,375,607.30	180,150,951.22	114,438,015.94	7,052,136.85	121,490,152.79	193,778,799.78	6,588,616.10	200,367,415.88	142,166,372.32	4,006,921.37	146,173,293.69

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	81,521,171.46	-118,188,107.80	-118,188,107.80	-13,423,733.45	79,337,320.62	-80,108,452.46	-80,108,452.46	-4,105,492.49
青岛展诚科技有限公司	87,520,539.01	4,218,241.91	4,270,191.32	-29,951,715.75				

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	648,755,817.93	596,125,215.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,939,617.01	-6,906,594.80
--综合收益总额	-2,939,617.01	-6,906,594.80

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	81,515,032 .27			3,938,500. 21		77,576,532 .06	与资产相关
递延收益	36,654,744 .93	8,130,240. 00		7,189,410. 97		37,595,573 .96	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	12,432,058.47	18,863,813.62

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、衍生金融资产、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）国际局势及汇率波动风险

自二战之后，特别是上世纪八九十年代以来，全球化发展日益加速，已成为时代发展的重要特征和显著标志，国家之间在经济、政治、文化、社会等方面的交流程度大幅提升，在加速科技进步和生产力发展的同时，也使得民族国家的利益面临着多元化的冲击和挑战，最终导致民族主义情绪的累积并在近年来显著抬头，右翼民粹主义、反全球化主义、贸易保护主义、本土主义等主张在全球，尤其是欧美国家泛起，引发国际局势紧张及日趋复杂化，对跨国经营的企业提出诸多新的挑战。公司同时持有境内外资产，虽然公司在 2025 年 7 月已完成瑞典 Silex 控制权出售的交割，但公司目前仍持有瑞典 Silex 股份，此外公司还涉及外币结算，日常涉及美元、欧元、瑞典克朗、日元、人民币等货币。因此，公司客观上面临着国际政治经济局势剧烈变化的风险，随之而来的还包括因汇率大幅波动对公司报表业绩（以人民币计算）产生较大影响的风险。

（2）行业竞争加剧的风险

公司 MEMS 主业直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、惠普、意法半导体、德州仪器等 IDM 企业，也包括 Teledyne、台积电、X-FAB、索尼、Atomica 等境外代工企业，以及芯联集成、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微、华鑫微纳等含 MEMS 业务的境内企业；IC 设计服务及 EDA 工具服务竞争对手包括创意电子、智原科技、灿芯股份、创耀科技、芯原股份、华大九天、概伦电子、广立微、行芯科技等。MEMS 属于技术、智力及资金密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来市场及产品竞争的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

（3）新兴行业的创新风险

公司 MEMS 主业属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，同时也是国家“十五五”规划中的科技前沿攻关领域，该产业技术进步及迭代迅速，要求行业参与者不断通过新技术/工艺的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术/工艺、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，近年来，公司研发费用支出的绝对金额以及占营业收入的比重均处于高位，2023-2025 年及 2026 年上半年，公司研发费用分别高达 3.57 亿元、4.55 亿元、3.93 亿元、1.99 亿元，占营业收入的比重分别高达 27.44%、37.75%、47.66%、111.56%（2026 年上半年主要系瑞典 Silex 出表公司营业收入下滑，导致研发费用占营业收入比重大幅上升），而研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

2、信用风险

2026 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收账款及其他应收款。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司存在信用风险集中的情况，应收账款余额前五名占 2026 年 6 月 30 日应收账款余额的 49.37%。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的 被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	13,790,603.66			13,790,603.66
（4）基金投资	13,790,603.66			13,790,603.66
（二）其他非流动金融 资产	4,454,268,818.16			4,454,268,818.16
持续以公允价值计量的 资产总额	4,468,059,421.82			4,468,059,421.82
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产和其他非流动金融资产，以市场报价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杨云春。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
西安智诚微电子科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
穆林	本公司实际控制人之配偶
北京芯东来半导体科技有限公司	本公司实际控制人担任董事的企业
北京瑞宏宇星科技有限公司	本公司董事持股超过 5%的企业
青岛聚能创芯微电子有限公司	本公司实际控制人担任董事长、总经理的企业
海创智能装备（烟台）有限公司	本公司实际控制人控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
海创智能装备（烟台）有限公司	采购材料	10,619.47			
西安智诚微电子科技有限公司	采购服务	4,128,764.19			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛聚能创芯微电子有限公司	MEMS 工艺开发		4,425,000.00
北京芯东来半导体科技有限公司	出售半导体设备	5,309,734.51	
西安智诚微电子科技有限公司	销售服务	664,567.69	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
穆林	房屋	134,112.00	134,112.00				268,224.00				
杨云春	房屋	108,156.80	140,603.84				87,877.40				

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京赛积国际科技有限公司	250,000,000.00	2022 年 10 月 31 日	2028 年 10 月 31 日	否
北京赛积国际科技有限公司	50,000,000.00	2025 年 09 月 05 日	2026 年 12 月 31 日	否
北京赛积国际科技有限公司	25,000,000.00	2025 年 10 月 15 日	2027 年 10 月 15 日	否
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	50,000,000.00	2025 年 09 月 05 日	2026 年 12 月 31 日	否
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	100,000,000.00	2025 年 04 月 23 日	2027 年 06 月 25 日	否
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	100,000,000.00	2025 年 12 月 25 日	2027 年 01 月 25 日	否
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	100,000,000.00	2025 年 09 月 30 日	2027 年 04 月 27 日	否

赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	450,000,000.00	2023 年 09 月 06 日	2028 年 09 月 05 日	否
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	230,000,000.00	2025 年 05 月 29 日	2028 年 05 月 28 日	否
北京赛莱克斯国际科技有限公司	258,967,680.00	2025 年 09 月 15 日	2035 年 09 月 15 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨云春	10,000,000.00	2025 年 10 月 15 日	2027 年 10 月 15 日	否
杨云春	125,977,600.00	2025 年 12 月 11 日	2035 年 12 月 10 日	否
杨云春	250,000,000.00	2022 年 10 月 31 日	2028 年 10 月 31 日	否
杨云春	50,000,000.00	2025 年 09 月 05 日	2026 年 12 月 31 日	否
杨云春	25,000,000.00	2025 年 10 月 15 日	2027 年 10 月 15 日	否
杨云春	50,000,000.00	2025 年 09 月 05 日	2026 年 12 月 31 日	否
杨云春	100,000,000.00	2025 年 04 月 23 日	2027 年 06 月 25 日	否
杨云春	100,000,000.00	2025 年 12 月 25 日	2027 年 01 月 25 日	否
杨云春	100,000,000.00	2025 年 09 月 30 日	2027 年 04 月 27 日	否
杨云春	450,000,000.00	2023 年 09 月 06 日	2028 年 09 月 05 日	否
杨云春	258,967,680.00	2025 年 09 月 15 日	2035 年 09 月 15 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,280,776.04	3,575,911.96

(8) 其他关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	购买价格（元）
-----	------	--------	--------	----------	---------

海创智能装备（烟台）有限公司	为公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生实际控制企业且其担任执行董事	收购股权	收购海创智能装备持有的芯东来部分股权	以芯东来 2025 年 5 月融资投后估值 5 亿元为参考，并结合实际经营、资产、所在行业估值及未来发展、合作情况，经各方初步协商确定	22,231,000.00
----------------	--------------------------------------	------	--------------------	---	---------------

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京芯东来半导体科技有限公司	5,309,734.51	265,486.73		
应收账款	西安智诚微电子科技有限公司	331,963.25	16,598.16	311,704.50	15,585.23

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	穆林	134,112.00	0.00
其他应付款	杨云春	389,364.48	281,207.68
应付账款	西安智诚微电子科技有限公司	556,603.77	1,609,451.16
合同负债	北京芯东来半导体科技有限公司	6,500,761.91	6,500,761.91
合同负债	青岛聚能创芯微电子有限公司	4,425,000.00	4,425,000.00
合同负债	北京瑞宏宇星科技有限公司	2,946,902.65	2,946,902.65
其他应付款	海创智能装备（烟台）有限公司	11,055,663.72	11,055,663.72
应付账款	海创智能装备（烟台）有限公司	12,000.00	0.00
其他流动负债	北京芯东来半导体科技有限公司	845,099.05	845,099.05
其他流动负债	北京瑞宏宇星科技有限公司	383,097.35	383,097.35

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、耐威时代借款还款事项

公司 2021 年 3 月 16 日第四届董事会第十次会议以及 2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，同意将全资子公司耐威时代 100%股权以 3.74 亿元人民币转让给青州市宏源公有资产经营有限公司。公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司股权转让交易调整的议案》，同意公司签署《股权转让协议补充协议》，各方均同意北京耐威时代科技有限公司原持有的导航产业基地土地使用权、房屋、建筑物及构筑物等资产不再列入原协议项下股权转让标的范围内，股权价款变更为 18,121.71 万元。2022 年 3 月 29 日，耐威时代已完成该次股权转让交易的工商变更登记程序并取得新的营业执照。截至 2022 年 3 月 10 日，上述股权转让款已全部收回。

在公司作为耐威时代控股股东期间，为支持耐威时代业务发展，公司向其提供借款，借款金额 227,964,855.12 元，待支付的分红款 28,000,000.00 元，上述款项均未归还。针对上述借款，公司与耐威时代及耐威时代控股股东青州市宏源公有资产经营有限公司签署了《还款协议》，具体还款内容如下：

- (1) 耐威时代应当于 2023 年偿还人民币 25,964,855.12 元；
- (2) 耐威时代应当于 2024 年偿还人民币 100,000,000.00 元；
- (3) 耐威时代应当于 2025 年偿还人民币 130,000,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，耐威时代上述借款及分红款已偿还 195,250,000.00 元，尚余借款 60,714,855.12 元未偿还，该笔款项已逾期。公司与耐威时代达成协议，耐威时代承诺在 2026 年 5 月 31 日前全额偿还上述款项。截至 2026 年 6 月 30 日，上述款项已经按照协议约定全部归还。

2、其他说明

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生所持公司 11,843,479 股股份被司法冻结（诉前保全），占其所持股份的比例为 7.69%，占公司总股本比例为 1.62%。该事项起因为杨云春先生控制的商业主体（非赛微电子及其子公司）与申请保全方的融资租赁合同纠纷。原告与被告在案件审理过程中自行和解达成协议，2026 年 6 月 24 日山东省青岛市中级人民法院予以确认，出具了《民事调解书》，案件已审理终结。根据《民事调解书》，欠款方应于 2026 年 9 月 30 日前（含当日）向青岛国信分批偿还未偿还款项。

(2) 2026 年 7 月 8 日，赛莱克斯国际与国家集成电路基金签署了《产权交易合同》，赛莱克斯国际向国家集成电路基金购买其持有的赛莱克斯北京的 19%股权，交易价格为 62,362.74 万元。截至 2026 年 7 月 10 日，赛莱克斯国际已向北京产权交易所支付本次交易全部价款，赛莱克斯国际收到北京产权交易所出具的《产权交易凭证》。2026 年 8 月 20 日，该交易完成工商变更登记，公司合计间接持有赛莱克斯北京 100%的股权。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,057,700.00	21,227,700.00
1 至 2 年	12,669,900.00	45,019,900.00
2 至 3 年	46,701,747.76	33,351,747.76
3 年以上	35,633,341.62	35,641,567.71
3 至 4 年	18,199,537.12	21,699,537.12
4 至 5 年	9,150,000.00	5,650,000.00

5 年以上	8,283,804.50	8,292,030.59
合计	107,062,689.38	135,240,915.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,600,000.00	1.49%	1,600,000.00	100.00%		1,600,000.00	1.18%	1,600,000.00	100.00%	
其中：										
客户 1	1,600,000.00	1.49%	1,600,000.00	100.00%		1,600,000.00	1.18%	1,600,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	105,462,689.38	98.51%	34,313,797.61	32.54%	71,148,891.77	133,640,915.47	98.82%	34,295,523.70	25.66%	99,345,391.77
其中：										
账龄组合	105,462,689.38	98.51%	34,313,797.61	32.54%	71,148,891.77	133,640,915.47	98.82%	34,295,523.70	25.66%	99,345,391.77
合计	107,062,689.38	100.00%	35,913,797.61	33.54%	71,148,891.77	135,240,915.47	100.00%	35,895,523.70	26.54%	99,345,391.77

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	客户财务困难
合计	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,057,700.00	602,885.00	5.00%
1 至 2 年	12,669,900.00	1,266,990.00	10.00%
2 至 3 年	46,701,747.76	9,340,349.55	20.00%
3 至 4 年	18,199,537.12	9,099,768.56	50.00%
4 至 5 年	9,150,000.00	7,320,000.00	80.00%
5 年以上	6,683,804.50	6,683,804.50	100.00%

合计	105,462,689.38	34,313,797.61	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,600,000.00					1,600,000.00
按组合计提坏账准备	34,295,523.70	18,273.91				34,313,797.61
合计	35,895,523.70	18,273.91				35,913,797.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	27,909,300.00		27,909,300.00	26.07%	4,376,700.00

客户 2	20,257,800.00		20,257,800.00	18.92%	8,881,455.00
客户 3	18,590,700.00		18,590,700.00	17.36%	2,507,760.00
客户 4	9,721,401.44		9,721,401.44	9.08%	4,860,700.72
客户 5	8,478,135.68		8,478,135.68	7.92%	4,239,067.84
合计	84,957,337.12		84,957,337.12	79.35%	24,865,683.56

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		200,000,000.00
其他应收款	1,772,952,890.62	1,560,519,281.05
合计	1,772,952,890.62	1,760,519,281.05

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京赛莱克斯国际科技有限公司		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权投资款	876,640,066.62	876,640,066.62
往来款	894,410,308.80	714,865,915.22
股权转让款	2,550,000.00	2,550,000.00
押金及保证金	2,050,850.00	2,004,850.00
备用金	515,955.47	483,127.47
代扣代缴款项	156,778.61	162,182.61
合计	1,776,323,959.50	1,596,706,141.92

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	731,917,218.03	491,680,661.68
1 至 2 年	210,518,697.38	194,818,097.38
2 至 3 年	20,770,000.00	4,400,000.00
3 年以上	813,118,044.09	905,807,382.86
3 至 4 年	987,000.00	63,293,127.47
4 至 5 年	596,106,326.23	623,188,732.73
5 年以上	216,024,717.86	219,325,522.66
合计	1,776,323,959.50	1,596,706,141.92

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	33,636,860.87		2,550,000.00	36,186,860.87
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-32,815,791.99			-32,815,791.99
2026 年 6 月 30 日余额	821,068.88		2,550,000.00	3,371,068.88

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	36,186,860.87	-32,815,791.99				3,371,068.88
合计	36,186,860.87	-32,815,791.99				3,371,068.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京赛莱克斯国际科技有限公司	股权投资款	825,840,066.62	2-3 年 19,800,000 元， 4-5 年 595,020,198.76 元， 5 年以上 211,019,867.86 元	46.49%	
赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司	往来款	487,249,369.04	1 年以内 387,229,248.70 元， 1-2 年 100,020,120.34 元	27.43%	
北京微芯科技有限公司	往来款	208,930,000.00	1 年以内	11.76%	
北京海创微芯科技有限公司	往来款	152,395,334.96	1 年以内 93,596,757.92 元， 1-2 年 58,798,577.04 元	8.58%	
北京赛积国际科技有限公司	股权投资款	50,800,000.00	1-2 年	2.86%	
合计		1,725,214,770.62		97.12%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,927,144,703.52		2,927,144,703.52	2,927,144,703.52		2,927,144,703.52
对联营、合营企业投资	513,553,059.73		513,553,059.73	527,391,127.85		527,391,127.85
合计	3,440,697,763.25		3,440,697,763.25	3,454,535,831.37		3,454,535,831.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京赛莱克斯国际科技有限公司	1,784,620,761.87						1,784,620,761.87	
飞纳经纬科技（北京）有限公司	16,500,000.00						16,500,000.00	
北京微芯科技有限公司	75,084,429.40						75,084,429.40	
北京赛积国际科技有限公司	767,467,512.25						767,467,512.25	
北京海创微元科技有限公司	126,000,000.00						126,000,000.00	
青岛展诚科技有限公司	157,472,000.00						157,472,000.00	
合计	2,927,144,703.52						2,927,144,703.52	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉光谷信息技术股份有限公司和湖北北	368,811,396.52				-452,324.62							368,359,071.90

斗产业 创业投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙）												
青岛海 丝民合 半导体 投资中 心（有 限合 伙）	9,350,5 51.91			8,619,0 53.11							731,498 .80	
青岛聚 能创芯 微电子 有限公 司	12,734, 627.41				- 4,017,3 35.36						8,717,2 92.05	
北京赛 微私募 基金管 理有限 公司	12,322, 175.20				- 540,490 .65						11,781, 684.55	
北京北 工怀微 传感科 技股权 投资基 金（有 限合 伙）	124,172 ,376.81			3,882,5 27.50	3,673,6 63.12						123,963 ,512.43	
小计	527,391 ,127.85			12,501, 580.61	- 1,336,4 87.51						513,553 ,059.73	
合计	527,391 ,127.85			12,501, 580.61	- 1,336,4 87.51						513,553 ,059.73	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

由于武汉光谷信息技术股份有限公司为新三板挂牌企业（证券代码 430161），其截至 2026 年 8 月 26 日尚未披露 2026 年半年度报告，因此将武汉光谷信息技术股份有限公司及湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合并列示。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			8,807.34	
合计			8,807.34	

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,336,487.51	-6,821,999.84
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,864,117.42	10,394,568.32
合计	-8,200,604.93	3,572,568.48

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	733,958,288.58	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,493,558.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,577,492,322.41	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,103.77	
减：所得税影响额	236,888,660.98	
少数股东权益影响额（税后）	1,591,837.57	
合计	3,081,465,774.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	34.07%	3.6905	3.6905
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.78%	-0.5180	-0.5180

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他